

盛群半導體股份有限公司

一〇四年度年報

刊印日期：中華民國一〇五年四月二十五日

臺灣證券交易所公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司揭露年報相關資料之網址：<http://www.holtek.com.tw>

一、發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓 名：李佩縈

職 稱：資源管理中心副總經理

聯絡電話：(03)563-1999

電子郵件信箱：pattyli@holtek.com.tw

二、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓 名：蔡榮宗

職 稱：業務行銷中心協理

聯絡電話：(03)563-1999

電子郵件信箱：armstro@holtek.com.tw

三、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新竹科學園區研新二路 3 號

電 話：(03)563-1999

分公司地址：香港九龍長沙灣道 777-779 號天安工業大廈三字樓 A 座

Block A, 3/F Tin On Industrial Building

777-779 Cheung Sha Wan Rd.

Kowloon, Hong Kong

電 話：852-2745-8288

台北營業處：台北市南港區園區街 3 之 2 號 4 樓之 2

電 話：(02)2655-7070

大陸營業處：合泰半導體(中國)有限公司

中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢(總部壹號 10 號樓)

電 話：86-769-2626-1300

四、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市博愛路 17 號 3 樓

網 址：www.sinotrade.com.tw

電 話：(02)2381-6288

五、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：曾漢鈺會計師、游萬淵會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：台北市信義路五段 7 號 68 樓（台北 101 大樓）

網 址：www.kpmg.com.tw

電 話：(02)8101-6666

六、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式
無

七、公司網址

www.holtek.com.tw

盛群半導體股份有限公司

一〇四年度年報

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司簡介	
一、設立日期	3
二、公司沿革	3
參、公司治理報告	
一、組織系統	5
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構 主管資料	8
三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	12
四、公司治理運作情形	19
五、會計師公費資訊	50
六、更換會計師資訊	51
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近 一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形	51
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股 比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	52
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係之資訊	53
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之 事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	54
肆、募資情形	
一、資本及股份	56
二、公司債	61
三、特別股	61
四、海外存託憑證	61
五、員工認股權憑證	61
六、限制員工權利新股	61
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	61
八、資金運用計畫執行情形	61

伍、營運概況

一、業務內容-----	62
二、市場及產銷概況-----	73
三、從業員工-----	82
四、環保支出資訊-----	82
五、勞資關係-----	82
六、重要契約-----	85

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表-----	86
二、最近五年度財務分析-----	94
三、最近年度財務報告之監察人審查報告-----	99
四、最近年度財務報告-----	99
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告-----	99
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響-----	99

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況-----	185
二、財務績效-----	186
三、現金流量-----	187
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	187
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫-----	188
六、風險事項分析-----	188
七、其他重要事項-----	189

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料-----	190
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	197
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形-----	197
四、其他必要補充說明事項-----	197
五、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項-----	197

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

盛群半導體股份有限公司（以下簡稱本公司）在 2015 年面對全球經濟不穩定、國際油價持續下跌、日本與歐盟因採量化寬鬆政策引起貨幣貶值與全球通縮等不利因素，因此本公司在 2015 年度仍然是採取謹慎保守的經營策略；這一年同時面臨大陸經濟的緊縮政策，美國升息帶動美元強勢引發各新興國家貨幣競相貶值，均直接或間接影響全球半導體產業發展，全球產值並未如原先預估 2% 以上的成長，反而較 2014 年衰退約 1%。

大環境雖處於不佳狀況，本公司 2015 年度營收仍是向前邁進一小步達成新台幣（以下同）39.68 億元，較 2014 年雖僅微幅成長 0.9%，但毛利率則提升到 49% 的高水準；歸屬母公司稅後淨利 8.07 億元較前一年度 7.92 億元小幅成長 2%，每股稅後盈餘則超過 2014 年度的 3.52 元達到 3.57 元，在全球經濟不穩定及半導體產業激烈競爭環境下有此成績誠屬不易，惟經營團隊檢討後認為表現應該還有許多方面需要檢討改善之處。

綜合檢視 2015 年本公司整體營運的概況，分別從業務／產品開發／生產等方面簡要說明如下：

業務方面：

本公司 2015 年度營收來自中國大陸及香港地區佔比 69%，較 2014 年增加 1%，臺灣地區營收佔比也較前一年度增加 1% 達到 15%，其它海外地區佔比則降低 2% 至 16%；從以上的資訊上反應出大陸地區對半導體需求仍是最大市場，對全球經濟影響力也越來越強，為因應大陸地區客戶快速變化，產品的銷售及技術服務力道需要更深入與到位，本公司在大陸地區業務面除了佈建完整通路商體系外，更需要有更多專業方案公司的加入，才能強化對終端客戶的應用技術服務；經過一年的努力，去年度又再新增兩家方案公司深入合作，對未來產品發展及市場推廣將更有助益；臺灣地區由於在電競週邊產品領域有不錯的表現因而有所增長，海外地區則面臨部份地區尤其是中南美新興國家經濟衰退導致比重降低。

產品開發方面：

2015 年度計有七類 129 項產品開發計劃，共完成 82 項約佔 64%，產品開發成效不盡理想，但由於設計 IP 化加上企劃規格正確性與嚴謹性逐漸提升，因此產品的 Work-Rate 與 Time-to-Market 已有顯著改善，多項產品對於客戶與市場需求都能及時到位將對營收貢獻助益不少。新開發完成的產品項目中包括：

1. 標準 8-bit MCU：內建高記憶體容量資源、高精準數位類比轉換及觸控 SOC MCU。
2. ASSP MCU：包括第二代移動電源 MCU／快充 Quick Charger 2.0／無線充電 MCU／鋰電池充電管理 MCU／無刷直流馬達控制 BLDC MCU／健康量測 MCU／LED 燈飾控制 MCU 等。
3. 系列性 ARM M0+ 32-bit MCU。
4. 各式電源管理／電源轉換 IC。
5. 各式模組：包括溫濕度感應模組、PIR 感測模組及 1mm 超薄型光學式指紋辨識模組等。

生產方面：

隨著本公司產品越來越多樣化，所採用的晶圓製程與封裝技術也需不斷提升，對生產部門工作將是一大挑戰，本公司產品製程需求已從早期 0.35 微米轉至 0.25 微米，並一路往前推進到 0.11 微米及 90 奈米，封裝從低腳數逐漸往高腳數及極小體積發展，配合本公司產品演進發展，生產單位都能提供新產品開發所需製程及封裝，亦需同時要應付每月超過 6 千萬顆 IC 以上的晶圓與封裝出貨需求，生產單位都能使命必達對營收成長貢獻良多，擔當本公司最堅強的後勤支援。

根據國際貨幣基金 IMF 與中國中科院預測，2016 年度全球經濟成長率約為 3.4%，其中美國 2.6%、歐元區 1.7%、日本 1.0% 及中國 6.8%，尤以中國大陸經濟成長動能逐漸減低影響最劇，中國市場整體製造產能過剩造成供給失衡現象，加上低迷的油價與原物料價格，以及多數國家潛在的通膨壓力，從以上的數據與狀況預估 2016 年整體市場景氣恐怕並不樂觀；但另一方面，由於 IoT 物聯網（Internet of Things）的發展，加上大陸二胎化及人口老化趨勢，對健康概念持續發酵將產生更多的半導體產品應用需求，因此部份調研機構預期，2016 年半導體市場前景也可能會好轉，全球半導體產值可望增加 3%，這對半導體產業彷彿露出一道曙光，本公司應好好把握此一方向面對 2016 年的挑戰，無論在經營管理、產品開發、推廣銷售、以及生產調度等都將更為艱辛，但本公司也已備妥因應的對策，只要各單位能落實執行，達成目標是指日可待，2016 年相關營運計劃說明如下：

2016 年度產品開發的重點包括：RF 無線產品、SoC MCU、低功耗 32-bit MCU、各式 ASSP MCU；8-bit MCU 產品開發則需加強大記憶體容量資源、耐高壓、耐大電流、低工作電壓、極低功耗等標準與 ASSP MCU；此外，各式模組產品、健康量測產品、高精密度量測、安防應用、指紋辨識應用，以及 IoT 相關應用等產品項目，都需要研發團隊加強積極執行提高開發效率。

在業務方面，面對外在競爭更加激烈情形下，業務單位需針對現有產品找出更多應用發揮，新開發出的產品則需採取主動有效攻擊以搶佔市場，相信一定可以提升公司的營收突破 40 億元的關卡；同時前線的業務與技術服務同仁更應主動出擊加強企圖心，培養觀察新產品與新市場的專業能力，不斷強化既有通路的專業與服務能力，積極找出不同產品應用領域的專業方案公司，才得以創造更多客戶 Design-in 的機會；再加上生產單位強而有力的後勤支援，以上各面向所構成的競爭力將是公司持續成長的主要動能。

本公司經營團隊深信 2016 年在業務推廣／產品開發／生產交貨／品質控管等各項重要工作展開，所有前線與後勤單位同仁做事更為積極主動，把守勢轉為攻勢，全力以赴努力達成 2016 年度 42 億元的營收目標將不是難事。

當然，最重要的還有各位股東長期給予的支持與鼓勵，讓本公司經營團隊毫無後顧之憂，全力衝出好成績以回饋給所有股東。

最後祝福全體股東 健康如意、平安喜樂、財源廣進！

董事長 吳啟勇



總經理 高國棟



貳、公司簡介

一、 設立日期：民國八十七年十月一日。

二、 公司沿革

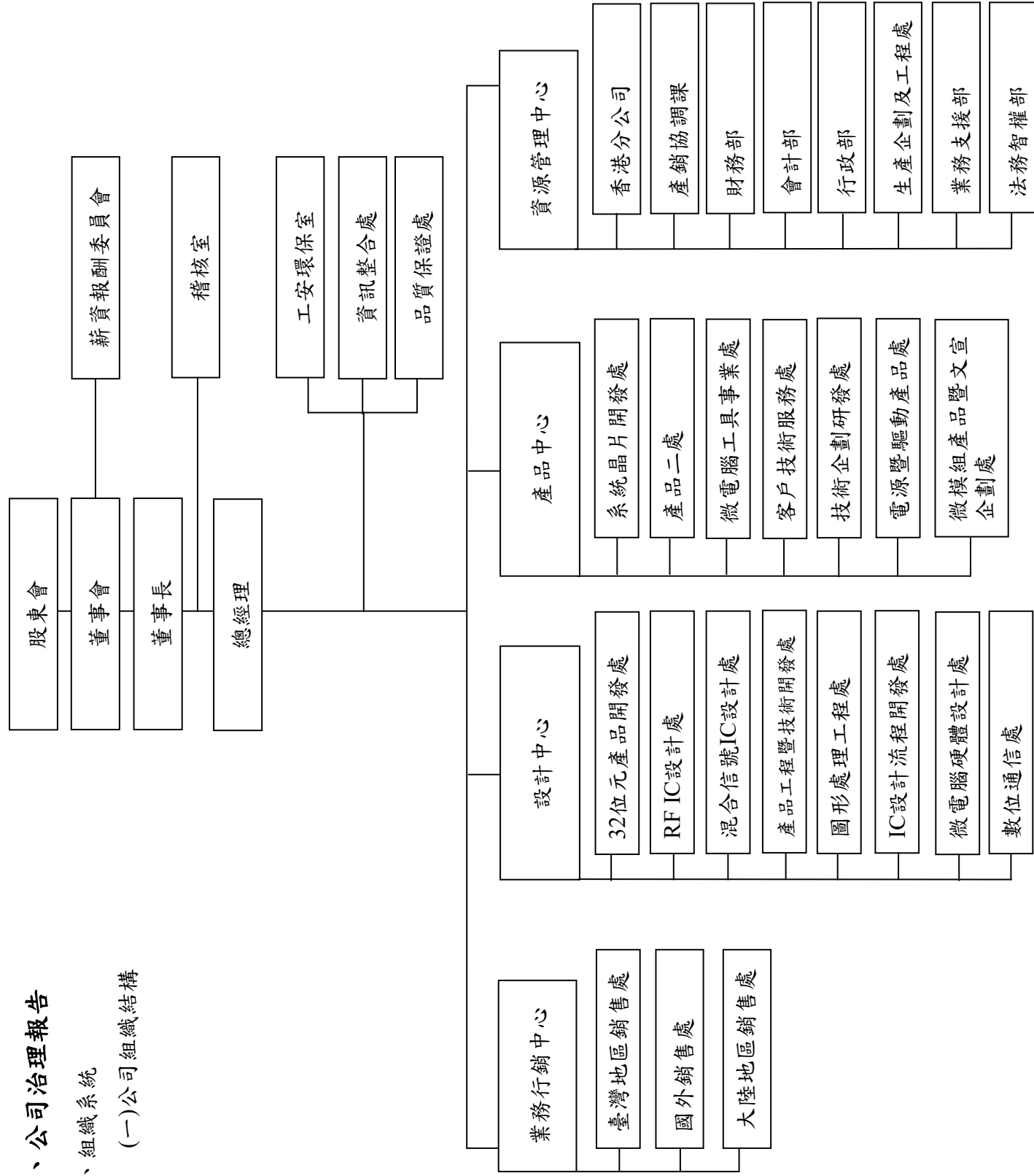
民國八十七年	十月	盛群半導體公司成立，設立實收資本額新台幣四億元。
民國八十八年	三月	現金增資新台幣六億元，實收資本額達新台幣十億元。
民國八十九年	三月	推出公司第一顆符合工業規格等級 8-bit OTP MCU。
	四月	設立香港分公司，從事香港及部份海外地區發貨及倉儲作業。
	五月	經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票公開發行。 通過國際 ISO 9001 品保認證。
民國九十年	三月	設立上海子公司（盛揚半導體（上海）有限公司），從事大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
	五月	設立美國子公司（Holtek Semiconductor (USA), Inc.），從事北美地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
民國九十一年	八月	經財政部證券暨期貨管理委員會核准股票上櫃。
	十月	投資蘇州子公司（金科集成電路（蘇州）有限公司），負責大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
	十一月	股票正式櫃檯買賣。
民國九十二年	七月	通過國際 ISO 14001 環境管理系統驗證。
	八月	取得 SONY "Green Partner" 認證。
	九月	獲頒經濟部第十二屆國家發明獎。
民國九十三年	九月	股票正式上市買賣。
	十二月	GSA 頒發 Outstanding Financial Performance Award。
民國九十四年	六月	取得華碩 "Green Partner" 認證。
	九月	取得經濟部核定在臺設立研發中心計劃。
	十月	取得三星電子 "ECO Partner" 認證。
	十一月	首屆盛群盃 MCU 校園競賽於臺灣地區舉行。
	十二月	取得經濟部核定在臺設立營運總部。
民國九十五年	五月	首屆盛群盃 MCU 校園競賽於大陸地區舉行。
	十一月	通過國際 OHSAS 18001 職業安全衛生管理認證。
民國九十六年	一月	推出公司第一顆符合工業規格等級 8-bit Flash MCU。
	五月	通過 IECQ QC080000HSPM 國際認證。
	十二月	Holtek 無線 USB 語音傳輸晶片 HT82A850R/HT82A851R 榮獲中國電子業界創新大獎。
民國九十七年	二月	投資廈門子公司（芯群集成電路（廈門）有限公司），負責大陸地區 IC 及微控制器應用工具技術支持與諮詢服務。

- 民國九十九年 一月 推出公司第一顆整合型 8-bit Touch Flash MCU。
- 民國一〇〇年 五月 盛揚半導體（上海）有限公司遷移至深圳，更名為盛揚半導體（深圳）有限公司，從事大陸地區 IC 銷售及技術支持服務。
- 六月 推出公司第一顆 ARM Cortex M3 32-bit Flash MCU。
- 七月 取得經濟部核定在臺設立營運總部。
- 十月 推出 Touch Key Flash MCU with LED / LCD Driver。
- 十二月 公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 18 名。
- 民國一〇一年 六月 設立東莞子公司（合泰半導體（中國）有限公司），從事大陸地區 IC 銷售業務及提供技術支持與諮詢服務。
- 十二月 公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 14 名。
- 101 年度新推出產品：
1. Smoke Detector ASSP Flash MCU。
 2. Power Bank ASSP Flash MCU。
- 民國一〇二年 十一月 通過 WPC 聯盟 Qi 標準。
- 十二月 公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 12 名。
- 102 年度新推出產品：
1. 20-bit A/D + LCD Flash MCU。
 2. Blood Pressure Meter ASSP Flash MCU。
 3. Glucose Meter ASSP Flash MCU。
- 民國一〇三年 七月 推出全球最薄 6.5mm 及 4.9mm 光學式指紋辨識系列產品。
- 全球第五家擁有 UL 60730-1（家庭用電器用品安全機制）軟體認證的半導體公司。
- 取得經濟部核定在臺設立營運總部。
- 十一月 無線充電微控制器 IC 取得 WPC 無線充電聯盟 Qi 規格認證。
- 十二月 公司 8-bit MCU 營收佔全球排名第 12 名。
- 103 年度新推出產品：
1. 1.8V~5.5V Flash MCU。
 2. 24-bit A/D LCD Flash MCU。
 3. Wireless Power Transmitter（Qi）ASSP Flash MCU。
 4. Body Fat ASSP Flash MCU。
- 民國一〇四年 三月 獲選第三屆中堅企業潛力企業。
- 十二月 盛群盃 HOLTEK MCU 創意大賽邁入第十屆擴大舉辦。
- 104 年度新推出產品：
1. 全球最薄 1mm，擁有超高解析度且唯一量產的光電混合式指紋辨識感測器。
 2. ARM Cortex-M0+ 之 32 位元 Flash MCU。
 3. Fast Charge Power Bank MCU。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)公司組織結構



(二)各主要部門所營業務

部 門	主要職掌
稽核室	全公司業務及行政之稽核。
工安環保室	工安、消防安全、醫療保健及環境保護等相關事宜。
資訊整合處	(A)規劃及維護公司網路資訊流動環境、硬體設施。 (B)研究開發並建立相關之資訊系統。
品質保證處	進出貨檢驗，外包廠品質監控、評鑑，品質活動推行，儀器校正作業，產品可靠度測試及客訴服務。
臺灣地區銷售處	臺灣地區產品推廣及銷售、Agent/Third party/客戶管理及技術服務。
國外銷售處	海外地區技術引進/情報收集、Agent/Third party/客戶管理、技術支援、產品推廣銷售與服務。
大陸地區銷售處	大陸地區市場開發、市場分析產品行銷及所屬代理商管理。
32 位元產品開發處	(A)32 位元微控制器之相關技術與 IP 之建立。 (B)32 位元微控制器之相關 IC 設計與整合。 (C)通訊與訊號處理相關之技術與 IP 之建立。 (D)通訊與訊號處理相關之 IC 設計與整合。
RF IC 設計處	(A)無線射頻接收機系統設計。 (B)無線射頻接收機 IC 設計、整合和研發。 (C)射頻 IC IP 研發。
混合信號 IC 設計處	(A)Analog IC/IP 技術評估及電路設計。 (B)Memory IC/IP 技術評估及電路設計。 (C)Digital Cell Library/IP 技術評估及電路設計。 (D)Special I/O 電路設計及 ESD/Latch-up Cell 標準化。
產品工程暨技術開發處	(A)靜電防護工程：新製程 ESD 元件/Latch-up Rule 評估、新專案 ESD/System ESD 方案與改善、ESD 元件驗證、測試與使用管制。 (B)產品工程：產品生產良率提升、產品生產製造管理、新製程(含衍生性)產品下線管控、新製程評估與導入、專案產品下線管控、Shuttle 與 MPW 支援。
圖形處理工程處	(A)圖形處理自動化環境及圖形資料庫之建立。 (B)圖形佈局工作。
IC 設計流程開發處	(A)設計工具、設計流程及測試工程等研發環境整合與技術支援。 (B)研發及委外測試技術之協調，並將測試流程導入量產及管理。
微電腦硬體設計處	MCU 產品設計技術之策略規劃及產品設計計劃管理。
數位通信處	數位信號處理器開發、數位信號處理演算法開發、通信系統架構分析與模擬、數位調變/解調技術開發、基頻資料封包處理/鏈結層控制器開發。
系統晶片開發處	(A)影像及音頻訊號處理的系統技術建立與 SOC 開發。 (B)影像及音頻訊號處理的資料儲存與傳輸的相關技術建立。
產品二處	負責 HT8 與 HT8051 8-bit MCU 標準 MCU 與 ASSP MCU 之市場調查、規劃與開發管控、推廣及產品管理。
微電腦工具事業處	專案技術技術開發、新技術評估與導入、工具開發技術評估；客服問題處理、落實改善計畫；實驗室維護管理、零件採購與寄送。
客戶技術服務處	對客戶需求提供技術及產品應用整合工作。

部 門	主要職掌
技術企劃研發處	(A)統籌標準 MCU、嵌入式 MCU、特定產品專用 ASSP MCU 等相關 IC 產品開發技術相關事宜，包含產品系統技術分析、IC 市場與技術開發評估、IC 規格技術企劃、IC 應用驗證、產品系統驗證、產品應用開發、技術文件及後續產品推廣技術服務等事項。 (B)前瞻產品技術之搜尋、關鍵技術研究、關鍵性 IP 建立與提升產品層次及競爭力。
電源暨驅動產品處	(A)電源管理/白光 LED 背光/LED 照明/Motor Driver/ Display 相關產品市場企劃、系統規劃及新產品推廣。 (B)DC-DC PWM Buck Regulator、Boost Regulator、AC-DC Converter IC 設計開發及產品驗證。 (C)VFD/LED/LCD Display Controller/Driver IC 規格制定、設計開發、產品驗證及軟硬體技術支援。
微模組產品暨文宣企劃處	(A)產品企劃：市場訊息與相關微模組產品企劃及規格書產出。 (B)應用文件品管、技術文件編譯、產學文宣企劃。
香港分公司	從事香港及部份海外地區發貨及倉儲業務。
產銷協調課	(A)產銷協調，訂單交期及訂單監控。 (B)配貨出貨及貨源調配安排。
財務部	資金管理、客戶信用管理、進出口保稅業務、股務及投資人關係相關作業處理。
會計部	會計帳務處理、預算管理、轉投資管理及財務報表分析。
行政部	人事、教育訓練、總務、採購及員工福利等相關事務。
生產企劃及工程處	統籌委外採購及封裝/測試委工、倉儲/物流管理、工具製造、封裝/測試工程等作業事宜。
業務支援部	產品庫存之調節管理、業務資訊分析及產品訂價與成本管理。
法務智權部	法律事務、智慧財產權建立與維護及各項諮詢服務。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料

日期：105 年 3 月 29 日 單位：股

職稱	國籍或 註冊地	姓名	選就任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人		
						股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	吳敏勇	1020611	1020611~ 1050610	870907	7,635,809	3.41%	7,665,809	3.39%	2,745,598	1.21%	-	-	逢甲大學電子工程系 盛群公司董事長	盛群公司董事長 Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、 Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.、 Bestcomm RF Electronics Inc等公司之法人董 事代表人、盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、 合泰半導體(中國)、盛通科技、優方科技等公 司之董事長	無	-	-
董事	中華民國	高國棟	1020611	1020611~ 1050610	870907	6,671,176	2.98%	6,701,176	2.96%	-	-	-	-	華夏專電子工程科 盛群公司總經理	盛群公司總經理 Kingtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、盛凌投資、 芯群集成電路(廈門)、合泰半導體(中國)、盛通科技 等公司之法人董事代表人、金科集成電路(蘇州)有限 公司董事長	無	-	-
董事	中華民國	張 治	1020611	1020611~ 1050610	930601	1,171,785	0.52%	1,111,785	0.49%	354,389	0.16%	-	-	成功大學電機所 盛群公司設計及產品中心執行副總	盛群公司設計及產品中心副總經理 金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)公 司之法人董事代表人	無	-	-
董事	中華民國	林正鋒	1020611	1020611~ 1050610	870907	1,802,697	0.81%	1,842,697	0.81%	290,513	0.13%	-	-	逢甲大學電子系 盛群公司總經理室副總經理	盛群公司總經理室副總經理 Sigmus Holdings Ltd.、MCU Holdings Ltd.、香 港新榮、新緯科技(深圳)公司之法人董事代表 人	無	-	-
董事	中華民國	李佩榮	1020611	1020611~ 1050610	990615	996,843	0.45%	1,013,093	0.45%	630	0.00%	-	-	加州大學河濱分校企管所 盛群公司資源管理中心副總經理	盛群公司資源管理中心副總經理 Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、 Sigmus Holdings Ltd.、MCU Holdings Ltd.、盛 凌投資、Sanitek Holdings Ltd.、新禾(廈門)電 子、Newtek Electronics Ltd.、新鼎電子(深圳)、 Truetek Technology Ltd.、信霖電子商貿(上 海)、E-Micro Technology Holding Ltd.、振揚電 子(青島)、New Wave Electronics Holding Ltd.、 Crown Rich Technology Holding Ltd.、華瑞昇 電子(深圳)、Forte Electronics Holding Ltd.、華 榮匯電子(北京)、Quanding Technology Holding Ltd.、全鼎電子(蘇州)、Imnotek Electronics Inc.、Bestway Electronics Inc.、金 高利、液達科技、鈺威科技、欣宏電子、金 信科技、Bestcomm RF Electronics Inc.、盛通 科技、Best Solution Electronics Inc.、優方科技、 Fire Chip Electronics Inc.、健芳電子科技上 海)、Archip Technology Corporation、嘉芯安 科技(深圳)、金科集成電路(蘇州)及合泰半導 體(中國)等公司之法人董事代表人、芯群集成 電路(廈門)、天宇微機電等公司之法人監察人 代表人、金科集成電路(蘇州)有限公司總經理	無	-	-

職稱	國籍或 註冊地	姓名	選就任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人	
						股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名
獨立 董事	中華民國	呂正榮	1020611	1020611~ 1050610	910417	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學會計研究所 亞東聯合會計師事務所合夥會計師	亞東聯合會計師事務所合夥會計師 元根企業(股)公司之獨立董事	無	-
獨立 董事	中華民國	邢智田	1020611	1020611~ 1050610	930601	-	-	-	-	-	-	-	-	美國佛羅里達大學電機機博士 廣達電腦(股)公司資深副總暨廣達 研究院院長	波若威科技(股)公司之獨立董事	無	-
監察人	中華民國	王仁宗	1020611	1020611~ 1050610	930601	3,635,209	1.63%	2,137,209	0.94%	1,500,000	0.66%	-	-	清華大學科管所	金信科技、定耀科技等公司之法人董事代表 人、超豐電子(股)公司之法人監察人代表人、 崧智科技(股)公司監察人	無	-
監察人	中華民國	林嘉茂	1020611	1020611~ 1050610	870907	3,992,104	1.79%	2,492,104	1.10%	2,283,003	1.01%	-	-	輔仁大學數學系	無	無	-
監察人	中華民國	新耕投資 有限公司 代表人： 周吟娜	1020611	1020611~ 1050610	990615	368,884	0.16%	368,884	0.16%	-	-	-	-	不適用	不適用	無	-
			1020611	1020611~ 1050610	990615	91,363	0.04%	91,363	0.04%	-	-	-	-	東吳大學國貿系	優方科技、欣宏電子、金信科技等公司之法 人監察人代表人、定耀科技(股)公司之監察人	無	-

(二)法人股東之主要股東

日期：105 年 3 月 29 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東(註)	法人股東之主要股 東其持股比例(%)
新耕投資有限公司	陳 芎	20.00
	張麗瓊	20.00
	許瑞茹	20.00
	李玉琴	20.00
	林正亮	20.00

註：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

(三)董事及監察人所具專業知識及獨立性情形

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註）										兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數
		商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
吳啟勇			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
高國棟			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
張 治			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
林正鋒			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
李佩縈			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
呂正樂			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
邢智田			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
王仁宗			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
林嘉茂			✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
新耕投資有限公司 代表人:周玲娜			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(四)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

日期：105 年 3 月 29 日 單位：股

職 稱	國 籍	姓 名	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司 之職務	具配偶或二親等 以內關係之經理 人		
				股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係
總經理	中華民國	高國棟	87/10/01	6,701,176	2.96%	-	-	-	-	華夏工專電子工程科	Kingtek Semiconductor Holding (BV) Ltd、盛凌投資、芯群集成電路(廈門)、合泰半導體(中國)、盛通科技等公司之法人董事代表人、金科集成電路(蘇州)有限公司董事長	無	-	-
設計及產品中心 執行副總	中華民國	張 治	87/12/11	1,111,785	0.49%	354,389	0.16%	-	-	成功大學電機所	金科集成電路(蘇州)、芯群集成電路(廈門)公司之法人董事代表人	無	-	-
總經理室 副總經理	中華民國	林正鋒	87/12/11	1,842,697	0.81%	290,513	0.13%	-	-	逢甲大學電子系	Sigmos Holdings Ltd、MCU Holdings Ltd、香港新榮、新緯科技(深圳)公司之法人董事代表人	無	-	-
資源管理中心 副總經理	中華民國	李佩榮	92/01/06	1,013,093	0.45%	630	0.00%	-	-	加州大學河濱分校企管所	Holtek Semiconductor Holding (BV) Ltd、Sigmos Holdings Ltd、MCU Holdings Ltd、盛凌投資、Sanitek Holdings Ltd、新禾(廈門)電子、Newtek Electronics Ltd、新鼎電子(深圳)、Truetek Technology Ltd、信霖電子商貿(上海)、E-Micro Technology Holding Ltd、振揚電子(青島)、New Wave Electronics Holding Ltd、Crown Rich Technology Holding Ltd、華瑞昇電子(深圳)、Fortic Electronics Holding Ltd、華榮匯電子(北京)、Quanding Technology Holding Ltd、全鼎電子(蘇州)、Innotek Electronics Inc、Bestway Electronics Inc、金濤高科、宏達科技、鉅威科技、欣宏電子、金浩科技、Bestcomm RF Electronics Inc、盛通科技、Best Solution Electronics Inc、優方科技、Fine Chip Electronics Inc、健芳電子科技(上海)、Anchip Technology Corporation、嘉芯安科技(深圳)、金科集成電路(蘇州)及合泰半導體(中國)等公司之法人董事代表人、芯群集成電路(廈門)、天字微機電等公司之法人監察人代表人、金科集成電路(蘇州)有限公司總經理	無	-	-
品質保證處協理	中華民國	吳紹萴	92/06/23	130,845	0.06%	10,080	0.00%	-	-	東海大學物理系	無	無	-	-
設計中心協理	中華民國	吳德傳	94/04/15	1,270,317	0.56%	-	-	-	-	成功大學電子研究所	無	無	-	-
產品中心協理	中華民國	王鈺鈿	98/07/01	185,393	0.08%	-	-	-	-	成功大學電機所	無	無	-	-
業務行銷中心 協理	中華民國	蔡榮宗	99/06/15	292,684	0.13%	206,580	0.09%	-	-	逢甲大學自動控制系	欣宏電子公司之法人董事代表人及合泰半導體(中國)公司之總經理	無	-	-
產品中心協理	中華民國	王明坤	100/04/01	193,349	0.09%	-	-	-	-	臺灣技術學院電子系	無	無	-	-
設計中心協理	中華民國	余國成	100/05/02	131,654	0.06%	29,839	0.01%	-	-	逢甲大學電子系	無	無	-	-
會計部門主管	中華民國	李文德	101/08/01	9,049	0.00%	-	-	-	-	中正大學國際經濟學系	無	無	-	-

三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)董事(含獨立董事)之酬金

日期：104 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例(註 11)		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例(註 11)	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註 12)						
		報酬(A) (註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註 3)		業務執行費用(D)(註 4)		薪資、獎金及特支費等(E)(註 5)		退職退休金(F)				員工酬勞(G)(註 6)		員工認股權憑證得認購股數(H)(註 7)		取得限制員工權利新股股數(I)(註 13)	
		本公司	財務報告內所有公司(註 8)	本公司	財務報告內所有公司(註 8)	本公司	財務報告內所有公司(註 8)	本公司	財務報告內所有公司(註 8)	本公司	財務報告內所有公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 8)				本公司	財務報告內所有公司(註 8)	本公司	財務報告內所有公司(註 8)		
												現金金額	股票金額							現金金額	股票金額
董事長	吳啟勇	0	0	0	9,097	0	0	13,265	0	6,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
董事	高國棟																				
董事	張 治																				
董事	林正鋒	0	0	0	9,097	0	0	13,265	0	6,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
董事	李佩縈																				
獨立董事	呂正樂																				
獨立董事	邢智田																				

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名				
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)		
	本公司(註 9)	財務報告內所有公司 (註 10)I	本公司(註 9)	財務報告內所有公司 (註 10)J	
低於 2,000,000 元	吳啟勇、高國棟、張治、林正鋒、李佩縈、呂正樂、邢智田	吳啟勇、高國棟、張治、林正鋒、李佩縈、呂正樂、邢智田	呂正樂、邢智田	呂正樂、邢智田	
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	吳啟勇、高國棟	吳啟勇、高國棟	
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	張治、林正鋒、李佩縈	張治、林正鋒、李佩縈	
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
100,000,000 元以上	—	—	—	—	
總計	7	7	7	7	

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者，應填列本表及下表。

註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。

註 8：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註 9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 11：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 12：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、所領取之酬金，併入酬金級距表之「J」欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

註 13：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數，尚應填列附表十五之一。

(二)監察人之酬金

日期：104 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三項總額占稅後純益之比例(註 8)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註 9)
		報酬(A)(註 2)		酬勞(B)(註 3)		業務執行費用(C)(註 4)				
		本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	
監察人	王仁宗	0	0	1,795	1,795	0	0	0.22%	0.22%	0
監察人	林嘉茂									
監察人	新耕投資有限公司 代表人：周玲娜									

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司(註 6)	財務報告內所有公司(註 7)D
低於 2,000,000 元	王仁宗、林嘉茂 新耕投資有限公司代表人：周玲娜	王仁宗、林嘉茂 新耕投資有限公司代表人：周玲娜
2,000,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	3	3

註 1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。

註 2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之監察人酬勞金額。

註 4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等)。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司監察人於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表 D 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」

c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

(三)總經理及副總經理之酬金

日期：104 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)(註 2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)(註 3)		員工酬勞金額(D)(註 4)				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例(註 9)		取得員工認股權憑證數額(註 5)		取得限制員工權利新股股數(註 11)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註 10)
		本公司	財務報告內所有公司(註 6)	本公司	財務報告內所有公司(註 6)	本公司	財務報告內所有公司(註 6)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司(註 6)	本公司	財務報告內所有公司(註 6)	本公司	財務報告內所有公司(註 6)	
董事長	吳啟勇	10,535	10,535	0	0	2,730	2,730	6,371	0	6,371	0	2.43%	2.43%	0	0	0	0	0
總經理	高國棟																	
副總經理	張治																	
副總經理	林正鋒																	
副總經理	李佩縈																	

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註 7)	財務報告內所有公司(註 8)E
低於 2,000,000 元	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	吳啟勇、高國棟、張 治 林正鋒、李佩縈	吳啟勇、高國棟、張 治 林正鋒、李佩縈
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	5	5

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。

註 6：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 9：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

註 11：係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

日期：104 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
經 理 人	董事長	吳啟勇	0	13,724	13,724	1.70%
	總經理	高國棟				
	設計中心副總經理	張 治				
	總經理室副總經理	林正鋒				
	資源管理中心副總經理	李佩縈				
	品質保證處協理	吳紹藩				
	設計中心協理	吳德傳				
	產品中心協理	王鈺鈿				
	業務行銷中心協理	蔡榮宗				
	產品中心協理	王明坤				
	設計中心協理	余國成				
	會計部經理	李文德				

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

(五)比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

職 稱	支付酬金總額占個體財務報告稅後純益比例	
	103 年	104 年
董事	3.52%	3.56%
監察人	0.22%	0.22%
總經理及副總經理	2.39%	2.43%

1.董事及監察人酬金給付政策及訂定酬金之程序：本公司股利政策擬於 105 年 5 月 27 日送股東常會通過修訂公司章程案

本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一，五為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

由薪資報酬委員會討論依各董監事執行業務程度於上述金額內分配董事及監察人酬金，再提交董事會決議。

2.總經理及副總經理酬金給付政策及訂定酬金之程序

(1)本公司訂有人事薪資制度，總經理及副總經理之薪資依公司制度由人事單位予以考核，並送交總經理室會議中予以評定，並呈送薪資報酬委員會討論通過提交董事會決議，人事薪資制度參考因素主要為執行業務內容、經歷與績效及貢獻度，其中尤以績效及貢獻度為著。

(2)本公司章程規定年度分派員工酬勞，員工酬勞之分配由人事單位制定之分配辦法作業，該辦法參考因素主要為職務內容、績效及未來貢獻度，尤以績效及未來貢獻度比重最大，送交總經理室會議中予以評定。

(3)上述之總經理、副總經理及協理級經理人之薪資及員工酬勞於總經理室會議中予以核定後，呈薪資報酬委員會討論通過並提交董事會決議。

3.給付酬金與經營績效及未來風險之關聯性

(1)董事酬勞係依據在本公司擔任之職位及對本公司營運參與程度及貢獻之價值核發。

(2)總經理及副總經理之酬金，係依據職位、對公司的貢獻度及參考同業水準，依本公司人事規章辦理。

已將經營績效時所需考量未來風險發生之可能性及關聯性減至最低，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以落實風險與報酬之管理平衡。

四、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：104 年度董事會開會 6 次，董事監察人出席情形如下

職稱	姓名(註 1)	實際出(列) 席次數	委託出 席次數	實際出(列)席 率(%(註 2))	備 註
董 事 長	吳啟勇	6	0	100%	
董 事	高國棟	6	0	100%	
董 事	張 治	5	1	83%	
董 事	林正鋒	6	0	100%	
董 事	李佩榮	6	0	100%	
獨 立 董 事	呂正樂	6	0	100%	
獨 立 董 事	邢智田	5	1	83%	
監 察 人	王仁宗	6	0	100%	
監 察 人	林嘉茂	6	0	100%	
監 察 人	新耕投資有限公司 代表人：周玲娜	6	0	100%	

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

1. 本公司訂有「董事會議事規則」、「董事會績效評估辦法」及設立獨立董事，以提升董事會運作效能。
2. 獨立董事每月定期覆核內部稽核單位提供之稽核報告，實際掌握公司運作情形。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(二)監察人參與董事會運作情形：104 年度董事會開會 6 次，監察人出席情形如下

職稱	姓名	實際列席次數	實際出席率(%)(註)	備註
監察人	王仁宗	6	100%	
監察人	林嘉茂	6	100%	
監察人	新耕投資有限公司 代表人：周玲娜	6	100%	

其他應記載事項：

一、監察人之組成與職責：

(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形：本公司監察人如認為有必要時，可隨時與員工及股東直接溝通。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：本公司監察人經常列席董事會監督公司經營狀況，每月定期覆核內部稽核單位提供之稽核報告，實際掌握公司運作情形，並於每季審閱經會計師查核或核閱之簽證報告。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。

註：

- (1) 年度終了日前有監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有監察人改選者，應將新、舊任監察人均予以填列，並於備註欄註明該監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際列席率(%)則以其在職期間實際列席次數計算之。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之「公司治理實務守則」，並已於本公司網站與公開資訊觀測站揭露相關內容。	與公司治理實務守則相符。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 1.本公司依照公司法及相關法令規定召集股東會，並制定完備的股東會議事規則，給予股東適當的發言機會，股東對議案有異議時可充分表達意見，並採取票決方式決議。 2.本公司重視股東知的權利，除確實遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務及內部人持股情形，即時以公開資訊觀測站之資訊系統提供訊息予股東。 3.為確保股東權益，本公司設有發言人制度及專責投資人關係人員處理股東建議、疑義及糾紛事項，並於本公司外部網頁充分揭露聯繫方式，股東均可反應意見，並獲妥善處理。 4.為降低公司訴訟風險及成本，並確保股東權益，本公司內部設有專職法務單位，並聘請外部專業法律顧問，依內部處理程序處理法務訴訟相關事宜。	(一)與公司治理實務守則相符。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及	V		(二)本公司依證交法第25條規定，對內部人(董事、	(二)與公司治理實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
主要股東之最終控制者名單？			監察人、經理人及持有股份超過總額10%之股東)所持股權之變動情形，按月申報公開資訊觀測站，以掌握實際控制公司的主要股東及主要股東之最終控制者名單，以確保經營之穩定。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 1.本公司內部控制涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之營運活動，並訂有「對子公司之監理辦法」，落實對子公司風險控管機制。 2.本公司訂有「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」，與關係企業間之人員、資產及財務管理權責均清楚劃分，有業務往來者，本於公平合理原則，並建立健全之財務、業務及會計管理制度，往來之客戶及廠商妥適進行風險評估，實施必要的控管機制，建立適當的防火牆，及訂定相關的內部控制制度。 3.本公司設有專責單位每月定期檢查及監督各關係企業的營運循環及財務作業，確認關係企業運作正常且風險皆在本公司可控制範圍。 (四)本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則營守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並告知公司內部人不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。	(三)與公司治理實務守則相符。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)本公司已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則營守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，並告知公司內部人不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。	(四)與公司治理實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否成就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V	(一) 1.本公司董事會考量公司經營發展規模及主要股東持股情形，目前設置董事七人之適當董事席次，其中有一席為女性董事，二席為獨立董事並具備財務及產業相關專業資格。 2.本公司董事成員除二席獨立董事具有電子產業專業及財金專業外，其他五席董事亦為在電子產業擁有二十年以上專業，分別針對產品開發、市場推廣、供應鏈管理、財務會計、內部控制等，分別擬訂公司目標及計劃，並每月/每季檢查是否落實計畫目標。 3.本公司董事均慎盡職守，對於公司業務之執行，除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外，確實依董事會決議為之。	(一)與公司治理實務守則相符。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V	(二) 1.本公司已設置薪資報酬委員會，並將於105年度股東常會通過設置審計委員會。 2.嗣後將視法令規定及營運需要決定是否設置其他功能性委員會。	(二)與公司治理實務守則相符。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？	V	(三) 1.本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，每年12月底進行當年度董事會及薪酬委員會之績效評估，董事會及功能性委員會績效評估應函括下列五	(三)與公司治理實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	大面向：(1)對公司營運之參與程度。(2)提升董事會決策品質。(3)董事會組成與結構。(4)董事的選任及持續進修。(5)內部控制。並將其績效評估結果於次一年度送交董事會報告。 2.104年度董事會評估結果為董事會運作良好，董事會是否建置適當且足夠之功能性委員會，將適時依公司實際運作來設置。 3.104年度薪酬委員會於執行董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性，其評估結果為運作良好。 (四) 1.本公司每年定期審酌簽證會計師之專業資格及獨立性，連同會計師出具未違反獨立性之聲明函，提報董事會評估之。 2.本公司經董事會評估簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺及游萬淵會計師無違反職業道德規範公報第十號所規定之情事，二位會計師除簽證相關費用外，未擔任本公司之董監事、經理人或重大影響之職務，亦無其他財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，符合獨立性及適任性條件。	
			(四)與公司治理實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V	1. 本公司與股東、往來銀行、員工、客戶、供應商或利益相關者，保持暢通之溝通管道，並尊重及維護其應有的合法權益。 2. 本公司設有投資人關係專責單位，提供股東及投資人公司相關資訊及溝通管道。 3. 本公司對於往來銀行提供充足的資訊及財務報表，以便其瞭解公司的經營及財務狀況。 4. 本公司透過各種管道鼓勵員工與管理階層溝通，適度反映員工對公司之意見。 5. 本公司與客戶及供應商保持長期良好的合作關係，每月定期檢討往來情況，增進合作默契。 6. 本公司致力於經營發展及實現股東利益最大化，並關注消費者權益、社區環保及公益等議題，並投入人力經費以加強產學合作及社會職能訓練，重視公司之社會責任。 7. 已於本公司網站建立各利害關係人溝通管道-各專責人及電話、e-mail。	與公司治理實務守則相符
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		與公司治理實務守則相符
六、資訊公開			
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一)與公司治理實務守則相符。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設	V		(二)與公司治理實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？		1.本公司定期更新公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊的蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。 2.本公司設有投資人關係專責人員負責公司資訊之蒐集及揭露，且依規定設有發言人及代理發言人，並已將相關財務資訊、重要新聞訊息與「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「薪資酬勞委員會組織章程」、「公司治理守則」、「誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」等資訊於公司外部網站揭露。 3.本公司每季定期召開法人說明會，並將相關資料及法說會現場影片放置於公開資訊觀測站及公司網站中，並提供投資人查詢公司營運及財務資訊。	
七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	V		與公司治理實務守則相符

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
			法充分揭露公司營運各項訊息，設有發言人制度及專責投資人關係人員處理股東權益之各項事務，並以提升營運績效及股東權益報酬率為長期目標。 4.供應商關係： (1) 本公司之主要供應商均為國內外知名大廠，往來信用良好，並重視與供應商建立長久之合作關係。 (2) 本公司亦注重供應商本身是否符合國際環保規定及勞工安全衛生規範，致力於綠色供應鏈之建立。 5.利害關係人之權利：本公司對利害關係人之權利，保持良好之溝通管道，並尊重維護其應有之合法權益。 6.董事及監察人進修之情形：本公司每年規劃相關課程，提供董事、監察人進修，以加強專業知識及實務運作，董監事進修情形請參閱第46頁。 7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司訂定內部控制制度並有效執行，其中，財務風險管理：(1)信用風險：主要往來銀行、客戶及供應商適時辦理風險評估，以降低信用風險；(2)流動性風險：企業剩餘資金之運用，首重金融投資商品是否為低風險性及高流動性，其次方追求合理之收益率。另，有關營運風險管理：(1)銷售分散：

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
		透過銷售分散可防止客戶因惡性破產而受影響； (2)智慧財產權保護：有關專利之文件均依「機密文件」管理規定，不得擅自攜帶外出或轉借；調閱時須經過調閱及保管部門主管核准後始得調卷。資訊安全風險管理：(1)各項重要資料、檔案皆定期資料備份，且電腦程式設計測試、使用及維護均制定嚴密之作業管制流程；(2)對外營運之資訊系統已建構完善安全防護系統防範駭客非法攻擊，並建置多組輔助及替換電腦設備，以降低資訊系統中斷風險。 8.客戶政策之執行情形： (1)本公司以長期穩健經營為原則，重視國內外客戶之長期合作關係，提供最具競爭力的產品及服務予客戶，重視客戶應有之權益，並定期審視客戶與本公司間之往來業務及信用狀況，創造雙贏局面。 (2)本公司配合客戶需求，提供各式環保標章證明及勞安衛證書，並協助客戶取得市場推廣所需認證及供貨保障。 9.公司為董事及監察人購買責任保險之情形： 本公司董事及監察人之選任資格皆符合公司法等相關法令規定，皆為具有豐富商務、財務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗或專業資格之人士，目前雖未有購董事及監察人之責任保險，但	

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
		每月定期評估公司營運狀況及風險，因公司營運正常且資金充裕，並未有對外融資之情事，另聘請法律顧問提供法務協助，未來將視實際情況或依相關法令規定辦理。	
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告？（若有，請敘明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形）（註2）	V	1.本公司依規定至證基會網站完成第二屆公司治理評鑑系統-自評作業。 2.本公司除確實辦理內部控制制度之自行檢查作業外，董事會及管理階層均至少每季檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告，並由監察人關注及監督之。 3.針對自評作業未能達成之項目，本公司已進行持續改善中，期許自評成績逐年進步。	與公司治理實務守則相符

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註2：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。

(四)薪酬報酬委員會之組成、職責及運作情形

(1)薪資報酬委員會成員資料

身份別 (註1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註2)								兼任其他 公開發行公司 薪資報酬委員會 成員家數	備註 (註3)
		商務、法 務、會計 或公司業 務所需相 關料系之 公私立大 專院校講 師以上	法官、檢察 官、律師、會 計師或其他 與公司業務 所需之國家 考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員	具有商 務、法 務、財 務、會計 或公司 業務所 需之工 作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立 董事	呂正樂		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
獨立 董事	邢智田			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
其他	蔡英雄			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8)未有公司法第30條各款情事之一。

註3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
2. 本屆委員任期：102 年 6 月 11 日至 105 年 6 月 10 日，104 年度薪資報酬委員會開會 4 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席次 數	實際出席率(%) (註)	備註
召集人	邢智田	4	0	100%	
委員	呂正樂	4	0	100%	
委員	蔡英雄	4	0	100%	
其他應記載事項： 一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無，董事會全數採納薪資報酬委員會之建議。 二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無，薪資報酬委員會之各項決議事項，所有委員全數通過。					

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五)履行社會責任情形

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、落實公司治理 (一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？	V	(一) 本公司已訂定「企業社會責任實務守則」，並由專職人員隨時注意國內與國際企業社會責任制度之發展及企業環境之變遷，據以檢討改進公司所建置之企業社會責任制度，以提升履行企業社會責任成效，具體推動計畫如下： 1. 人才培育：推動台灣/大陸地區之盛群大學計畫-聯合實驗室的建立與教學師資培育及辦理「盛群盃MCU創意競賽」，包括補助學校相關課程及實驗室經費、定期舉辦全國性校園競賽、與全國各中心職訓局及訓練機構合作，提供經費辦理電子相關課程，以帶動資通訊產業及電子產業之人才培育。 2. 促進經濟：本公司發展策略鎖定以家電、醫療、金融與汽車領域為發展市場，並經由專注研發高品質微控制器開拓國際市場，優異的產品品質與快速的在地服務，不但滿足全球客戶的需求，亦已成功地將HOLTEK微控制器順利導入全球著名家電大廠，建立起HOLTEK全球化的專業品牌形象。 3. 環境永續：本公司為純IC設計廠商，為求環境之保護及永續發展，通過ISO9001、ISO14000及	(一)與企業社會責任實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			OHSA08000之相關規範及認證，本公司承諾奉行以下原則，持續改善以提昇環境管理成效： (1)符合政府環保法規及客戶對環境禁用物質之要求，採用符合國際環保要求的原物料。 (2)致力研發綠色設計之產品，並發展/使用低汙染之原物料，以降低對環境之衝擊。 (3)節約能源，回收及有效裡用能源，並預防污染。 (4)宣導環保觀念，提升員工及供應商之環保意識及能力。
(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？	V		(二)與企業社會責任實務守則相符。
(三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	V		(三)與企業社會責任實務守則相符。
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？	V		(四)與企業社會責任實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
二、發展永續環境 (一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	(一)本公司為純IC設計公司，並無設置製造工廠，仍以污染預防及持續改善為發展基本架構，研發節能省碳之綠色概念產品及改善製程技術降低環境衝擊，符合法規要求及其他相關要求事項，並落實環保教育，確實執行資源回收，珍惜水資源，進行良好環境溝通，並訂有IECQ QC080000有害物質流程管理系統，符合國際規範，維護美好地球。	(一)與企業社會責任實務守則相符。
(二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V	(二) 1.本公司已取得國際ISO9001品保認證，將產品開發及供應之品質系統，持續落實執行。 2.本公司設有專責單位負責致力推動ISO14001環境管理系統的持續改善，秉持企業永續發展之經營理念。 3.本公司要求合作之所有供應商必須取得ISO9001品保認證及ISO14001環保認證，共同推動永續發展合適的環境。	(二)與企業社會責任實務守則相符。
(三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？	V	(三) 本公司為推動節能減碳，預計105年節省5%電力及水費，其執行措施如下： 1.辦公室節能措施： (1)隨季節開關空調及設定恆溫於26度，以減低電費，且對員工宣導管理之下，公司同仁也做到隨手關閉電腦、空調與照明電源。	(三)與企業社會責任實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			(2)辦公室之照明燈光將以LED取代鹵素燈,既能降低燈源發熱量,並達到節能目的。 2.電腦機房節能措施:推行伺服器虛擬化,節省電力及相關設備。 3.省水措施:給水裝置全部加裝變頻器以穩定水壓,公共洗手間也使用感應式水龍頭,控制用水量可達35%,已有效減少不必要的水資源浪費。 4.其他: (1)持續推動文件管理電子化系統,減少紙張使用量。 (2)確實執行廢棄物如廚餘、空碳粉匣、鐵鋁玻璃罐、廢紙與保特瓶等的回收管理與資源分類,並由專業人員負責廢棄物的處理與分類。
三、維護社會公益 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序?	V		(一)與企業社會責任實務守則相符。 (一) 1.本公司依照勞動及相關法規制定各項符合法規之制度與措施,以保障員工之各項權益。 2.本公司遵守安衛法令規章要求,落實安全衛生作業準則,並實施安衛訓練溝通宣導,推行全員預防認知責任。 3.本公司確保員工職場安全衛生,提供安全衛生設施環境,及建立安衛稽核審查制度,承諾推行持續改善活動。 4.本公司重視員工權益,除設有職工福利委員會定期舉辦各項活動及提供各項補助外,同時設有醫

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二)公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？	V	務休息室、餐廳、員工工休閒活動區、韻律教室、健身運動器材區，辦理員工及眷屬團體保險，聘僱專業醫護人員定期舉辦員工健康檢查及提供即時醫療服務等相關福利措施。 (二) 1.本公司設有內部電子信箱、部門會議等管道供同仁與各級主管做雙向的意見表達及溝通，並設置行政部專職人員，提供員工暢通的申訴管道。 2.本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信或違反兩性工作平等法等違法行為時，應即刻查明相關事實，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 3.本公司對於已發生之不誠信或違法行為，將責成相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。 4.本公司專責單位將不誠信或違法行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。 (三)本公司於2006年取得國際OHSAS18001職業安全衛生管理認證，並推動各項員工安全衛生業務的持續改善活動，包括安全衛生相關訓練，創造優良的工作環境，並保護員工身心健康與安全，詳細說明請參閱本年報第84頁~第85頁。 (四)	(二)與企業社會責任實務守則相符。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V	(三)與企業社會責任實務守則相符。	(三)與企業社會責任實務守則相符。
(四)公司是否建立員工定期溝通之機制，並	V	(四)與企業社會責任實務守則相符。	(四)與企業社會責任實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？		1.本公司設有內部電子信箱、部門會議等管道供同仁與各級主管做雙向的意見表達及溝通，並設計相關訓練課程，提供員工自我成長。 2.本公司管理制度或營運模式有重大變動時，將召開說明會向員工說明，並設置專職單位回答員工之疑問，讓員工充分瞭解公司制度規章。	
(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	(五)本公司對人才的培育一直不遺餘力，除編列預算供員工在外進修外，並由教育訓練委員會、行政部及部門主管針對公司發展目標及各部門需求設計內部訓練課程，讓每位員工在完整的工作生涯培訓體系下成長，詳細說明請參閱本年第82頁~第83頁。	(五)與企業社會責任實務守則相符。
(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V	(六) 1.本公司重視產品品質，並訂有「客戶滿意度作業規範」、「客戶抱怨處理規範」及「客戶退貨處理規範」等作業程序，並且在公司網站設置客戶服務專區，達到盡速解決並處理客戶申訴問題之目標。 2.為符合國際規範，本公司於研發、採購及生產流程均嚴格遵守相關安全、環保及勞工保護規範，以確保本公司出貨的產品，維護客戶的權益。	(六)與企業社會責任實務守則相符。
(七)對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？	V	(七)本公司產品遵循國際環保法規，符合歐盟ROHS與REACH的要求，並在產品包裝上有明確標示，以確保產品不含有傷害人體的有害物質。	(七)與企業社會責任實務守則相符。
(八)公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？	V	(八) 1.本公司與他人建立商業關係前，應先行瞭解代理	(八)與企業社會責任實務守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。
			2.本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。
			3.本公司人員應避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。
(九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	V		(九)與企業社會責任實務守則相符。
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	V		(一)與企業社會責任實務守則相符。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司為善盡企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，訂有「企業社會責任實務守則」，主要運作重點如下：			

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務 守則差異情形及原因
	是	否	
(一)落實公司治理：依據公司治理守則及誠信經營守則辦理各項工作。 (二)發展永續環境：注重生態環境保護與資源有效利用，並落實於實際運作上。 (三)維護社會公益：保障員工權益與創造良好的工作環境，並關心社區發展與消費者權益。 (四)加強企業社會責任資訊揭露：充份揭露相關資訊於年報及公司網站。			
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：			
(一)本公司為IC設計公司，並無製程或生產設備，故無空氣污染及廢水問題；至於一般事業廢棄物之處理，本公司設有資源回收專區，並交由合格廠商回收；對於有害之事業廢棄物，本公司亦設有專區處理，再委託合格之甲級清除商代為處理。 (二)本公司委託晶圓代工及封裝測試業務之供應商，均嚴格要求往來的供應商亦需取得相關品保及環境標準章規定，並定期稽核所有供應商是否持續落實相關規定。 (三)本公司注重員工之工作環境安全及身心健康，並保障員工之工作權益，以及重視員工工作技能之訓練與提昇能力，提供員工安心工作健康無虞的環境。			
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：本公司尚未出具企業社會責任報告書。			

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註2：公司已編製企業社會責任報告書者，摘要說明得以註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一)與公司誠信經營守則相符。
(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？	V		(二)與公司誠信經營守則相符。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	V		3.本公司透過內部稽核制度，並於每月定期審核所有業務/財務/人事資訊，建立嚴謹的防範制度，防止不誠信行為發生。 (三) 1.本公司之帳戶進出均有專人隨時監控，不會有外帳或保留秘密帳戶，亦俾確保公司內部有牽涉行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形時，利用糾正或檢舉違反廉潔守則情事，維護同仁、公司及股東權益之行為。 2.收受不正當利益之處理程序：本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益時，若有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理： (1) 提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起三日內，陳報其直屬主管，並知會行政部。 (2) 提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會行政部；無法退還時，應於收受之日起三日內，交行政部處理。行政部應視第一項財物之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，呈總經理核准後執行。 3.合法政治獻金之處理程序： (1) 應確認係符合政治獻金收受者所在國家之政治獻金相關法規，包括提供政治獻金之上限及形式等。	(三)與公司誠信經營守則相符。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	
			(2)政治獻金應依法規及會計相關處理程序予以入帳。 (3)提供政治獻金時，應避免與政府相關單位從事商業往來、申請許可或辦理其他涉及公司利益之事項。 4.本公司每月定期檢查相關資訊，除嚴格落實防範措施外，其立即矯正可能產生漏洞之作業程序。
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		(一)與公司誠信經營守則相符。 (一) 1.本公司與往來銀行、代理商、供應商或利益相關者，均由專案人員定期審視其信用狀況，可即時避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，且與代理商/經銷商等簽訂之「產品代理/經銷/銷售契約」針對銷售價格、智慧財產權及保密責任進行規範。 2.與供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序： (1)本公司與他人建立商業關係前，應先行瞭解代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。 (2)本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？	V		(3)本公司人員應避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。 (二) 1.本公司由資源管理中心負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並由業務行銷中心、設計中心、產品中心及品質保證處等單位協助負責。 2.本公司針對較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，由內部稽核部門每年定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。	(二)與公司誠信經營守則相符。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三) 1.本公司董事、經理人及員工不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。 2.本公司與其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂契約，其內容應包括遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。	(三)與公司誠信經營守則相符。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？	V		(四)本公司已建立完整有效的會計制度、內部控制制度，由內部稽核部門及外部專業單位(如會計師)持續稽查違反誠信經營之情事，截至今日並無違反誠信經營之情事。	(四)與公司誠信經營守則相符。

評 估 項 目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)本公司定期對董事、經理人及員工舉辦誠信經營之教育訓練與宣導，若發現有違誠信經營守則嫌疑之情事，均有向其主管或檢舉管道負責單位舉報之責任與義務。並將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。	(五)與公司誠信經營守則相符。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一) 1.本公司已訂定「檢舉制度」及「同仁廉潔守則」，其專責單位為行政部，若檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管；若涉及董事或協理級(含)以上之高階主管，應呈報至獨立董事。 2.本公司同仁若發現有舞弊或洩漏機密而違反誠信經營規定時，可透過部門主管或行政部予以檢舉，並指派專責人員受理，調查相關事實證明，若確實違反廉潔守則，除所獲取之各項不正當利益，均應追繳發還被索取人或公司外，並依情節大小，予以不等之處分。	(一)與公司誠信經營守則相符。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？	V		(二) 1.本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，即刻查明相關事實，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，將立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。 2.對於檢舉情事經查證屬實，相關單位應檢討內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次	(二)與公司誠信經營守則相符。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		發生，並由專責單位將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。 (三)本公司提供正當且獨立之檢舉管道，並對檢舉人身份及檢舉內容確實保密，以維護檢舉人之人身安全。	(三)與公司誠信經營守則相符。
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一)本公司已訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，並揭露於公司網站與公開資訊觀測站，並由資源管理中心負責推動誠信經營相關政策。	(一)與公司誠信經營守則相符。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司訂有「誠信經營守則」，並隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，提昇誠信經營成效，目前運作情形良好。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 截至目前為止，公司無發生重大違反誠信經營規定，影響公司營運之情事。				

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司之「公司治理守則」及相關規章已揭露於公司網站及公開資訊觀測站，查詢方式請參閱本公司網站(<http://www.holtek.com.tw>)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

董事/監察人、經理人及稽核主管之進修情形：

職稱	姓名	就任日期	進修期間	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	吳啟勇	102/06/11	104/03/18	社團法人中華公司治理協會	如何透過內控強化公司治理主動發現弊端	3.0
			104/11/05	社團法人中華公司治理協會	公司治理評鑑與企業社會責任實務分享	3.0
董事	高國棟	102/06/11	104/03/18	社團法人中華公司治理協會	如何透過內控強化公司治理主動發現弊端	3.0
			104/11/05	社團法人中華公司治理協會	公司治理評鑑與企業社會責任實務分享	3.0
董事	張 治	102/06/11	104/03/18	社團法人中華公司治理協會	如何透過內控強化公司治理主動發現弊端	3.0
			104/11/05	社團法人中華公司治理協會	公司治理評鑑與企業社會責任實務分享	3.0
董事	林正鋒	102/06/11	104/03/18	社團法人中華公司治理協會	如何透過內控強化公司治理主動發現弊端	3.0
			104/11/05	社團法人中華公司治理協會	公司治理評鑑與企業社會責任實務分享	3.0
董事	李佩縈	102/06/11	104/03/18	社團法人中華公司治理協會	如何透過內控強化公司治理主動發現弊端	3.0
			104/11/05	社團法人中華公司治理協會	公司治理評鑑與企業社會責任實務分享	3.0
獨立董事	呂正樂	102/06/11	104/03/18	社團法人中華公司治理協會	如何透過內控強化公司治理主動發現弊端	3.0
			104/11/05	社團法人中華公司治理協會	公司治理評鑑與企業社會責任實務分享	3.0
獨立董事	邢智田	102/06/11	104/03/18	社團法人中華公司治理協會	如何透過內控強化公司治理主動發現弊端	3.0
			104/11/05	社團法人中華公司治理協會	公司治理評鑑與企業社會責任實務分享	3.0
監察人	王仁宗	102/06/11	104/03/18	社團法人中華公司治理協會	如何透過內控強化公司治理主動發現弊端	3.0
			104/11/05	社團法人中華公司治理協會	公司治理評鑑與企業社會責任實務分享	3.0
監察人	林嘉茂	102/06/11	104/03/18	社團法人中華公司治理協會	如何透過內控強化公司治理主動發現弊端	3.0
			104/11/05	社團法人中華公司治理協會	公司治理評鑑與企業社會責任實務分享	3.0
監察人	新耕投資 有限公司 代表人： 周玲娜	102/06/11	104/03/18	社團法人中華公司治理協會	如何透過內控強化公司治理主動發現弊端	3.0
			104/11/05	社團法人中華公司治理協會	公司治理評鑑與企業社會責任實務分享	3.0
會計 主管	李文德	101/08/01	104/05/22 ~ 104/05/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0
稽核 主管	廖明通	103/02/01	104/08/07	內部稽核協會	最新修正財務報告編製準則及相關法令對企業內控、內稽之影響	6.0
			104/09/24	內部稽核協會	內部稽核人員如何執行法令規章遵循稽核	6.0

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

盛群半導體股份有限公司

內部控制聲明書



日期：一〇五年三月三日

本公司民國一〇四年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一〇四年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一〇五年三月三日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

盛群半導體股份有限公司

董事長：吳啟勇



總經理：高國棟



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

日 期	會 別	重 要 決 議 事 項
104.06.09	股東常會	1.通過本公司民國一〇三年度營業報告 2.通過監察人查核本公司民國一〇三年度決算報告 3.通過本公司民國一〇三年度營業報告書及財務報表 4.通過本公司民國一〇三年度盈餘分派案 執行情形：已訂定 104.08.17 為除息基準日，並於 104.08.28 發放現金股利 5.通過本公司法定盈餘公積配發股東現金案 執行情形：已訂定 104.08.17 為除息基準日，並於 104.08.28 發放現金股利 6.通過本公司「公司章程」修訂案 執行情形：已向主管機關報備公司章程修訂案，並於 104.06.18 取得核准函 7.通過本公司「股東會議事規則」修訂案 8.通過本公司董事競業禁止解除案
104.07.27	董事會	1.通過訂定本公司一〇三年度盈餘分派之配息基準日案 2.通過訂定本公司法定盈餘公積發放現金基準日案 3.通過 MCU Holdings Ltd.撤銷 MegaSky Electronics Holding Ltd.投資案 4.通過 MCU Holdings Ltd.新增轉投資 Fine Chip Electronics Inc.案 5.通過 Fine Chip Electronics Inc.再轉投資健芳電子科技(上海)有限公司案(名稱暫定) 6.通過本公司董事及監察人酬勞與經理人績效津貼及員工紅利案
104.10.27	董事會	1.通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」訂定案 2.通過優方科技股份有限公司辦理現金減資案 3.通過 MCU Holdings Ltd.轉投資 Anchip Technology Corporation 及嘉芯安科技(深圳)有限公司案(名稱暫定) 4.通過金佶科技股份有限公司增加投資案 5.通過本公司董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬案
104.11.05	董事會	1.通過本公司「一〇五年稽核作業風險評估報告及年度稽核計劃」案 2.通過本公司一〇五年營運計劃書 3.通過本公司董事及經理人「道德行為準則」訂定案 4.通過永豐銀行新竹分行短期額度申請案
105.01.25	董事會	1.通過本公司「公司章程」修訂案 2.通過本公司民國一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案 3.通過本公司民國一〇四年合併財務報告及個體財務報告 4.通過本公司「董事會績效評估辦法」訂定案 5.通過本公司「檢舉制度」訂定案 6.通過本公司董事、監察人及經理人之績效評估、薪資報酬及員工酬勞案

日 期	會 別	重 要 決 議 事 項
105.03.03	董事會	1.通過本公司民國一〇四年度營業報告書 2.通過本公司民國一〇四年度盈餘分派案 3.通過本公司法定盈餘公積配發股東現金案 4.通過本公司「公司章程」修訂案 5.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 6.通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 7.通過本公司「背書保證作業程序」修訂案 8.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案 9.通過本公司「誠信經營守則」修訂案 10.通過本公司「董事會議事規則」修訂案 11.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂案 12.通過本公司「審計委員會組織規程」訂定案 13.通過本公司「企業社會責任實務守則」修訂案 14.通過本公司「公司治理守則」修訂案 15.通過本公司「對子公司之監理辦法」修訂案 16.通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」修訂案 17.通過本公司第六屆董事及監察人任期將屆，依公司章程規定擬於一〇五年股東常會中辦理全面改選第七屆董事(含獨立董事)事宜 18.通過討論解除董事競業禁止案 19.通過本公司一〇五年股東常會召開日期案 20.通過本公司出具內部控制聲明書案 21.通過 MCU Holdings Ltd.處分 Innotek Electronics Inc.投資案
105.04.14	董事會	1.通過審查本公司第七屆董事(含獨立董事)候選人提名
105.04.25	董事會	1.通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案 2.通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案 3.通過新增倍創科技股份有限公司投資案 4.通過本公司轉投資 MCU Holdings Ltd.辦理減資案 5.通過本公司董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬案

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等)辭職解任情形：無。

五、會計師公費資訊

- (一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備 註
安侯建業聯合會計師事務所	魏興海	曾漢鈺	103/01/01~103/12/31	事務所內部組織調整
安侯建業聯合會計師事務所	曾漢鈺	游萬淵	104/01/01~104/12/31	事務所內部組織調整

金額單位：新台幣仟元

金額級距 \ 公費項目		審計公費	非審計公費	合 計
1	低於 2,000 千元	—	—	—
2	2,000 千元(含)~4,000 千元	3,670	—	3,670
3	4,000 千元(含)~6,000 千元	—	—	—
4	6,000 千元(含)~8,000 千元	—	—	—
5	8,000 千元(含)~10,000 千元	—	—	—
6	10,000 千元(含)以上	—	—	—

- (二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
- (三) 審計公費較前一年度減少百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

六、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更 換 日 期	104.01.01		
更 換 原 因 及 說 明	事務所內部組織調整		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情 況	會計師	委任人
	主動終止委任	—	—
	不再接受(繼續)委任	—	—
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	—	會計原則或實務
		—	財務報告之揭露
		—	查核範圍或步驟
		—	其 他
	無	V	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第 10 條第 5 款第 1 目第 4 點應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	安侯建業聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	曾漢鈺會計師、游萬淵會計師
委 任 之 日 期	104.01.01
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	104 年度		當年度截至 105 年 3 月 29 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	吳啟勇	—	—	—	—
董事兼總經理	高國棟	—	—	—	—
董事兼副總經理	張 治	(45,000)	—	—	—
董事兼副總經理	林正鋒	—	—	—	—
董事兼副總經理	李佩縈	—	—	—	—
獨立董事	呂正樂	—	—	—	—
獨立董事	邢智田	—	—	—	—
監察人	王仁宗	(1,500,000)	—	—	—
監察人	林嘉茂	(1,500,000)	—	—	—
監察人	新耕投資有限公司 代表人：周玲娜	—	—	—	—
協 理	吳紹藩	(40,000)	—	—	—
協 理	吳德傳	—	—	—	—
協 理	王鈺鈿	—	—	—	—
協 理	蔡榮宗	10,000	—	—	—
協 理	王明坤	—	—	—	—
協 理	余國成	—	—	—	—
會計主管	李文德	—	—	—	—
大股東	聯華電子(股)公司	—	—	—	—

註 1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註 2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

(二)股權移轉資訊

本公司董事、監察人、經理人及持股比例 10%以上股東並無辦理股權移轉予關係人之情事。

(三)股權質押資訊

本公司董事、監察人、經理人及持股比例 10%以上股東並無辦理股票質押予關係人之情事。

九、持股比例占前十名之股東，其相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

105 年 3 月 29 日；單位：股

姓名（註 1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。 （註 3）		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
聯華電子股份有限公司 洪嘉聰	25,944,257	11.47%	—	—	—	—	無	無	
富邦人壽保險股份有限公司 鄭本源	13,400,000	5.92%	—	—	—	—	無	無	
國泰人壽保險股份有限公司 蔡宏圖	9,012,000	3.98%	—	—	—	—	無	無	
吳啟勇	7,665,809	3.39%	2,745,598	1.21%	—	—	無	無	
高國棟	6,701,176	2.96%	—	—	—	—	無	無	
南山人壽保險股份有限公司 杜英宗	5,710,000	2.52%	—	—	—	—	無	無	
德銀託管奎特外國價值小型資本基金專戶	5,489,900	2.43%	—	—	—	—	無	無	
啟盛投資股份有限公司 陳佳宏	5,172,703	2.29%	—	—	—	—	無	無	
財團法人國家文化藝術基金會 施振榮	4,288,000	1.90%	—	—	—	—	無	無	
新光人壽保險股份有限公司 吳東進	3,482,000	1.54%	—	—	—	—	無	無	

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

日期：104 年 12 月 31 日 單位：仟股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	15,253	100%	—	—	15,253	100%
芯群集成電路(廈門)有限公司(註 1)	—	100%	—	—	—	100%
合泰半導體(中國)有限公司(註 1)	—	100%	—	—	—	100%
Sigmos Holdings Ltd.	200	100%	—	—	200	100%
Holtek Semiconductor (USA) Inc. (註 2)	2,000	100%	—	—	2,000	100%
MCU Holdings Ltd.	2,277	100%	—	—	2,277	100%
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	2,000	100%	—	—	2,000	100%
金科集成電路(蘇州)有限公司(註 3)	—	100%	—	—	—	100%
盛凌投資股份有限公司	40,000	100%	—	—	40,000	100%
Bestway Electronic Inc. (註 4)	800	40%	—	—	800	40%
新榮(香港)有限公司(註 5、註 18)	2,000	40%	—	—	2,000	40%
新緯科技(深圳)有限公司(註 6)	—	40%	—	—	—	40%
Santek Holdings Ltd. (註 4)	180	40%	—	—	180	40%
新禾(廈門)電子有限公司(註 7)	—	40%	—	—	—	40%
New Wave Electronics Holding Ltd. (註 4)	800	40%	—	—	800	40%
諾華達電子(深圳)有限公司(註 8)	—	40%	—	—	—	40%
金濤高科有限公司(註 4)	2,400	40%	—	—	2,400	40%
宏達科技有限公司(註 4)	1,275	33%	—	—	1,275	33%
Innotek Electronics Inc. (註 4)	320	40%	—	—	320	40%
新碩電子科技(杭州)有限公司(註 9)	—	40%	—	—	—	40%
ForIC Electronics Holding Ltd. (註 4)	300	40%	—	—	300	40%
華榮匯電子科技(北京)有限公司(註 10)	—	40%	—	—	—	40%
E-Micro Technology Holding Ltd. (註 10、註 19)	300	40%	—	—	300	40%
振揚電子(青島)有限公司(註 11)	—	40%	—	—	—	40%
Newtek Electronics Ltd. (註 4)	1,501	41%	—	—	1,501	41%
新鼎(深圳)電子有限公司(註 12)	—	41%	—	—	—	41%
Truetek Technology Ltd. (註 4)	920	40%	—	—	920	40%
信霖電子商貿(上海)有限公司(註 13)	—	40%	—	—	—	40%
Crown Rich Technology Holding Ltd. (註 4)	80	40%	—	—	80	40%
華瑞昇電子(深圳)有限公司(註 14)	—	40%	—	—	—	40%
Quanding Technology Holding Ltd. (註 4)	60	40%	—	—	60	40%
全鼎電子(蘇州)有限公司(註 15)	—	40%	—	—	—	40%
欣宏電子股份有限公司(註 16)	6,595	40%	10	0%	6,605	40%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
A-ONE WIRELESS TECHNOLOGY CORP.(註 17)	2,000	40%	—	—	2,000	40%
鈺威股份有限公司(註 16)	5,641	22%	—	—	5,641	22%
高聖科技股份有限公司(註 16)	235	39%	115	19%	350	58%
優方科技股份有限公司(註 16)	1,600	55%	425	11%	2,025	66%
BEST SOLUTION ELECTRONIC INC. (註 20)	400	55%	—	—	400	55%
天宇微機電股份有限公司(註 16)	380	20%	—	—	380	20%
金佶科技股份有限公司(註 16)	2,050	33%	—	—	2,050	33%
Gingy Technology Inc.(註 21)	2	33%			2	33%
盛通科技股份有限公司(註 16)	2,000	100%			2,000	100%
BestComm RF Electronics Inc.(註 22)	18	100%			18	100%
Fine Chip Electronics Inc. (註 4)	1	40%	—	—	1	40%
Anchip Technology Corporation (註 4)	—	40%	—	—	—	40%

註 1：係 Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.轉投資。

註 2：係 Sigmos Holdings Ltd.轉投資。

註 3：係 Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.轉投資。

註 4：係 MCU Holdings Ltd.轉投資。

註 5：係 Bestway Electronic Inc.轉投資。

註 6：係新棠(香港)有限公司轉投資。

註 7：係 Santek Holdings Ltd.轉投資。

註 8：係 New Wave Electronics Holding Ltd.轉投資。

註 9：係 Innotek Electronics Inc.轉投資。

註 10：係 ForIC Electronics Holding Ltd.轉投資。

註 11：係 E-Micro Technology Holding Ltd.轉投資。

註 12：係 Newtek Electronics Ltd.轉投資。

註 13：係 Truetek Technology Ltd.轉投資。

註 14：係 Crown Rich Technology Holding Ltd.轉投資。

註 15：係 Quanding Technology Holding Ltd.轉投資。

註 16：係盛凌投資股份有限公司轉投資。

註 17：係欣宏電子股份有限公司轉投資。

註 18：由新棠(香港)有限公司之股東設立，並全數收購新棠(香港)有限公司原股東之股權，於完成股權移轉後，MCU Holding Ltd.持有 Bestway 40%之股權。

註 19：由 ForIC Electronics Holding Ltd.全數收購 E-Micro Technology Holding Ltd. (BVI)原股東之股權，完成股權移轉後，ForIC Electronics Holding Ltd.持有 E-Micro Technology Holding Ltd. (BVI) 100%之股權。

註 20：係優方科技股份有限公司轉投資。

註 21：係金佶科技股份有限公司轉投資。

註 22：係盛通科技股份有限公司轉投資。

註 23：上述轉投資事業均係公司採用權益法之投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
87/10	10	100,000	1,000,000	40,000	400,000	公司發起設立現金增資 340,000 仟元	技術股作價 60,000 仟元	--
88/04	10	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	現金增資 600,000 仟元	無	--
89/05	10	180,000	1,800,000	122,000	1,220,000	盈餘轉增資 220,000 仟元	無	註 1
90/04	10	180,000	1,800,000	153,380	1,533,800	盈餘轉增資 313,800 仟元	無	註 2
91/06	10	180,000	1,800,000	175,118.7	1,751,187	盈餘轉增資 217,387 仟元	無	註 3
92/06	10	260,000	2,600,000	183,400	1,834,000	盈餘轉增資 82,813 仟元	無	註 4
93/07	10	270,000	2,700,000	194,100	1,941,000	盈餘轉增資 107,000 仟元	無	註 5
94/06	10	290,000	2,900,000	205,409.5	2,054,095	盈餘轉增資 113,095 仟元	無	註 6
94/08	10	290,000	2,900,000	206,614.5	2,066,145	認股權憑證轉換 12,050 仟元	無	註 7
94/10	10	290,000	2,900,000	206,695	2,066,950	認股權憑證轉換 805 仟元	無	註 7
95/01	10	290,000	2,900,000	207,244.5	2,072,445	認股權憑證轉換 5,495 仟元	無	註 7、8
95/04	10	290,000	2,900,000	207,451.5	2,074,515	認股權憑證轉換 2,070 仟元	無	註 7、8
95/08	10	290,000	2,900,000	211,126.1	2,111,261	盈餘轉增資 36,746 仟元	無	註 9
95/08	10	290,000	2,900,000	212,100.1	2,121,001	認股權憑證轉換 9,740 仟元	無	註 7、8、10
95/10	10	290,000	2,900,000	212,210.35	2,122,103.5	認股權憑證轉換 1,102.5 仟元	無	註 7、8、10
96/01	10	290,000	2,900,000	212,470.1	2,124,701	認股權憑證轉換 2,597.5 仟元	無	註 7、8、10
96/04	10	290,000	2,900,000	212,759.35	2,127,593.5	認股權憑證轉換 2,892.5 仟元	無	註 7、8、10
96/08	10	290,000	2,900,000	216,487.05	2,164,870.5	盈餘轉增資 37,277 仟元	無	註 11
96/08	10	290,000	2,900,000	217,550.8	2,175,508	認股權憑證轉換 10,637.5 仟元	無	註 7、8、10
96/11	10	290,000	2,900,000	217,843.3	2,178,433	認股權憑證轉換 2,925 仟元	無	註 7、8、10
97/02	10	290,000	2,900,000	218,005.3	2,180,053	認股權憑證轉換 1,620 仟元	無	註 7、8、10
97/04	10	290,000	2,900,000	218,297.3	2,182,973	認股權憑證轉換 2,920 仟元	無	註 7、8、10
97/09	10	300,000	3,000,000	220,470.4	2,204,704	盈餘轉增資 21,731 仟元	無	註 12
97/09	10	300,000	3,000,000	220,910.4	2,209,104	認股權憑證轉換 4,400 仟元	無	註 7、8、10
97/11	10	300,000	3,000,000	220,955.15	2,209,551.5	認股權憑證轉換 447.5 仟元	無	註 7、8、10
98/03	10	300,000	3,000,000	220,997.4	2,209,974	認股權憑證轉換 422.5 仟元	無	註 7、8、10
98/04	10	300,000	3,000,000	221,180.9	2,211,809	認股權憑證轉換 1,835 仟元	無	註 7、8、10
98/08	10	300,000	3,000,000	222,087.7	2,220,877	盈餘轉增資 9,068 仟元	無	註 13
98/08	10	300,000	3,000,000	222,217.45	2,222,174.5	認股權憑證轉換 1,297.5 仟元	無	註 8
98/11	10	300,000	3,000,000	222,301.45	2,223,014.5	認股權憑證轉換 840 仟元	無	註 8

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
99/02	10	300,000	3,000,000	222,347.45	2,223,474.5	認股權憑證轉換 460 仟元	無	註 8
99/04	10	300,000	3,000,000	222,556.2	2,225,562	認股權憑證轉換 2,087.5 仟元	無	註 8、14
99/08	10	300,000	3,000,000	222,666.2	2,226,662	認股權憑證轉換 1,100 仟元	無	註 14、15
99/11	10	300,000	3,000,000	222,798.7	2,227,987	認股權憑證轉換 1,325 仟元	無	註 14、15
100/02	10	300,000	3,000,000	223,044.2	2,230,442	認股權憑證轉換 2,455 仟元	無	註 14、15
100/05	10	300,000	3,000,000	223,339.7	2,233,397	認股權憑證轉換 2,955 仟元	無	註 14、15
100/08	10	300,000	3,000,000	223,598.45	2,235,984.5	認股權憑證轉換 2,587.5 仟元	無	註 14、15
102/08	10	300,000	3,000,000	223,680.45	2,236,804.5	認股權憑證轉換 820 仟元	無	註 15
102/11	10	300,000	3,000,000	224,941.2	2,249,412	認股權憑證轉換 12,607.5 仟元	無	註 15
103/01	10	300,000	3,000,000	226,168.2	2,261,682	認股權憑證轉換 12,270 仟元	無	註 15

註 1：財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 5 月 15 日(89)台財證(一)第 36989 號函核准。

註 2：財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 4 月 3 日(90)台財證(一)第 116941 號函核准。

註 3：財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 5 月 17 日(91)台財證(一)第 126989 號函核准。

註 4：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 6 月 27 日(92)台財證(一)第 0920128586 號函核准。

註 5：金融監督管理委員會證券期貨局 93 年 6 月 25 日(93)台財證(一)第 0930128187 號函核准。

註 6：金融監督管理委員會證券期貨局 94 年 6 月 24 日(94)金管證(一)第 0940125322 號函核准。

註 7：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 4 月 1 日(92)台財證(一)第 0920110590 號函核准。

註 8：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 8 月 22 日(92)台財證(一)第 0920138382 號函核准。

註 9：金融監督管理委員會證券期貨局 95 年 6 月 29 日(95)金管證(一)第 0950127323 號函核准。

註 10：財政部證券暨期貨管理委員會 93 年 6 月 25 日(93)台財證(一)第 0930128187 號函核准。

註 11：金融監督管理委員會 96 年 6 月 25 日(96)金管證(一)第 0960031838 號函核准。

註 12：金融監督管理委員會 97 年 7 月 9 日(97)金管證(一)第 0970034273 號函核准。

註 13：金融監督管理委員會 98 年 6 月 23 日金管證發字第 0980031086 號函核准。

註 14：行政院金融監督管理委員會 94 年 8 月 26 日金管證一字第 0940135791 號函核准。

註 15：行政院金融監督管理委員會 96 年 12 月 31 日金管證一字第 0960073308 號函核准。

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普 通 股	226,168,200 股	73,831,800 股	300,000,000 股	屬上市公司股票

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)股東結構

105 年 3 月 29 日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個 人	外國機構 及外國人	合計
人 數	1	7	83	16,744	127	16,962
持有股數	175,000	33,883,000	43,021,185	115,099,384	33,989,631	226,168,200
持股比率(%)	0.08%	14.98%	19.02%	50.89%	15.03%	100%

(三)股權分散情形

1.普通股

105年3月29日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比率%
1 至 999	5,034	279,460	0.12
1,000 至 5,000	9,199	17,988,905	7.95
5,001 至 10,000	1,358	10,429,281	4.61
10,001 至 15,000	399	4,897,246	2.17
15,001 至 20,000	259	4,741,063	2.10
20,001 至 30,000	233	5,839,336	2.58
30,001 至 50,000	173	6,923,706	3.06
50,001 至 100,000	130	9,026,546	3.99
100,001 至 200,000	70	9,946,029	4.40
200,001 至 400,000	44	12,601,378	5.57
400,001 至 600,000	18	9,003,353	3.98
600,001 至 800,000	8	5,284,001	2.34
800,001 至 1,000,000	3	2,960,716	1.31
1,000,001 股以上	34	126,247,180	55.82
合 計	16,962	226,168,200	100.0

2.特別股：無。

(四)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱，
持股數額及比例

105年3月29日；單位：股

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比率%
聯華電子股份有限公司		25,944,257	11.47%
富邦人壽保險股份有限公司		13,400,000	5.92%
國泰人壽保險股份有限公司		9,012,000	3.98%
吳啟勇		7,665,809	3.39%
高國棟		6,701,176	2.96%
南山人壽保險股份有限公司		5,710,000	2.52%
德銀託管奎特外國價值小型資本基金專戶		5,489,900	2.43%
啟盛投資股份有限公司		5,172,703	2.29%
財團法人國家文化藝術基金會		4,288,000	1.90%
新光人壽保險股份有限公司		3,482,000	1.54%

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元

項 目 \ 年 度			103 年	104 年	當年度截至 105 年 3 月 31 日
每 股 市 價 (註 1)	最 高		71.60	61.90	54.90
	最 低		44.70	35.50	46.90
	平 均		57.15	51.42	50.90
每 股 淨 值 (註 2)	分配前		17.94	17.89	18.69
	分配後		13.97	註 8	註 8
每 股 盈 餘	加權平均股數(仟股)		226,168	226,168	226,168
	每股盈餘(註 3)		3.50	3.57	0.74
每 股 股 利	現金股利		3.50	註 8	—
	無 償 配 股	盈餘配股	—	註 8	—
		資本公積配股	—	註 8	—
	累積未付股利(註 4)		—	—	—
投 資 報 酬 分 析	本益比(註 5)		16.33	14.40	—
	本利比(註 6)		16.33	註 8	—
	現金股利殖利率(註 7)		6.12%	註 8	—

註 1：列示各年度普通股最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。

註 2：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註 3：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註 4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

註 6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

註 7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

註 8：104 年度盈餘分派案尚未經股東常會決議，故相關比率暫不列示。

(六)公司股利政策及執行狀況

- 1.股利政策：本公司股利政策擬於 105 年 5 月 27 日送股東常會通過修訂公司章程案
本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一，五為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。
上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

2.本次股東會擬議股利分配之情形

本公司擬自 104 年度盈餘分配中，以未分配盈餘分配，股東股利 714,872,447 元全數以現金發放，按配息基準日之股東名簿所記載之股東持股數，每股擬配發現金股利 3.1608 元，另以法定盈餘公積分配，法定盈餘新台幣 92,548,027 元按配息基準日之股東名簿所記載之股東持股數，每股配發現金 0.4092 元，前述以未分配盈餘及法定盈餘公積分配予股東，以現金發放合計 807,420,474 元，合計每股配發現金 3.57 元。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(八)員工、董事及監察人酬勞：

- 1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：本公司股利政策擬於 105 年 5 月 27 日送股東常會通過修訂公司章程案
本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一，五為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
- 2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：
本公司依上述公司章程規定比例提供員工、董事及監察人酬勞，帳列當期費用項下，若董事會或股東會決議與估列金額有差異時，於決議年度將差異金額帳列當期費用項下調整之。
- 3.董事會通過分派酬勞情形：
 - (1)經董事會通過分派 104 年度員工酬勞及董監事酬勞，分別為員工酬勞新台幣 98,026,894 元及董監事酬勞新台幣 10,891,877 元，全數以現金發放，係以本公司該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董監事酬勞前之金額乘上本公司章程擬訂定之員工酬勞及董監事酬勞分派成數為估列基礎，與認列費用年度估列金額並無差異。
 - (2)以股票分派之員工酬勞金額占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

103 年度員工紅利新台幣 96,174,085 元、董監事酬勞新台幣 10,686,009 元，全數以現金發放。實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形並無差異。

(九)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累積至年報刊印日止，取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

(一)計畫內容：前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

(二)執行情形：前各次發行或私募有價證券截至年報刊印日前一季止之執行情形及與原預計效益之比較：無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

本公司以各種積體電路之設計服務與自有產品之開發、製造及行銷為主要業務，其整體產品開發與相關設計服務皆以客戶及市場需求為導向。

2. 主要產品之營業比重

年度 產品別	104 年度
微控制器 IC	70%
週邊 IC	30%
合 計	100%

3. 目前產品及服務項目

在自有產品的開發部分，本公司之產品重心係以微控制器(MCU)暨其週邊 IC 為技術核心，主要應用範圍包含各式標準型及嵌入式 MCU、螢幕顯示 IC 產品、電源管理 IC 產品、電腦週邊 IC 產品、通訊 IC 產品、記憶體 IC 產品、類比 IC 產品、觸控開關 IC 產品、金融產品、醫療量測產品、馬達控制產品及物聯網產品等，其產品走向不但要求符合全球性的應用領域，亦十分重視區域性特殊需求的滿足。另外，本公司也針對個別客戶之需求，提供專屬 ASIC MCU 之委託設計服務，以及針對特殊應用領域開發 ASSP MCU，以充分滿足各類市場的需求。

4. 計劃開發之新產品及服務

為了提供客戶完整的產品及技術服務，本公司將產品之應用範圍擴大到 4C+MG(Medical & Green)領域，同時提供包含多種設計形式之專業服務，以滿足客戶對產品功能、成本、推出時效或產品保護等多樣要求。茲分述主要產品內容如下：

- (1) 工作電壓 1.8V~5.5V A/D 型及 LCD 型 Flash MCU。
- (2) 高壓 12V A/D 型系列 Flash MCU，內含 LDO 穩壓電路及高壓輸出。
- (3) 24 位元 Delta Sigma A/D with LCD 型 Flash MCU。
- (4) 整合電容式感應觸控按鍵+大功率功放語音 Flash MCU 系列。
- (5) 整合人機界面操作電容感應式觸控 Flash MCU 系列性解決方案。
- (6) 針對穿戴式裝置開發極低功耗之觸控 Flash MCU。
- (7) 各種醫療量測 MCU 及解決方案。
- (8) 小家電電源專用 MCU 及解決方案。
- (9) 移動電源充放電管理專用 MCU 及解決方案。

- (10) 無線充電器專用 MCU 及解決方案。
- (11) 鋰電池充放電與太陽能電池管理及解決方案。
- (12) 安防產品(例：煙感器) MCU 內建 OPA 及解決方案。
- (13) 高資源 Flash MCU 及 CAN Bus Flash MCU 及解決方案。
- (14) 高精準 TDC 量測 Flash MCU 及解決方案。
- (15) 超聲波霧化器 Flash MCU 及解決方案。
- (16) E-Banking MCU。
- (17) 加解密 IC 及 MCU。
- (18) 馬達控制 MCU。
- (19) 超聲波流量計 ASSP MCU。
- (20) 超音波測距/倒車雷達專用 MCU。
- (21) 語音 Flash MCU。
- (22) FRS Audio processor 專用式 Flash MCU 整合 SoC 方案。
- (23) RF Sub-1GHz 及 OOK 超再生接收 I/O+A/D Flash MCU 解決方案。
- (24) RF Sub-1GHz 及 OOK+FSK 無線發射 Flash MCU SoC 方案。
- (25) USB Full speed Flash MCU 系列。
- (26) USB Low speed Flash MCU 系列。
- (27) USB Bridge 系列 IC。
- (28) USB RGB LED 調色鍵盤 ASSP MCU。
- (29) 32 位元 MCU 之物聯網應用開發平台及解決方案。
- (30) 32 位元 MCU 之低功耗藍牙應用開發平台及解決方案。
- (31) 32 位元 MCU 產品推出以 ARM® Cortex™-M0+及 M3 核心之 Flash 微控制器。
- (32) LED 照明驅動 IC。
- (33) 標準 OPA 產品開發。
- (34) Class D Amp 產品開發。
- (35) 電源管理 IC(LDO/DC-DC/AC-DC)。
- (36) 高壓總線傳輸 IC。
- (37) 高速 CIS/CCD 類比前置處理器(AFE)及其 LVDS 介面。
- (38) 金融機具之高速雙面 CIS 類比前置處理器(AFE)。
- (39) 金融機具之高速雙面多通道 CIS 數位前置處理器(DFE)暨其時序產生器。
- (40) 金融機具之高速雙面 CIS 類比前置處理器(AFE)暨其數位前置處理器(DFE)及時序產生器。
- (41) 金融機具之高速貨幣序號(冠字碼)讀出暨影像辨識處理器及其解決方案。
- (42) 精準 RTC 計時 IC。
- (43) 霍爾(Hall)元件 SoC 整合 IC。
- (44) 模組產品類：結合各類感測器的應用，並具有需求高精度、需複雜的量產特性校正、特殊小尺寸或應用技術門檻高等性質的應用產品，如焦電型紅外線感測器(PIR)模組、溫濕度感測器模組等。

(二) 產業概況：

1. 產業之現況與發展

(1) 全球半導體產業市場：

根據 WSTS 統計，15Q4 全球半導體市場銷售值達 829 億美元，較上季(15Q3)衰退 2.8%，較去年同期(14Q4)衰退 5.2%；銷售量達 1,949 億顆，較上季(15Q3)衰退 3.1%，較去年同期(14Q4)成長 0.1%；ASP 為 0.425 美元，較上季(15Q3)成長 0.3%，較去年同期(14Q4)衰退 5.2%。

2015 年全球半導體市場全年總銷售值達 3,352 億美元，較 2014 年衰退 0.2%；2015 年總銷售量達 7,872 億顆，較 2014 年成長 2.7%；2015 年 ASP 為 0.426 美元，較 2014 年衰退 2.8%。

在全球總體經濟平穩成長走勢下，Gartner 預估 2016 年全球半導體市場銷售值達 3,411 億美元，成長 1.9%。而 2017 年達 3,584 億美元，成長 5.4%，受半導體產業景氣循環之因素影響。2018 年達 3,740 億美元，成長 4.4%。2019 年達 3,883 億美元，成長 3.8%。預估在 2020 年全球半導體市場規模可達 4,000 億美元大關。若進一步細分，雖然 2016 年全球半導體產值成長有限，但隨著各國開始往工業自動化及提升行車安全發展，工業用及車用 IC 需求成長動能優於整體產業。根據 Gartner 最新預估，2016 年工業用及車用半導體產值分別達到 353 億美元 (YoY +5.7%) 及 327 億美元 (YoY +4.8%)，2015~2019 年的年複合成長率分別為 YoY +8.2%及 YoY +4.3%，優於整體半導體產業。

(2) 臺灣半導體產業市場：

依據臺灣半導體協會委託工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)，於日前公佈的臺灣半導體產業回顧與展望報告：2015 年第四季臺灣整體 IC 產業產值(含 IC 設計、IC 製造、IC 封裝、IC 測試)達新台幣 5,632 億元(USD\$17.7B)，較上季(15Q3)衰退 1.9%，較去年同期(14Q4)衰退 4.6%。其中 IC 設計業產值為新台幣 1,608 億元(USD\$5.0B)，較上季(15Q3)成長 2.9%，較去年同期(14Q4)成長 6.8%；IC 製造業為新台幣 2,928 億元(USD\$9.2B)，較上季(15Q3)衰退 4.3%，較去年同期(14Q4)衰退 10.6%，其中晶圓代工為新台幣 2,430 億元(USD\$7.6B)，較上季(15Q3)衰退 3.7%，較去年同期(14Q4)衰退 9.3%，記憶體製造為新台幣 498 億元(USD\$1.6B)，較上季(15Q3)衰退 6.9%，較去年同期(14Q4)衰退 16.6%；IC 封裝業為新台幣 767 億元(USD\$2.4B)，較上季(15Q3)衰退 2.5%，較去年同期(14Q4)衰退 2.9%；IC 測試業為新台幣 329 億元(USD\$1.0B)，較上季(15Q3)衰退 1.8%，較去年同期(14Q4)衰退 0.3%(新台幣對美元匯率以 31.9 計算)。

工研院 IEK 統計 2015 年臺灣 IC 產業產值達新台幣 22,640 億元(USD\$71.0B)，較 2014 年成長 2.8%。其中 IC 設計業產值為新台幣 5,927 億元(USD\$18.6B)，較 2014 年成長 2.8%；IC 製造業為新台幣 12,300 億元(USD\$38.6B)，較 2014 年成長 4.9%，其中晶圓代工為新台幣 10,093 億元(USD\$31.6B)，較 2014 年成長 10.4%，記憶體製造為新台幣 2,207 億元(USD\$6.9B)，較 2014 年衰退 14.8%；IC 封裝業為新台幣 3,099 億元(USD\$9.7B)，較 2014 年衰退 1.9%；IC 測試業為新台幣 1,314 億元(USD\$4.1B)，較 2014 年衰退 4.7%。

2015 年臺灣 IC 產業產值統計結果

億新台幣	15Q1	季 成長	年 成長	15Q2	季 成長	年 成長	15Q3	季 成長	年 成長	15Q4	季 成長	年 成長	2015 年	年 成長
IC 產業產值	5,706	-3.3%	20.5%	5,559	-2.6%	0.9%	5,743	3.3%	-2.4%	5,632	-1.9%	-4.6%	22,640	2.8%
IC 設計業	1,360	-9.6%	8.5%	1,397	2.7%	-4.1%	1,562	11.8%	0.8%	1,608	2.9%	6.8%	5,927	2.8%
IC 製造業	3,259	-0.5%	32.6%	3,054	-6.3%	6.0%	3,059	0.2%	-1.8%	2,928	-4.3%	-10.6%	12,300	4.9%
晶圓代工	2,648	-1.2%	46.5%	2,491	-5.9%	12.5%	2,524	1.3%	3.5%	2,430	-3.7%	-9.3%	10,093	10.4%
記憶體製造	611	2.3%	-6.1%	563	-7.9%	-15.3%	535	-5.0%	-21.1%	498	-6.9%	-16.6%	2,207	-14.8%
IC 封裝業	767	-2.9%	8.0%	778	1.4%	-4.5%	787	1.2%	-6.9%	767	-2.5%	-2.9%	3,099	-1.9%
IC 測試業	320	-3.0%	1.6%	330	3.1%	-8.6%	335	1.5%	-10.2%	329	-1.8%	-0.3%	1,314	-4.7%
IC 產品產值	1,971	-6.2%	3.5%	1,960	-0.6%	-7.6%	2,097	7.0%	-5.8%	2,106	0.4%	0.2%	8,134	-2.6%
全球半導體成長率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.2%

資料來源：TSIA；工研院 IEK(2016/02)

2011 年~2015 年臺灣 IC 產業產值

億新台幣	2011 年	2011 年 成長率	2012 年	2012 年 成長率	2013 年	2013 年 成長率	2014 年	2014 年 成長率	2015 年	2015 年 成長率
IC 產業產值	15,627	-11.7%	16,342	4.6%	18,886	15.6%	22,033	16.7%	22,640	2.8%
IC 設計業	3,856	-15.2%	4,115	6.7%	4,811	16.9%	5,763	19.8%	5,927	2.8%
IC 製造業	7,867	-12.6%	8,292	5.4%	9,965	20.2%	11,731	17.7%	12,300	4.9%
晶圓代工	5,729	-1.7%	6,483	13.2%	7,592	17.1%	9,140	20.4%	10,093	10.4%
記憶體製造	2,138	-32.5%	1,809	-15.4%	2,373	31.2%	2,591	9.2%	2,207	-14.8%
IC 封裝業	2,696	-6.1%	2,720	0.9%	2,844	4.6%	3,160	11.1%	3,099	-1.9%
IC 測試業	1,208	-5.5%	1,215	0.6%	1,266	4.2%	1,379	8.9%	1,314	-4.7%
IC 產品產值	5,994	-22.3%	5,924	-1.2%	7,184	21.3%	8,354	16.3%	8,134	-2.6%
全球半導體成長率	-	0.4%	-	-2.7%	-	4.8%	-	9.9%	-	-0.2%

資料來源：TSIA；工研院 IEK(2016/02)

展望 2016 全年，因受 2015 年經濟造成的全球動盪影響導致終端產品需求不振，整體而言，臺灣 IC 設計業 2016 年的產值預計將達新台幣 6,202 億元，較 2015 全年微幅成長 4.6%。

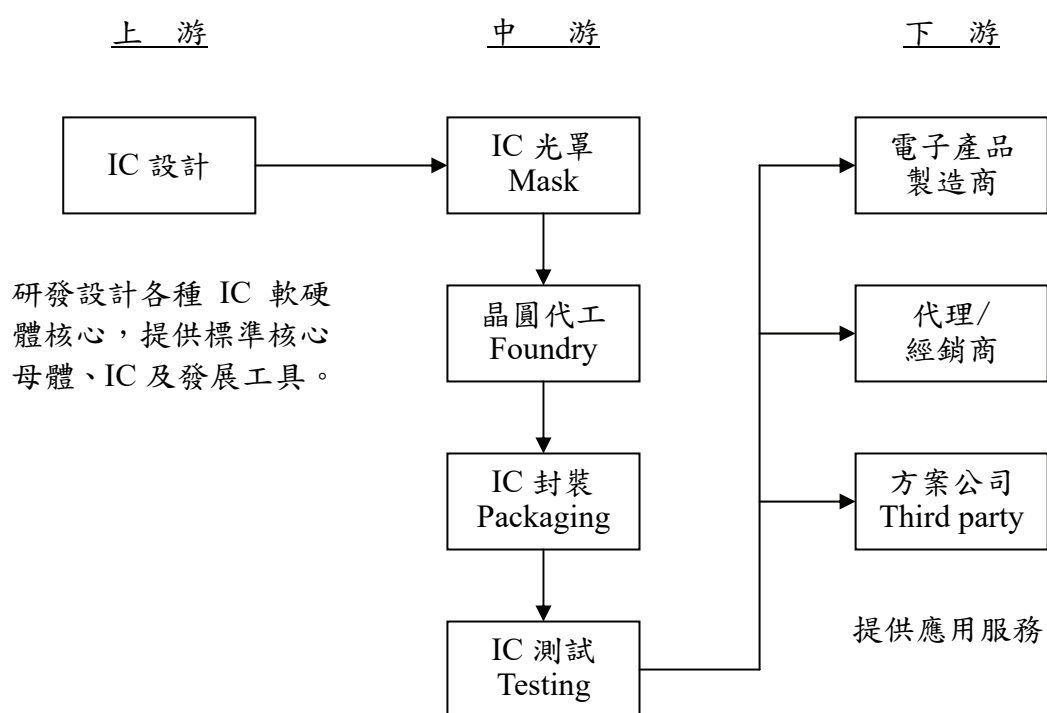
(3) 中國半導體產業市場：

中國半導體行業協會設計分會理事長魏少軍博士表示，2015 年協會針對 736 家設計企業的經營情況進行了調查統計，比 2014 年的 681 家擴大了 55 家(統計資料中剔除了企業異地設立分支機構可能產生的重複計算和企業非晶片設計活動產生的銷售)。初步統計顯示，2015 年全行業銷售收入預計為 1,234.16 億元，比 2014 年的 982.5 億元增長 25.62%(按照美元兌人民幣 1:6.35 匯率計算，全年銷售額達到 194.36 億美元)，預計占全球積體電路設計業的比重將有較大幅度提升。

與 2014 年相比，十大設計企業的銷售總和達到 540.47 億元，比上年的 406.10 億元增加 134.37 億元，十大設計企業的銷售總和占全行業銷售總和的比例為 43.79%，比上年的 41.33% 增加 2.46 個百分點，產業集中度進一步提高。十大設計企業的平均增長率為 33.09%，比行業平均增長率 25.62% 高了個 7.47 個百分點。只是於 2015 年，盈利企業的數量為 409 家，比去年的 427 家，減少了 18 家，降低了 4.4 個百分點，不盈利企業的數量則從去年 254 家增加到今年的 327 家，增加了 27.74%。另外，根據對排名前 100 的設計企業的統計，百大設計公司的平均毛利率為 29.56%，比上年的 30.86%，下降了 1.3 個百分點，十大設計公司的平均毛利率為 40.25%，比 2014 年的 37.05% 提高了 3.2 個百分點，2016 年中國半導體產業市場競爭將更是激烈。

2. 產業上、中、下游之關聯性

IC 設計產業結構圖



3. 產品之各種發展趨勢

本公司設計之 IC 產品系列齊全，所涵蓋的應用領域非常廣泛，包括電腦、通訊、消費、智能家電、工業設備、醫療量測及物聯網產品等領域使用：

主要產品	用 途
微控制器(MCU)產品	1. ARM Cortex-M0+及 M3 為核心之系列 32 位元 MCU。 2. HT8 為核心之系列 8 位元 Flash MCU。 3. BS 系列 8 位元觸控 Flash MCU。 4. 各式 ASSP 及 ASIC MCU。
RF SoC 微控制器(MCU)產品	無線對講機、電動機車報警、電動腳踏車防盜、智能家居無線遙控和防盜。

主要產品	用 途
家電產品類	各式小家電微控制器、家電面板顯示控制 MCU 及各類家電觸控按鍵 MCU。
電腦產品類	鍵盤、滑鼠、電競鍵盤、USB Bridge、USB Fingerprint、掃描器與多功能事務機等。
顯示器產品類	電錶顯示器、影音 & 家電顯示器、車用顯示器、電子貨架標籤顯示器及穿戴式產品顯示器等。
電源管理產品類	家電電源板卡、充電器、煙感器、行動電源、無線充電、智能電錶、鋰電池個人護理產品(剃鬚刀、鼻毛刀、潔面儀、電推剪)及手電筒等 ASSP MCU。
金融產品類	動態密碼產生器、挑戰應答動態密碼產生器、智能卡讀卡器、基於貨幣、信用卡、身份證等有掃描辨識需求之相關金融機具，如點驗鈔機、清分機、ATM 機及身份證鑑別儀等。
物聯網產品類	基於 WiFi 及 BLE(低功耗藍牙)的物聯網技術，以 32 位元 MCU 提供小家電、健康監控、醫療照護、智慧手環及其他物聯網相關產品完整的解決方案。
安防產品類	煙霧感測器、PM2.5 感測器、CO 感測器、PIR 感測器及溫溼度感測器等。
健康量測產品類	血壓計、血糖儀、血氧儀、體溫計、電子體重秤、計價秤、體脂秤、耳溫槍及額溫槍等。

4. 競爭情形

臺灣 IC 設計業適逢天時、地利、人和之有利因素，大大小小總計成立超過四百多家公司，分別在不同領域發揮其所長。然而由於技術背景相似、市場目標雷同、產品重疊性高等因素，致使同業間之空前激烈競爭。

另外不容忽視的超級競爭對手—大陸 IC 設計業者，在中國政府支持發展下也在迅速地茁壯，未來臺灣業者如無法持續將現有產品進行轉型/技術提升或提供更具有競爭的產品與方案，那麼將難逃被淘汰之命運。

此外東歐與其他東南亞等開發中國家也看好此一產業，紛紛由政府大力獎勵與支援，以培植重點產業之型態持續努力中，亦實在值得留意。

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	104 年度	105 年第一季
研發費用	659,417	170,126
營業收入	3,967,840	908,086
研發費用佔營業收入比率(%)	17%	19%

註 1：當年度截至 105 年 3 月 31 日之財報資料為經會計師核閱之合併財務資料

2. 開發成功之技術或產品

本公司以每年約營業額的 15%~20%投入新產品與新技術研發，藉由新產品的持續導入來創造公司營業額的穩定成長與利潤的提升。

一〇四年度主要的研發成果以微控制器為核心，搭配週邊 IC 系列，提供完整解決方案暨滿意之整體服務。依應用分類概述於下：

(1) 新一代 8 位元 MCU

- A. 1.8V~5.5V 低工作電壓 Flash 型系列：支援更低的工作電壓，內建 AD 及 LCD 功能，適用電池類產品。
- B. 內建多級放大器、比較器及穩壓器 MCU：節省 PCB 板的空間並簡化電路架構，縮小應用產品體積，具有節省成本及生產方便等優勢，適合各種需要信號放大的產品應用，例如遙控器、倒車雷達、測距儀、玩具、機器人、量測儀器等。
- C. 觸控按鍵微控制器系列：觸控按鍵微控制器系列，搭上觸控產品熱潮，適合各式觸控產品使用，Flash Touch MCU 系列可多次 ICP(In Circuit Programming)燒寫，並內建 EEPROM，便於修改程序、參數調整與設定更改，提供客戶最方便的開發平台與最具競爭力產品。
- D. 低功耗標準型系列(TinyPower™ MCU)：本系列產品具備與國際大廠同等級之低功耗能力，符合環保潮流，適合於各種採用電池電源之可攜式產品。
- E. 健康醫療產品，鎖定血壓、血糖、血氧、體溫、體重與體脂肪等、保健與照護等相關產品，陸續開發出專用 MCU，除高度集成現有外部元器件外，並提供更高解析度的 24 位元 ADC 與先進 USB 與語音介面，簡化對於遠距照護產品的設計，提高老年人口使用方便性。
- F. 完成伺服馬達(Servo Motor，或稱為舵機)專用 MCU 之開發，應用於航空模型、小型機器人等產品。
- G. 完成無刷直流馬達(BLDC - Brushless DC Motor)控制 MCU，應用於節能風扇上，達到節能、線性控速與低噪音效果。

以上各系列 MCU 最低均達工業等級規格(寬溫運作範圍達到-40℃~+85℃)，抗雜訊能力與歐美日領導廠商之產品品質同級，產品品質已獲得廣泛客戶的認可。

(2) 消費性產品

- A. Flash Type Voice MCU：整合 16 位元 ADC/DAC 等類比 IP 並提供 SPI 介面，內建硬體語音壓縮等相關技術，減化客戶應用技術門檻，提高產品的便利性。
- B. Touch + Voice Flash MCU：整合 16 位元 ADC/DAC 等類比 IP 並提供 SPI 介面，軟體語音解壓縮技術，並內置 HOLTEK 第三代電容式觸控按鍵使用，及軟體 LCD 功能。減化客戶應用技術門檻及整合多項分離 IC 器件應用，提高產品的便利性及完整性。
- C. Touch + LCD/LED Flash MCU：結合第三代電容式觸控按鍵，直接驅動 LCD 及大電流 LED，內置 UART 串列式通信界面、RTC 實時時鐘功能與

高精度 12 bits 的模數轉換，除一般消費性產品使用外，並適用於工業用溫控器等工業產品。

D. 電源管理產品：

(A) $\pm 3\%$ 精準度 30mA/100mA/250mA/300mA/500mA 低功耗穩壓 IC：廣泛使用於各類型電子產品，如：可攜式或插電式省電型產品等，可延長電池壽命及達到綠色節能效果。

(B) $\pm 1\%$ 精準度 30mA/100mA 低功耗穩壓 IC：提供高輸入耐壓及低功耗電源穩壓 IC，精準的輸出電壓可提升系統產品特性，適合用於更高階電子產品。

(C) 100mA/200mA/300mA/350mA 同步整流直流升壓轉換：使用於可攜式高效率需求產品。

(D) 2A/3A 非同步 Step-Down DC-DC：使用於直流降壓大電流輸出產品，如網通、數位相框、LCD TV、USB 充電等產品。

(E) AC-DC Converter IC：應用在市電(交流電)轉換成直流電的家電產品，包括電磁爐、電陶爐、咖啡機、電飯煲電源等。

(F) LED 照明驅動 IC：使用於一般 LED 照明，可應用在 T8 燈管、E27 球泡燈等。

E. Real Time Clock IC：可使用在各種需要計數時間的產品，例如：電錶、水錶、煤氣錶、考勤及門禁設備、計費電話、收銀機、MP3、數位相框、辦公室自動化產品、家電產品、電腦產品等。

F. Remote Control Encoder IC：可使用在汽車防盜、機車/電動車防盜、家庭防盜及大門、窗簾、門鈴、家電之遙控。

G. 超聲波流量計 ASSP MCU：整合 TDC 等類比 IP 並提供通訊介面(SPI/UART/PC)，內建流量演算法及溫度量測等相關技術，降低客戶應用技術門檻，提高產品之便利性。

H. 高壓總線資料傳輸 IC：整合電壓調變資料輸入及電流調變資料輸出等類比 IP，提供解調變資料輸入及調變資料輸出功能；符合總線資料傳輸應用，以提高產品的便利性及完整性。

(3) 電腦週邊產品

A. USB 2.0 Full Speed MCU 系列。

B. USB Bridge 系列 IC。

C. 多媒體產品：

(A) USB Speaker：USB 2.0 full speed 支援立體聲喇叭。

(B) Wireless USB Audio：USB 2.0 full speed 內建 ADPCM 硬體壓縮電路，支援 2.4G 無線通信介面。

D. 高速 CIS/CCD 類比前置處理器(AFE)系列。

E. 內含計算機鍵盤控制器：支援 USB 暨計算機之功能。

F. USB 2.0 Full Speed MCU 系列。

G. USB Bridge 系列 IC。

(4) 無線產品

- A. 無線對講機控制器：內建 DSP 與音頻類比電路之 SoC Flash MCU，適用於類比式專用及 FRS 對講機。
- B. 無線遙控器：整合 315M/433M/868M/915MHz ISM 頻段之 RF 發射電路與編碼器，ASK/OOK/FSK/GFSK 調制方式之遙控器，並內置高性能 Flash MCU，結合 RF 及 MCU 控制為一體的 SoC IC。
- C. 無線控制器：315M/433M/868M/915MHz RF 接收超再生及超外差模式電路，解調 OOK/FSK 接收及 Flash MCU 應用合一，適合搭配無線發射遙控器產品，作為整合性單向、雙向控制應用。
- D. 2.4GHz 無線 MCU：整合 2.4G RF 電路之 Flash MCU，適用於具備抗干擾能力、雙向傳輸等應用。
- E. 32 位元標準型 MCU 系列：新增 External Bus Interface (EBI)、I²S 界面與 CRC-16/32，EBI 可提供客戶系統的擴充性如外擴 NOR Flash、SRAM、LCD Panel 8080/6800 Modes 及各種 Memory Mapped 的元件。I²S 方便客戶開發多媒體語音應用相關產品，CRC-16/32 則可加速客戶開發的產品取得歐盟家電產品安規認證；新增 Crystal-less USB 的功能可降低客戶開發產品成本。

(四)長短期業務發展計畫

1. 短期發展計畫

(1)行銷與營運策略

本公司擁有超過 30 年豐富的 IC 設計產業經驗，熟知客戶及市場需求，並擁有數家前段晶圓廠及後段封裝測試廠的全力支援，同時在臺灣/中國/美國建立當地銷售及技術服務據點。因此，本公司擁有高產品競爭力在於提供客戶：

- A. 最好的產品品質(高品質靜電破壞保護及抗雜訊能力)。
- B. 最短的產品交期。
- C. 最佳性價比產品。
- D. 提供一次寫入式(OTP)與多次寫入式(Flash)微控制器產品。
- E. 最快速的在地化技術服務。
- F. 彈性的 ASSP & ASIC 微控制器開發服務。
- G. 專業開發工具與高效 C 語言編譯器。

(2)生產策略：

- A. 維繫與主要晶圓代工廠、封裝廠、測試廠等外包廠商之合作關係，以爭取充足之產能及成本之競爭力。
- B. 建立與合作廠商之生產相關資訊，以便即時掌控生產的進度及數量，達到降低庫存與有效備貨的目標。

(3)產品策略：

- A. 本公司產品發展定位在以 8/32 位元微控制器 IC 為主，加上微控制器週邊 IC 為輔的架構上，提供客戶多元化的彈性選擇。一次購足的便利性以及優異的性能與價格比，使客戶的產品具有強大之市場競爭力。

- B. 產品策略能與市場緊密結合，並維持與客戶合作開發未來產品，以領先同業推出具競爭力之方案。
- C. 本公司以整體系統成本的角度出發，協助客戶降低整體成本以達到雙贏的目的。

(4)研發策略：

本公司將 MCU 核心架構在不同製程平台，並搭配特殊 IP 技術，達到小型化 SoC，在整合過程加強抗雜訊能力與靜電防護能力，達到美、日、歐 MCU 供應商相同工規的技術水準。

2. 長期發展計畫

(1)行銷與營運策略

公司發展策略鎖定以家電、健康量測、金融與安防領域為發展市場，並經由專注研發高品質微控制器開拓國際市場，優異的產品品質及快速的在地服務，不但滿足全球客戶的需求，亦已成功將 HOLTEK 微控制器順利導入全球著名家電大廠，建立起 HOLTEK 全球化的專業品牌形象。公司在 8 位元 MCU 已獲得大廠的認同並導入量產，除了持續精進 8 位元 MCU 產品外，長期亦將持續導入 32 位元 MCU，持續將市佔率擴大，期許未來能進入 MCU 全球排名前十大廠商。

(2)生產策略：

- A. 針對產業淡旺季循環做及早的因應，降低其衝擊。
- B. 持續使用先進製程，降低成本，建立成本優勢。
- C. 佈局臺灣及大陸地區供應鏈，提供最佳交期與最低成本。

(3)產品策略：

- A. 鎖定國內外大廠與具有潛力的市場，進行產品推廣及服務。
- B. 切入更高階之應用領域，如高階大小家電、健康護理、家用三錶、工業設備、安全防護、車用電子、金融加密產品等設備領域。

(4)研發策略：

提升產品設計能力，建立規格化與模組化之開發技術，減少開發時程與開發成本，加速新產品上市之時間並提高價格競爭力。

(5)產品發展項目：

- A. 發展全系列 1.8V~5.5V A/D 型及 LCD 型 Flash MCU，擴充更寬廣的電壓應用領域。
- B. 發展全系列 Tiny Power MCU：整合 Tiny Power 技術於各式 MCU 中降低功耗，達成節能效益。
- C. 發展全系列 Flash MCU：如 I/O、A/D、LCD、A/D with LCD、Tiny Power MCU，提供客戶多樣選擇。
- D. 發展更多應用在健康量測領域的專用 MCU：如血糖儀、血壓計、體脂計、血氧計等應用。
- E. 發展觸控面板專用 MCU，擴大觸控應用領域。

- F. 發展更高階 IP 整合之 MCU:邁向更高階解析度類比數位轉換(24 位元 Delta Sigma AD Converter)。
- G. 發展局部鎖住(Partial Lock)標準型 MCU:局部鎖住 MCU 提供方案公司彈性的智慧財產保護機制,滿足多方分工但各自保密需求,保護具特殊專才供應商智慧財產,刺激產業正面發展,產品應用多樣化,進而擴大市場需求。
- H. 發展 PC 週邊 USB 產品:除了持續發展 PC 週邊 Keyboard/Mouse 外,規劃 USB Full Speed 系列 MCU,並擴大 USB 產品應用,如 USB Speaker/USB Phone/USB Charger/USB Gaming MS & KB/USB Bridge 等。
- I. 發展更具競爭力 Voice MCU:提供更多播放/錄音功能的 Voice MCU,方便客戶開發更高品質的消費性商品,含高功率 1.2W 以上 A/B 類功放整合 Voice 控制及帶電容式觸控 MCU 產品。
- J. 發展全系列高壓 12V A/D 型 Flash MCU:內含 LDO 穩壓電路及高壓輸出,可直接推動繼電器等控制元件。
- K. 發展整合型 Sub 1GHz RF SoC Flash MCU 產品。
- L. 發展適用於各項通訊技術之 MCU:如通用型 2.4GHz、電力線傳輸、FRS、Zigbee、UHF 頻段無線通訊等技術以衍生出各式各樣的應用產品,開發適用於此類 SoC 應用產品的 MCU 為未來之發展方向之一。
- M. 發展 32 位元多腳位標準型 MCU 系列:新增 External Bus Interface,方便客戶系統的擴充性如外擴 NOR Flash、SRAM、LCD Panel 8080/6800 Modes 及各種 Memory Mapped 的元件。
- N. 發展新一代 32 位元馬達控制及指紋辨識系列 MCU:提升運行速度至 96MHz,系統記憶體 Flash 與 SRAM 都加大一倍,以擴大市場的覆蓋率。另外,新增 AES 加解密功能、CRC 運算功能及 I²S 語音應用界面與 SDIO 及 EBI 界面,可方便客戶開發各種具語音多媒體功能與有線/無線資料傳輸等功能的相關產品。
- O. 發展 32 位元低功耗標準型 MCU 系列並結合各項無線傳輸技術:目標是應用在物聯網與穿戴式設備。
- P. 開發電子貨架標籤(ESL)面板顯示驅動 IC:配合電子紙及 LCD 客戶開發專用 IC。
- Q. 推出 ARM[®] Cortex[™]-M0+核心之 32 位元 Flash 微控制器 HT32F523xx 系列和 HT32F522xx 系列產品。全系列均搭配多組高速週邊 USART、UART、SPI、I²C、USB 2.0 FS Device (HT32F523xx)、RTC、Comparator 等硬體資源與使用彈性,適合多種應用領域如:物聯網終端裝置、穿戴式裝置、USB 遊戲週邊、智能家電、家庭自動化、智能玩具、健康量測、消費性電子、資料採集與記錄器等。
- R. 發展 ASSP MCU 專用型系列:依產品專用需求規格設計 MCU。
- S. 發展中、低功率鋰電池充、放電管理及驅動控制之整合型 ASSP MCU:內置多路 PWM 控制,可驅動 DC/DC 升壓/降壓電路及負載驅動,內建硬體 OCP 過流保護及 OVP 過壓保護,有效保護鋰電池充、放電的安全性;適用

各種鋰電池驅動產品，如個人護理及手電筒等產品。

- T. 發展電動工具電源管理 ASSP MCU：包括多串(6 串)鋰電池充電管理 ASSP MCU、電動工具調速開關 ASSP MCU 等產品。
- U. 開發無線充電 ASSP MCU：現已取得 WPC Qi 認證，並持續研發符合 A4WP 磁共振式無線充電技術的 ASSP MCU。
- V. 開發 QC2.0 / QC3.0 及 USB Type C-PD 快速充電 ASSP MCU 產品。
- W. 開發各類傳感器量測 ASSP MCU，如：胎壓計、溫度計、濕度計等產品。
- X. 發展更高規格的 LDO 產品：如更大電流 250mA 輸出與帶有過流、過溫以及逆向電流保護機制之 LDO 系列 IC。
- Y. 發展高輸出電流之 DC/DC 同步升壓轉換器：採用散熱極佳之封裝技術，高度整合外部功率元件，高效率、低功耗與極少的外部元件特色，十分適用於體積限制之行動裝置，如行動電源等產品。
- Z. 發展 AC-DC 電源管理產品線：整合 PWM 及 PFC 的高效率 AC-DC 轉換器。
- AA. 發展小瓦數低成本的 AC-DC 電源管理產品線：整合高壓 MOS(700V) 節省整體電路元件及提供系統可靠度的 IC，目標是應用在小瓦數充電器、手持式裝置充電器以及小瓦數家電。
- BB. 開發下一代移動電源專用管理 IC，搭配硬體電路達成更快速的負載動態響應變化，整合更多的外部電路零件，如提供內部 1%精準電壓源等，使產品整體電路更精簡，達到產品成本降低，效能提升的高競爭力產品。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區

本公司 104 年度銷售地區分佈如下表所示：

單位：新台幣仟元

區域 \ 年度	104 年度	
	銷售額	%
臺灣地區	582,896	15
中國地區	2,734,771	69
其他海外地區	650,173	16
合計	3,967,840	100

2. 市場佔有率

本公司專注於微控制器(MCU)與週邊半導體器件產品之開發，相關產品之應用涵蓋範圍廣大，除了消費(Consumer)、通訊(Communication)、電腦(Computer)及汽車(Car)等 4C 相關領域之外，尚包含非揮發性記憶體 IC、顯示驅動 IC、電源管理 IC、類比 IC、ASSP/ASIC MCU 等，每一類型均已佔有市場一席之地。根據 Gartner(2015)調研報告指出，本公司 2014 年於全球 8 位元 MCU 廠商營收排名第十二名，亦為兩岸三地品牌的第一名，前面 10 名皆為國際大廠。本公司在 2014 年成功取代美系、韓系、日系 MCU 廠，於大陸 8 位元 MCU 市場市佔持續提升，

並成功切入 32 位元 MCU 市場。

本公司與各國際大廠與兩岸 IC 公司在大陸激烈競爭 MCU 市場，持續以高性價比的 8 位元 MCU 逐漸取代國際廠商，順利擴大在大陸的市佔率。本公司 2015 年 MCU 總出貨量超過 4.6 億顆，並期望在 2016 年持續推升，以提升市場佔有率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 供需狀況

市場研究機構 IC Insights 最新報告指出，受中國經濟成長趨緩、油價崩跌與美元強勢等影響，未來五年全球半導體市場仍持續成長，但成長趨緩(CAGR 約 3%)，2016 年全球半導體出貨量預估達 8,867 億顆，整體而言，平均年增率大致有 9% 的表現，預期 2018 年則可望突破一兆顆大關。

IEK 表示，搭上物聯網順風車的半導體廠，應可維持快速成長，且超越整體半導體業，整體物聯網產品數量在 2020 年將高達 330 億個，將創造出下一波半導體市場需求的成長。就產品面來說，臺灣 IC 業者除已在智慧手持裝置晶片、網通晶片等市場獲得不錯成果，面對未來物聯網與情境感知應用的逐漸發酵，不僅對臺灣 IC 龍頭大廠，也預期將對臺灣中小型或新創 IC 業者創造更多的市場契機。

就供給面而言，根據市場研究機構 IC Insights 研究指出，臺灣半導體產業在 2015 年取代韓國，成為全球半導體晶圓廠產能全球第一。根據其統計，臺灣半導體廠商於 2015 年 12 月之產能佔據全球總產能 21.5%，高出韓國的 20.5%。至於中國大陸，由於中國大陸政府積極扶植本土半導體製造業，從 2012 年於晶圓產能就超越歐洲，於 2015 年之產能也高於歐洲 50%。即使如此，中國大陸在整體半導體產能所佔比例，不增反減，卻從 2014 年的 10.9%，微幅下滑至 2015 年 9.7%，主要原因是在中國大陸組裝的大多數電子產品都仰賴半導體零組件的進口。

在封測產業方面，TrendForce 旗下拓璞產業研究所預估，由於產業競爭持續加劇，預估 2016 年 IC 封測產值年成長則呈現微幅下滑 0.5%，整體規模達 506.2 億美元。另外，中國大陸在政府政策及本土市場快速發展的驅動下，再加上購併效益，其封測市占率快速提升，不過高階技術發展及良率穩定度仍為長期發展之關鍵觀察。

(2) 未來成長性

根據 IC Insights 的市場研究報告中指出，2015 年全球 MCU 市場產值達 168 億美元(比 2014 年增長 5.6%)，出貨量達 209 億顆(比 2014 年提升 12.4%)，而平均每顆售價則是 0.81 美元。而未來到 2019 年，MCU 的銷售量仍維持逐年遞增(年複合成長率 CAGR 約為 6%)、ASP 逐年遞減的趨勢，但整體 MCU 市場規模仍是上揚的。

展望未來幾年後市，IC Insights 也指出，IC 以及光學、感測與離散元件(OSD)是今年主要成長的產品類別，主要用於智慧型手機、新型汽車電子系統，以及相關物聯網應用。其中 IC 產品類別中，又以 32 位元微控制器(MCU)成長幅度 29%居冠、無線通訊和類比 IC 等有 15%成長，驅動 IC 等成長幅度也有 12%。

物聯網行業的快速發展是驅動 MCU 發展的一大動力，此外，物聯網領域的智慧應用正蓬勃發展，比如醫療電子用品(如智慧血糖儀、電子血壓計等)、個人健康監測產品(如智慧手環、智慧手錶等)，這些需要低功耗、長時間使用、無線通訊的產品，也必須倚賴 MCU 來實現。本公司產品多以 8 位元為主，隨著物聯網時代任務的複雜化，對計算能力越來越高促使 MCU 開始邁向 32 位元來設計，執行效能更佳，應用類型也相當多元。根據 IC Insights 2014 年的資料，以出貨量計，32 位元 MCU 已經接近 8 位元 MCU，而銷售額 32 位元 MCU 已經躍升第一位，本公司 32 位元 MCU 出貨量已從 2014 年 250K 顆，年增 154.40%達 636K 顆，2015 年本公司全年 MCU 出貨量達 4.65 億顆，其中仍以 8 位元產品為主。展望 2016 年，隨著物聯網新應用市場需求在今年明顯增溫，加上去年完成卡位的健康量測、安防、銀行金融等應用市場穩定成長，本公司今年度 MCU 的年出貨量目標繼續朝向五億顆的門檻挑戰。

惟當前市面上各種移動電子產品需要頻繁充電，各家均致力於降低功耗，提升續航能力，所以除了三星、樂金(LG)、摩托羅拉(Motorola)的智慧手機已搭載無線充電，蘋果(Apple)亦追隨這股熱潮，根據 IHS 預估，2016 年將有一百萬個無線充電器被安置於公共基礎建設，加上當更多消費者使用具無線充電功能的智慧手機，連帶也會吸引旅館、餐廳和其他商業場所提供免費且方便的無線充電。本公司也推出了四合一無線充電產品，以高性價比積極布局無線充電，並加入快充識別功能，搶攻快充市場。

以 2016 年來看，本公司將會在安全防護、穿戴式裝置及智慧家居這三個市場收成，其中智慧家居因為陸系家電廠商積極佈局，也將有助於本公司在 32 位元 MCU 市場上挑戰國際大廠。國際研究暨顧問機構 Gartner 預估，2016 年將賣出 2.75 億台穿戴式裝置，比 2015 年的 2.32 億台成長 18.4%，而總體銷售額將達 287 億美元。在安全防護上，除安全監控外，亦布局於環境監控，執行環境檢測、精密溫溼度控制及空氣淨化掌握。

市場研究機構 IHS 統計，2015 年指紋感測器出貨量約達 4.99 億顆，較 2014 年的 3.16 億顆，成長 58%。本公司與金估科技合作於 2015 年推出獨創的光電混合式指紋辨識模組，讓原本過厚的產品變薄至 1mm，解析度達 1000dpi，將先以銀行、安控、智慧家庭等應用為主，未來再逐步擴散到市場規模更大的手機、平板電腦市場等市場。

4. 競爭利基

IC 設計業為高度智慧型、腦力密集且技術層次高的行業，充足的研發人才、電腦輔助設計和測試設備成為 IC 設計業的基本重要條件。

本公司歷經多年的經營，累積豐富的人才、技術研發和產品應用經驗，具體掌握核心技術，產品系列完整且多樣化且不斷推出新創意，新產品均擁有更強功能、更高品質、更低價格、符合客戶的需求和具備市場競爭力為整體發展目標。

(1) 研發能力強，產品領先群倫：

長期積極開發人力資源，延攬國內外優秀設計人員，並透過教育訓練，傳授技巧累積經驗，分工合作建立有效率的研發團隊，延續並發揚技術之優勢，

開發更新更有競爭力的 IC。

(2) 更新輔助設計器材與測試設備：

藉由精密的儀器設備，提升人員的工作效率，產品的穩定性和可靠性，並藉由客戶和市場之互動，開發出符合市場之高技術的應用 IC。

(3) 完整的全球行銷網路：

擁有臺灣、香港、深圳、東莞、廈門、上海、蘇州、杭州、北京、成都、青島、美國和東北亞、東南亞、南美洲、歐洲等世界各地的代理或經銷網，可迅速的蒐集市場訊息，掌握先機，並透過國內外銷售據點，做到快速的銷售和售後服務與技術支援。

(4) 上游工廠關係穩固：

與上游晶圓代工、封裝、測試工廠關係良好，除了確保貨源穩定供應不缺外，更能以長期合作、大量生產獲得較低的價格優勢，提高本公司之長期競爭力。

(5) 管理制度良好：

本公司取得 ISO9001 及 ISO14001 品質認證，所有作業系統流程都有標準化和規格化的管理，產品品質穩定深受客戶滿意。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

大部份 IC 設計業均以特定產業或專業產品來經營市場，由於資源集中且經驗累積迅速，在專業產品上較具優勢，但是面對強力競爭者挑戰或市場大變動時，其穩健度與反應能力就遠不及能提供不同應用及不同客戶需求的設計公司。因此，本公司即以提供各項產品應用與全方位服務為發展目標，目前掌握之競爭優勢如下：

A. 領先且完整的產品系列

(A) 由於自有 IP 日益豐富與設計能力提升，可按客戶需求快速提供 ASSP/ASIC MCU 等集成度高的 IC，並提供參考設計的完整解決方案，增加 IC 功能與客戶產品的競爭力。

(B) 產品橫跨多種產業，可有效降低市場風險。

(C) 公司的營業成長目標較具空間與彈性。

B. 全球行銷網的建立

(A) 有效建立區域行銷據點，以提供及時且在地化的產品技術服務，更能正確反應市場需求；在地化服務包含發展工具、FAE、安規驗證、軟體服務等。

(B) 長期建立的經銷體系已遍佈全球，順暢的行銷管道有助於整體產品的推展與營業額的擴張，並已獲美/歐/日/韓等國際大廠認證並採用。

(C) 持續重視客戶的開發與維護，以奠定穩健的市場基石。

(D) 產銷的結合，積極與客戶培養長期性互惠支援關係。

(E) 與上下游產業結盟以強化依存性及競爭力。

(F) 藉電腦化支援系統，使預估銷售需求、生產下線排程、庫存、委外加

工等作業皆能充分發揮產銷協調之功能，有效的產品速動管制作業使達到成本最低化、產值最大化、服務最佳化成果。

C. 產品開發能力

(A) 多年經驗累積之優良研發技術。

(B) 強大的研發團隊。

(C) 藉由策略性合作、產學合作等方式引進新技術，加速產品及技術升級。

D. 整體環境支援

(A) 產業支援集中，可增強經營效益。

(B) 產業專業分工，可增高合作及依存性。

(C) 產業整合度高且競爭性強，可提升產品優勢。

(2) 不利因素及因應之道

A. 國內外產品相似性太高，造成惡性競爭而獲利降低，必須提升產品技術層次及產品品質以避開衝突，並開發系列性產品及 ASSP 產品以滿足各種客戶需求，以取得獨特優勢。

B. 歐美大廠產品壓低售價的競爭，將以優勢的性價比，並配合以更好更迅速的服務及提供完整的設計方案，取得客戶的認同與採用。

C. 產品生命週期縮短，開發費用增高，所以開發環境的改善及市場資訊的蒐集務求又快又準，以取得先機。

D. 面對整合元件廠的強力競爭，必須與晶圓代工廠及封裝測試廠商策略聯盟以取得必要之競爭能力。

E. 在智慧財產權保護聲浪高漲下，IC 設計業生存空間縮小，必須持續增加智財權實力，努力提升產品之主導性。

F. 面臨大陸設計業的蓬勃發展，加上蓄意對智財權的忽視，臺灣 IC 設計同業均已受到威脅與影響，本公司除更積極於產品的發展動作，以產品轉型、多樣化及提升更高品質來鞏固市場外，更透過法律途徑保障本公司權益。

G. 部份客戶對臺灣品牌初期採用的信心度可能較低，本公司選擇合適之客戶進行長期合作，達到量產階段，以提升本公司在此產業之知名度。另外，產品組合不足部份，短期作法為積極尋求產品有互補性之廠商進行策略聯盟，共同推廣市場；長期則將透過技術引進等作法，來增加產品範圍之完整性與廣度。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

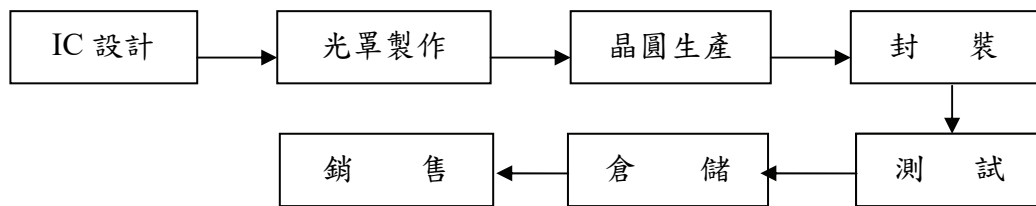
1. 主要產品之重要用途

主要產品	用 途
微控制器 MCU 產品	應用於家電產品、健康量測產品、汽機車、工業儀表控制、量測、消費性電子、觸控產品、通訊產品及電腦產品。
顯示驅動產品	應用於家電產品、教育、育樂產品、儀器、觸控產品、居家安全、防盜器、健康醫療器材及汽車應用等顯示驅動產品，含 LCD、VFD 及 OLED。

主要產品	用 途
電源管理產品	應用在各式電腦及消費性產品電源管理應用，含穩壓、偵壓、DC-DC 及 AC-DC 轉換應用。
記憶體產品	使用於電腦、通訊、消費電子、育樂產品及智慧型金融卡等。

2. 產品產製過程

- (1) 產品製造過程：本公司以設計及行銷為主，產品之前後段製造皆以委外生產為輔。



(2) 晶圓代工資源

本公司產品之晶圓代工資源，均為國內外知名大廠如聯電、台積電、漢磊、旺宏等，並建立長久之產品開發與生產合作關係。

(3) 封裝

與多家廠商以產能分工之長期合作模式進行如超豐、華泰等，確保封裝產能無虞。

(4) 測試

與多家測試廠合作，如超豐、久元等提供本公司需要之測試技術與設備，並可提供充份之產能。

(5) 倉儲作業

A. 主要儲存物品：

(A) 種類分為：晶圓/晶粒/封裝 IC/半成品/物料。

(B) 測試狀態分為：已測/未測。

(C) 依可用性分為：良品/不良品/報廢品。

B. 良好的倉儲規劃及管理與品質保證：

(A) 自動倉儲作業。

(B) 儲存物品之品質維護。

(C) 貨物進出的管理與正確性。

(D) 主動追蹤貨品週轉效率。

(三) 主要原料之供應狀況

本公司產品為高精密度積體電路，主要原材料為矽晶圓，主要原料供應廠商均為國內外之世界知名大廠，品質佳且來源穩定，其中更與聯電、台積電、漢磊、旺宏建立長期及良好之生產合作關係，保持晶圓代工資源之優勢，並更積極尋求其他國內外之晶圓代工廠之支援，以支應公司成長之需求。

(四) 最近二年度任一一年度中占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	103 年度				104 年度				當年度截至 105 年 3 月 31 日止(註 2)			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A	845,496	41	無	A	932,018	43	無	A	209,212	40	無
2	B	277,049	13	無	B	279,347	13	無	B	64,570	12	無
3	C	268,248	13	無	C	168,371	8	無	C	29,825	6	無
4	其他	697,099	33	無	其他	774,495	36	無	其他	218,846	42	無
	進貨淨額	2,087,892	100		進貨淨額	2,154,231	100		進貨淨額	522,453	100	

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：當年度截至 105 年 3 月 31 日之財報資料為經會計師核閱之合併財務資料。

主要供應商變動原因：

本公司與上、下游廠商皆維持良好默契與關係，近二年度主要產能因市場供需狀況及成本因素，致各廠商進貨金額有增減外，尚無明顯之重大變化。

2. 最近二年度銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	103 年度				104 年度				當年度截至 105 年 3 月 31 日止(註 2)			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季度止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	欣宏	470,973	12	本公司子公司採權益法評價之被投資公司	欣宏	530,751	13	本公司子公司採權益法評價之被投資公司	欣宏	140,802	16	本公司子公司採權益法評價之被投資公司
2	其他	3,459,546	88		其他	3,437,089	87		其他	767,284	84	
	銷貨淨額	3,930,519	100		銷貨淨額	3,967,840	100		銷貨淨額	908,086	100	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：當年度截至 105 年 3 月 31 日之財報資料為經會計師核閱之合併財務資料。

主要銷貨客戶變動原因：

本公司與客戶均保持良好的合作關係，且透過香港分公司直接出貨拓展海外銷售外，與其他客戶銷貨集中度不大，主要客戶會隨著市場開拓及景氣供需影響銷貨產生增減變動。

(二)最近二年度生產量值表

單位：仟粒/新台幣仟元

生產 量值 主要商品	年 度	103 年度			104 年度		
		產能	產量	產值	產能	產量	產值
微控制器 IC		--	469,559	1,451,282	--	477,848	1,487,903
週邊 IC		--	325,967	565,223	--	379,344	548,997
開發工具及設計收入		--	38	8,938	--	148	20,135
總 計		--	795,564	2,025,443	--	857,340	2,057,035

註 1：本公司所研發設計之產品，主要係委託晶圓代工廠製造，再委外測試、封裝，並無自有產能限制。

註 2：本公司產品之生產全部委外製造，包括晶圓代工及後段封裝測試，生產量的多寡全部依據當年度之銷售預估，產值與銷售金額成正比。

(六) 最近二年度銷售量值表

單位：仟粒/新台幣仟元

銷售 量值 主要商品	年 度	103 年度				104 年度			
		內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
微控制器 IC		48,194	367,352	417,973	2,375,583	51,133	407,806	413,374	2,383,613
週邊 IC		44,070	168,399	291,954	1,003,572	46,091	168,634	327,069	975,398
開發工具及設計收入		8	3,056	43	12,557	17	6,456	116	25,933
總 計		92,272	538,807	709,970	3,391,712	97,241	582,896	740,559	3,384,944

三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

日期：105 年 3 月 31 日

年度		103 年底	104 年底	當年度截至 105 年 3 月 31 日
員工	工程人員	466	504	509
	管理人員	125	129	132
人數	生產測試人員	28	37	42
	合計	619	670	683
平均年歲		35.64	35.48	35.48
平均服務年資		6.78 年	6.14 年	6.15 年
學歷 分布 比率	博 士	0.8%	0.6%	0.6%
	碩 士	27.1%	26.4%	26.5%
	大 專	63.2%	64.0%	63.8%
	高中(含以下)	8.9%	9.0%	9.1%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失及處分之總額，其未來因應對策及可能之支出：無。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施

(1)公司福利

本公司設有餐廳、員工休閒活動區、運動健身器材區、韻律教室、醫務休息室等設施，並舉辦團體保險、定期員工健康檢查等活動，且設有專業醫護人員，提供員工健康管理及健保服務。

(2)職工福利

福委會每年定期舉辦員工旅遊，各項遊戲競賽、年終聚餐、尾牙晚會摸彩等活動，除此之外，還包括生日禮金、年節禮券、旅遊、婚喪、生育、住院等皆有補助。為促進各種康樂社團，以增進員工團結及情誼，成立各類型之社團活動，並提供社團經費補助，例：桌球社、羽球社、瑜珈社、桌遊社…等，鼓勵同仁利用工作之餘也能平衡生活，藉以養成運動風氣、提高生活樂趣。

2.進修與教育訓練

本公司對人才的培育一直不遺餘力，除編列預算供員工在外進修外，並由教育訓練委員會、行政部及部門主管針對公司發展目標及各部門需求設計內部訓練課程，讓每位員工在完整的工作生涯培訓體系下成長：

(1) 職前訓練(新人訓練)：

- A.公司文化融入與陶冶：公司統一有新進人員訓練，讓新人了解熟悉本公司組織概況、人事規章、品質政策、工業安全與衛生、人物與環境而實施之訓練。
- B.工作上專業訓練：新進人員有資深工程師擔任指導員，針對相關工作職務規劃完整的培訓課程，幫助基礎設計技術建立及設計環境熟練。

(2) 在職訓練：

- A.部門自辦訓練：各部門會針對其專業需求，要求工程師參與部門自辦專長訓練。
- B.公司內部訓練：內部設有教育訓練委員會依據各部門專業需求，聘請專業講師至公司進行長期的專業訓練課程，包括專業技術培訓課程、管理技能培訓課程、品質培訓課程、工安衛生培訓課程、法務智權培訓課程及電腦培訓等多元而充實的訓練課程。
- C.線上學習課程：建立教育訓練平台，整合所有課程訊息、訓練系統及資料查詢，發展 e-learning 及知識管理系統，建立網路教學滿意度調查機制。
- D.公司外部訓練：每人每年固定提供培訓課程經費，可依個人計劃需求安排參與其他外部專業訓練。
- E.104 年員工內、外教育訓練實際執行情形：

	總時數	總人數
一般管理	239	40
專業技術	1,141.5	746
新人訓練	472	59

(3) 在職進修：

資深工程師可申請國內大學在職進修計劃，增進其專業研究發展技術與管理能力以配合公司未來發展與永續經營的需要。

(4) 自我發展：

除培養員工之專業能力，使其能在技術上建立自信心，進而訓練成計劃主持人，在計劃管理上感受團隊合作經驗及建立；另外培養資深員工為公司中堅幹部，依職級需求參與基層、中階、高階主管管理訓練，以提升經營管理能力及績效。

3.退休制度與其實施情形

(1) 退休金提繳：

- A.本公司訂有退休辦法並設置勞工之退休準備金監督委員會，依勞動基準法暨勞工退休準備金提撥及管理辦法規定，每月以實際職工薪資總額之 2%提撥退休基金，並以專戶存於臺灣銀行。
- B.本公司另依勞工退休金條例之規定，對適用勞工退休金條例之員工以每月工資 6%之提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

(2) 退休制度

- A.自請退休：本公司從業人員有下列情形之一者，得自請退休
- (A)在公司服務十五年以上，實際年齡滿五十五歲者。
- (B)在公司服務二十五年以上者。

(C)在公司服務十年以上，實際年齡滿六十歲者。

B.強制退休：本公司從業人員非有下列情形之一者，本公司不得強制其退休

(A)年滿六十五歲者。

(B)心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

C.退休金計算標準：本公司從業人員適用勞動基準法之退休金工作年資，其退休金之計算標準如下：

(A)年資之計算：從業員工在公司之工作年資自受僱日起算。

(B)基數計算：

a.在公司服務年資十五年以內者每年給予兩個基數。

b.在公司服務年資十五年以上者，前十五年每年給予兩個基數，超過十五年之部份每年給予一個基數。

c.總數以四十五個基數為限。

(C)畸零年資：

a.未滿半年以半年計。

b.滿半年未滿一年以一年計。

(D)基數：核准退休時一個月平均工資。

(E)平均工資：以退休前六個月之平均工資計算。

(F)強制退休之從業人員，其心神喪失或殘廢係因執行職務所致者，依上述規定加給 20%。

D.給付期限：退休金之給付於核准或強制退休之日起三十日內一次給付之。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司定期每季召開勞資相關會議，需要討論議案均經勞資雙方充分溝通，達成共識後執行，迄今勞資間關係良好，雇主與員工之間互動密切。

本公司設有行政人事專責單位制定各項符合相關勞基法令規定之制度及措施，保障員工之各項權益，若員工有任何意見，均可透過各種溝通管道向各級主管及行政單位反應及爭取權益。

5.員工行為與倫理守則

本公司訂定「道德行為準則」、「員工守則」及「同仁廉潔守則」規範全體同仁對於經管或監督之業務，不得利用職務之便，行直接或間接圖利之行為，以獲取不當利益或其他舞弊情事，並將上述規範納入公司規章及新進人員訓練教材中，定期對全體新進人員作宣導。

6.工作環境與員工安全保護措施

本公司於 2006 年取得國際 OHSAS18001 職業安全衛生管理認證，並推動各項員工安全衛生業務的持續改善活動，包括安全衛生相關訓練，創造優良的工作環境，並保護員工身心健康與安全。

(1)門禁安全：除大樓之保全人員 24 小時守衛外，並加強夜間、假日保全管理，以保障員工人身安全。

(2)消防安全：

- A.定期委請廠商進行保養及維修消防設備(例:消防警報器、滅火器)，並設有專責人員定期檢視後做成記錄。
- B.每年定期舉辦消防演習及緊急避難措施，推行全員預防認知責任。
- (3)環境安全：為維護員工飲用水衛生品質及健康，每季委請廠商進行抽樣檢測飲用水機之大腸桿菌群，並定期實施辦公室清潔與消毒作業，以確保工作環境安全與舒適。
- (4)員工健康檢查：本公司每年定期委託醫療機構特別至公司安排員工各項身體健康檢查，並設有專門之醫護人員提供醫護服務，以及每二個月安排專業醫師至公司看診及舉辦健康講座，注重員工身心健康。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
土地租賃	新竹科學工業園區管理局	90/03/15~109/12/31	租賃自建廠房用土地	限自建廠房用
技術開發	財團法人工業技術研究院	94/11/30~106/11/29	從事 Surveillance Camera DSP IP 技術開發計畫	不得違反相關法令之規定
技術授權	ARM Limited	96/06/25~永久	ARM Cortex-M3 技術授權	不得違反相關法令之規定
技術授權	ARM Limited	102/09/24~永久	ARM Cortex-M0+技術授權	不得違反相關法令之規定
技術授權	晶心科技	104/04/01~107/03/31	Andestech D10 CPU Softcore 技術授權	不得違反相關法令之規定

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一) 國際財務報導準則-合併資訊

1.簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)					當 年 度 截 至 105 年 3 月 31 日 財 務 資 料 (註 2)
		100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	
流 動 資 產		不 <					

註1：財務報表均經會計師查核簽證。

註2：當年度截至105年3月31日財務資料為經會計師核閱之合併財務季報告。

2.簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)					當 年 度 截 至 105 年 3 月 31 日 財 務 資 料 (註 2)
	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	
營 業 收 入	不 適 用	3,555,952	3,894,361	3,930,519	3,967,840	908,086
營 業 毛 利		1,569,012	1,823,338	1,888,747	1,948,478	447,595
營 業 損 益		582,312	755,589	817,495	846,550	173,101
營 業 外 收 入 及 支 出		65,560	126,443	121,024	100,153	22,033
稅 前 淨 利		647,872	882,032	938,519	946,703	195,134
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利		561,049	747,800	798,584	818,321	169,120
停 業 單 位 損 失		—	—	—	—	—
本 期 淨 利 (損)		561,049	747,800	798,584	818,321	169,120
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)		(4,607)	36,453	30,596	(25,886)	(4,366)
本 期 綜 合 損 益 總 額		556,442	784,253	829,180	792,435	164,754
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主		560,194	744,945	791,556	806,806	168,076
淨利歸屬於非控制權益		855	2,855	7,028	11,515	1,044
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主		555,656	781,291	822,225	780,920	163,710
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益		786	2,962	6,955	11,515	1,044
每 股 盈 餘		2.51	3.32	3.50	3.57	0.74

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：當年度截至 105 年 3 月 31 日財務資料為經會計師核閱之合併財務季報告。

(二) 國際財務報導準則-個體資訊

1.簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年 項 目 度		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)					當 年 度 截 至
		100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	105 年 3 月 31 日 財 務 資 料
流 動 資 產		不 <					

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

2.簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)					當 年 度 截 至 105 年 3 月 31 日 財 務 資 料
	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	
營 業 收 入	不 適 用	3,365,511	3,599,332	3,605,717	3,601,285	不 適 用
營 業 毛 利		1,489,273	1,632,693	1,685,380	1,719,836	
營 業 損 益		602,338	730,155	794,650	810,424	
營 業 外 收 入 及 支 出		43,575	147,616	132,769	119,254	
稅 前 淨 利		645,913	877,771	927,419	929,678	
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利		560,194	744,945	791,556	806,806	
停 業 單 位 損 失		—	—	—	—	
本 期 淨 利 (損)		560,194	744,945	791,556	806,806	
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)		(4,538)	36,346	30,669	(25,886)	
本 期 綜 合 損 益 總 額		555,656	781,291	822,225	780,920	
淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主		560,194	744,945	791,556	806,806	
淨 利 歸 屬 於 非 控 制 權 益		—	—	—	—	
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 母 公 司 業 主		555,656	781,291	822,225	780,920	
綜 合 損 益 總 額 歸 屬 於 非 控 制 權 益		—	—	—	—	
每 股 盈 餘		2.51	3.32	3.50	3.57	

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

1.簡明資產負債表

年 度		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)							
		100 年	101 年	103 年	103 年	104 年			
項 目									
流 動 資 產		3,464,859	3,391,453	不	不	不			
基 金 及 投 資		607,735	609,217						
固 定 資 產		321,971	499,430						
無 形 資 產		—	—						
其 他 資 產		87,375	64,393						
資 產 總 額		4,481,940	4,564,493						
流動負債	分配前	771,654	796,785						
	分配後	1,285,931	1,355,781						
長 期 負 債		—	—						
其 他 負 債		74,679	100,544						
負債總額	分配前	846,333	897,329	適	適	適			
	分配後	1,360,610	1,456,325						
股 本		2,235,985	2,235,985						
資 本 公 積		83,257	83,257						
保留盈餘	分配前	1,290,499	1,336,416						
	分配後	776,222	777,420						
金 融 商 品 未 實 現 損 益		—	—				用	用	用
累 積 換 算 調 整 數		18,008	2,862						
非 控 制 權 益		7,858	8,644						
未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失		—	—						
股東權益	分配前	3,635,607	3,667,164						
	分配後	3,121,330	3,108,168						

-90-

2.簡明損益表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)				
	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
營 業 收 入	3,519,371	3,555,952	不 適 用	不 適 用	不 適 用
營 業 毛 利	1,525,635	1,566,333			
營 業 損 益	539,900	582,312			
營 業 外 收 入 及 利 益	108,715	83,208			
營 業 外 費 用 及 損 失	15,071	17,648			
繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益	633,544	647,872			
繼 續 營 業 部 門 損 益	526,687	561,049			
停 業 部 門 損 益	—	—			
非 常 損 益	—	—			
會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數	—	—			
本 期 損 益	526,687	561,049			
每 股 盈 餘 (元)	2.36	2.51			

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

1.簡明資產負債表

年 度 項 目		最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)							
		100 年	101 年	102 年	103 年	104 年			
流 動 資 產		3,114,936	2,967,389	不	不	不			
基 金 及 投 資		992,130	1,276,164						
固 定 資 產		252,034	233,177						
無 形 資 產		—	—						
其 他 資 產		86,103	62,285						
資 產 總 額		4,445,203	4,539,015						
流動負債	分配前	742,426	779,765						
	分配後	1,256,703	1,338,761						
長 期 負 債		—	—						
其 他 負 債		75,028	100,730						
負債總額	分配前	817,454	880,495	適	適	適			
	分配後	1,331,731	1,439,491						
股 本		2,235,985	2,235,985						
資 本 公 積		83,257	83,257						
保留盈餘	分配前	1,290,499	1,336,416						
	分配後	776,222	777,420						
金 融 商 品 未 實 現 損 益		—	—				用	用	用
累 積 換 算 調 整 數		18,008	2,862						
未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失		11,798	1,190						
股東權益	分配前	3,627,749	3,658,520						
	分配後	3,113,472	3,099,524						

-92-

2.簡明損益表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料(註 1)				
	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
營 業 收 入	3,319,526	3,365,511	不 適 用	不 適 用	不 適 用
營 業 毛 利	1,449,620	1,489,273			
營 業 損 益	531,504	602,338			
營 業 外 收 入 及 利 益	110,106	60,923			
營 業 外 費 用 及 損 失	9,442	17,348			
繼 續 營 業 部 門 稅 前 損 益	632,168	645,913			
繼 續 營 業 部 門 損 益	526,775	560,194			
停 業 部 門 損 益	—	—			
非 常 損 益	—	—			
會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數	—	—			
本 期 損 益	526,775	560,194			
每 股 盈 餘 (元)	2.36	2.51			

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

(五) 最近五年度簽證會計師姓名及其查核意見

年度	簽證會計師	所屬單位名稱	查核意見
100	游萬淵、魏興海	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
101	魏興海、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
102	魏興海、曾漢鈺	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
103	魏興海、曾漢鈺	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見
104	曾漢鈺、游萬淵	安侯建業聯合會計師事務所	無保留意見

二、最近五年度財務分析

(一) 國際財務報導準則—合併資訊

年 度 (註 1) 分析項目 (註 3)		最近五年度財務分析 (註 1)					當年度截至 105年3月31日 財務資料(註 2)
		100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	
財務 結構 (%)	負債占資產比率	不 適 用	19	19	20	20	18
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		737	796	832	873	917
償債 能力 %	流動比率		434	448	446	447	511
	速動比率		360	386	387	378	428
	利息保障倍數		—	—	—	—	—
經營 能力	應收款項週轉率(次)		7.10	6.84	6.07	5.85	5.66
	平均收現日數		51	53	60	62	65
	存貨週轉率(次)		3.56	3.83	4.02	3.71	3.01
	應付款項週轉率(次)		4.34	4.47	4.40	4.29	4.07
	平均銷貨日數		103	95	91	98	121
	不動產、廠房及設備週轉率(次)		8.68	7.82	7.96	8.34	7.86
	總資產週轉率(次)		0.78	0.79	0.78	0.78	0.70
獲利 能力	資產報酬率(%)		12	16	16	16	13
	權益報酬率(%)		15	20	20	20	16
	稅前純益占實收資本額比率(%)		29	39	41	42	35
	純益率(%)		16	19	20	20	19
	每股盈餘(元)		2.51	3.32	3.50	3.57	0.74
現金 流量	現金流量比率(%)		72	117	114	90	51
	現金流量允當比率(%)		116	126	124	110	95
	現金再投資比率(%)		1	9	5	(1)	(2)
槓桿 度	營運槓桿度		1.00	1.96	1.86	1.90	2.11
	財務槓桿度		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達 20%者可免分析)

1、 現金流量比率較 103 年度下降，主要係 104 年度營業活動之淨現金流入減少所致。

2、 現金再投資比率較 103 年度下降，主要係 104 年度營業活動之淨現金流入減少所致。

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：當年度截至 105 年 3 月 31 日財務資料為經會計師核閱之合併財務季報告。

註 3：分析項目之計算公式如後。

(二) 國際財務報導準則—個體資訊

年 度 (註 1) 分析項目 (註 2)		最近五年度財務分析 (註 1)					當年度截至 105年3月31日 財務資料
		100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	
財務 結構 (%)	負債占資產比率		19	19	19	19	
	長期資金占不動產、廠房及設備比率		1,568	1,905	2,094	2,174	
償債 能力 %	流動比率		402	414	416	416	
	速動比率		331	356	362	352	
	利息保障倍數		—	—	—	—	
經營 能力	應收款項週轉率(次)	不	7.13	6.81	5.99	5.66	不
	平均收現日數		51	54	61	64	
	存貨週轉率(次)		3.76	4.10	4.38	4.09	
	應付款項週轉率(次)	適	4.42	4.53	4.45	4.35	適
	平均銷貨日數		97	89	83	89	
	不動產、廠房及設備週轉率(次)		13.87	16.31	17.99	19.05	
	總資產週轉率(次)		0.75	0.74	0.72	0.73	
獲利 能力	資產報酬率(%)	用	13	16	16	16	用
	權益報酬率(%)		15	20	20	20	
	稅前純益占實收資本額比率(%)		29	38	41	41	
	純益率(%)		17	21	22	22	
	每股盈餘 (元)		2.51	3.32	3.50	3.57	
現金 流量	現金流量比率(%)		74	119	108	88	
	現金流量允當比率(%)		113	122	118	103	
	現金再投資比率(%)		0	8	3	(2)	
槓桿 度	營運槓桿度		1.01	1.81	1.73	1.76	
	財務槓桿度		1.00	1.00	1.00	1.00	
請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達 20%者可免分析)							
1、現金流量比率較 103 年度下降，主要係 104 年度營業活動之淨現金流入減少所致。							
2、現金再投資比率較 103 年度下降，主要係 104 年度營業活動之淨現金流入減少所致。							

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：分析項目之計算公式如後。

財務分析計算公式

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

(三) 我國財務會計準則—合併資訊

年 度 分析項目（註 2）			最 近 五 年 度 財 務 分 析（註 1）				
			100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
財務結構 (%)	負債占資產比率		19	20	不 		

註1：財務報表均經會計師查核簽證。

註2：分析項目之計算公式如後。

(四) 我國財務會計準則——個體資訊

年 度			最 近 五 年 度 財 務 分 析 (註 1)				
			100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
分析項目 (註 2)							
財務結構 (%)	負債占資產比率		18	19	不 適 用	不 適 用	不 適 用
	長期資金占固定資產比率		1,439	1,569			
償債能力 %	流動比率		420	381			
	速動比率		353	315			
	利息保障倍數		—	—			
經營能力	應收款項週轉率 (次)		7.65	7.13			
	平均收現日數		48	51			
	存貨週轉率 (次)		3.40	3.76			
	應付款項週轉率 (次)		3.82	4.42			
	平均銷貨日數		107	97			
	固定資產週轉率 (次)		17.52	13.87			
	總資產週轉率 (次)		0.75	0.74			
獲利能力	資產報酬率 (%)		11	12			
	股東權益報酬率 (%)		14	15			
	占實收資本比率 (%)	營業利益	24	27			
		稅前純益	28	29			
	純益率 (%)		16	17			
	每股盈餘 (元)		2.36	2.51			
現金流量	現金流量比率 (%)		115	68			
	現金流量允當比率 (%)		148	113			
	現金再投資比率 (%)		4	0			
槓桿度	營運槓桿度		2.03	1.82			
	財務槓桿度		1.00	1.00			

請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)：不適用

註 1：財務報表均經會計師查核簽證。

註 2：分析項目之計算公式如後。

財務分析計算公式

1.財務結構

- (1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
- (2)長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／ 固定資產淨額。

2.償債能力

- (1)流動比率＝流動資產／流動負債。
- (2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
- (3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

- (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
- (2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。
- (3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
- (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
- (5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。
- (6)固定資產週轉率＝銷貨淨額／平均固定資產淨額。
- (7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

- (1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／ 平均資產總額。
- (2)股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。
- (3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
- (4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

- (1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
- (2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。
- (3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

- (1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／ 營業利益。
- (2)財務槓桿度＝營業利益／ (營業利益－利息費用)。

三、最近年度財務報告之監察人審查報告：詳見第 100 頁。

四、最近年度財務報告：詳見第 101 頁～第 144 頁。

五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告：詳見第 145 頁～第 184 頁。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

三、最近年度財務報告之監察人審查報告

盛群半導體股份有限公司 監察人查核報告書

董事會造送本公司一〇四年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表已委請安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺及游萬淵會計師查核完竣，並出具查核報告書在案。上述表冊及報告經本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上。

此 致

本公司一〇五年股東常會

盛群半導體股份有限公司

監察人：王仁宗



林嘉茂



新耕投資有限公司

代表人：周玲娜



中 華 民 國 一 〇 五 年 三 月 三 日

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

盛群半導體股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達盛群半導體股份有限公司及其子公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

盛群半導體股份有限公司業已編製民國一〇四年度及一〇三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

曾漢鈺
游萬勛



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號
民國一〇五年一月二十五日



盛群半導體股份有限公司
其子公司

民國一〇四年三月三十一日

單位：新台幣千元

		104.12.31		103.12.31		103.12.31	
		金	%	金	%	金	%
資產：							
流動資產：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 680,400	14	1,179,235	23	2150	3
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 (附註六(二))	214,512	4	158,476	3	2170	7
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三))	94,901	2	102,956	2	2201	-
1180	應收關係人款項(附註七)	585,618	12	571,953	11	2230	4
130X	存貨(附註六(四))	588,609	12	500,981	10	2300	2
1476	其他金融資產－流動(附註六(五)及八)	1,639,025	32	1,294,657	26		1
1470	其他流動資產	21,457	-	21,900	-		17
非流動資產：		3,824,522	76	3,830,158	75		2
1550	採用權益法之投資(附註六(六))	429,270	8	399,112	8		1
1543	以成本衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	229,750	5	229,750	5		3
1600	不動產、廠房及設備(附註六(七))	463,561	9	487,863	10		20
1840	遞延所得稅資產(附註六(十))	42,077	1	37,897	1		
1900	其他非流動資產	74,857	1	74,786	1		
		1,239,515	24	1,229,408	25		45
資產總計		<u>\$ 5,064,037</u>	<u>100</u>	<u>5,059,566</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,059,566</u>	<u>100</u>
負債及權益：							
流動負債：							
應付票據							
應付帳款							
應付關係人款項(附註七)							
應付薪資及獎金							
本期所得稅負債							
其他流動負債							
非流動負債：							
遞延所得稅負債(附註六(十))							
淨確定福利負債(附註六(九))							
存入保證金							
負債總計		<u>1,017,841</u>	<u>20</u>	<u>1,001,959</u>	<u>20</u>	<u>1,017,841</u>	<u>20</u>
權益：							
歸屬於母公司業主之權益：							
普通股股本		2,261,682	45	2,261,682	45	2,261,682	45
資本公積－普通股股票溢價		142,309	3	142,309	3	142,309	3
保留盈餘：							
法定盈餘公積		794,631	16	791,920	15	791,920	15
特別盈餘公積		2,642	-	2,642	-	2,642	-
未分配盈餘		794,419	16	794,417	16	794,417	16
		1,591,692	32	1,588,979	31	1,588,979	31
國外營運機構財務報告換算之兌換差額		32,280	-	45,662	1	45,662	1
歸屬於母公司業主之權益合計		4,027,963	80	4,038,632	80	4,038,632	80
非控制權益		18,233	-	18,975	-	18,975	-
權益總計		4,046,196	80	4,057,607	80	4,057,607	80
負債及權益總計		<u>\$ 5,064,037</u>	<u>100</u>	<u>5,059,566</u>	<u>100</u>	<u>\$ 5,059,566</u>	<u>100</u>

(請詳閱後附合併財務報告附註)



董事長：



經理人：



會計主管：

盛群半導體股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		104年度		103年度	
		金額	%	金額	%
4100	營業收入淨額(附註七)	\$ 3,967,840	100	3,930,519	100
5110	營業成本(附註六(四)及七)	<u>2,019,362</u>	<u>51</u>	<u>2,041,772</u>	<u>52</u>
	營業毛利	1,948,478	49	1,888,747	48
5910	未實現銷貨利益之變動	<u>(258)</u>	<u>-</u>	<u>4,815</u>	<u>-</u>
	已實現營業毛利	<u>1,948,736</u>	<u>49</u>	<u>1,883,932</u>	<u>48</u>
	營業費用：				
6100	推銷費用	99,150	2	84,369	2
6200	管理費用	343,619	9	324,045	8
6300	研究發展費用	<u>659,417</u>	<u>17</u>	<u>658,023</u>	<u>17</u>
		<u>1,102,186</u>	<u>28</u>	<u>1,066,437</u>	<u>27</u>
	營業淨利	<u>846,550</u>	<u>21</u>	<u>817,495</u>	<u>21</u>
	營業外收入及支出：				
7100	利息收入	26,759	1	26,480	1
7060	採用權益法認列之關聯企業利益之份額(附註六(六))	57,094	1	57,440	1
7020	其他利益淨額(附註六(十四))	<u>16,300</u>	<u>-</u>	<u>37,104</u>	<u>1</u>
		<u>100,153</u>	<u>2</u>	<u>121,024</u>	<u>3</u>
	稅前淨利	946,703	23	938,519	24
7950	所得稅費用(附註六(十))	<u>128,382</u>	<u>3</u>	<u>139,935</u>	<u>4</u>
	本期淨利	<u>818,321</u>	<u>20</u>	<u>798,584</u>	<u>20</u>
8300	其他綜合損益：				
8310	不重分類至損益之項目				
8341	確定福利計畫之再衡量數	(15,066)	-	888	-
8349	與不重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十))	<u>2,562</u>	<u>-</u>	<u>(151)</u>	<u>-</u>
	不重分類至損益之項目合計	<u>(12,504)</u>	<u>-</u>	<u>737</u>	<u>-</u>
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	(16,122)	-	35,989	1
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十))	<u>2,740</u>	<u>-</u>	<u>(6,130)</u>	<u>-</u>
	後續可能重分類至損益之項目合計	<u>(13,382)</u>	<u>-</u>	<u>29,859</u>	<u>1</u>
8300	本期其他綜合損益	<u>(25,886)</u>	<u>-</u>	<u>30,596</u>	<u>1</u>
	本期綜合損益總額	<u>\$ 792,435</u>	<u>20</u>	<u>\$ 829,180</u>	<u>21</u>
	本期淨利歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 806,806	20	791,556	20
8620	非控制權益	<u>11,515</u>	<u>-</u>	<u>7,028</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 818,321</u>	<u>20</u>	<u>\$ 798,584</u>	<u>20</u>
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	\$ 780,920	20	822,225	21
8720	非控制權益	<u>11,515</u>	<u>-</u>	<u>6,955</u>	<u>-</u>
		<u>\$ 792,435</u>	<u>20</u>	<u>\$ 829,180</u>	<u>21</u>
	每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))				
9750	基本每股盈餘	\$ <u>3.57</u>		\$ <u>3.50</u>	
9850	稀釋每股盈餘	\$ <u>3.52</u>		\$ <u>3.46</u>	

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：



盛群半導體股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

普通股 股本	預收股本	資本公積	保留盈餘		國外營運機構財務報告換算之兌換差	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
			法定盈餘公積	特別盈餘公積				
\$ 2,249,412	40,368	114,211	777,359	4,598	15,730	3,962,762	11,606	3,974,368
-	-	-	-	-	-	791,556	7,028	798,584
-	-	-	-	-	29,932	30,669	(73)	30,596
-	-	-	-	-	29,932	822,225	6,955	829,180
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	74,495	-	-	-	-	-
-	-	-	(59,934)	-	-	(746,355)	-	(746,355)
-	-	-	-	(1,956)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	414	414
12,270	(40,368)	28,098	-	-	-	-	-	-
2,261,682	-	142,309	791,920	2,642	45,662	4,038,632	18,975	4,057,607
-	-	-	-	-	-	806,806	11,515	818,321
-	-	-	-	-	(13,382)	(25,886)	-	(25,886)
-	-	-	-	-	(13,382)	780,920	11,515	792,435
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	79,156	-	-	-	-	-
-	-	-	(76,445)	-	-	(791,589)	-	(791,589)
-	-	-	-	-	-	-	(3,207)	(3,207)
-	-	-	-	-	-	-	(9,050)	(9,050)
2,261,682	-	142,309	794,631	2,642	32,280	4,027,963	18,233	4,046,196

民國一〇三年一月一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

特別盈餘公積迴轉

非控制權益增加

員工行使認股權

民國一〇三年十二月三十一日餘額

本期淨利

本期其他綜合損益

本期綜合損益總額

盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積

普通股現金股利

子公司發放現金股利

非控制權益減少

民國一〇四年十二月三十一日餘額



董事長：



經理人：

(請詳閱合併財務報告附註)

會計主管：



盛群半導體股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 946,703	938,519
調整項目：		
折舊費用	48,700	47,843
攤銷費用	66,759	51,272
利息收入	(26,759)	(26,480)
股利收入	(8,135)	(4,558)
採用權益法認列之關聯企業利益之份額	(57,094)	(57,440)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	(258)	4,815
其他不影響現金流量之費損淨額	4,223	336
與營業活動相關之資產及負債淨變動數：		
持有供交易之金融資產減少(增加)	(56,384)	104,737
應收票據及帳款(含應收關係人款項)增加	(9,915)	(47,552)
存貨減少(增加)	(88,476)	24,448
其他營業資產增加	(6,547)	(15,926)
應付票據及帳款(含應付關係人款項)增加	6,289	4,064
淨確定福利負債減少	(1,582)	(1,687)
其他營業負債增加	16,188	68
營運產生之現金流入	833,712	1,022,459
收取利息	26,696	26,476
收取股利	51,681	45,407
支付所得稅淨額	(144,501)	(115,171)
營業活動之淨現金流入	767,588	979,171
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	(31,146)	(7,632)
採用權益法之被投資公司減資退回股款	9,678	-
取得不動產、廠房及設備	(31,411)	(20,338)
處分不動產、廠房及設備價款	668	450
存出保證金減少(增加)	227	(487)
其他金融資產增加	(347,815)	(32,630)
其他非流動資產增加	(55,586)	(52,247)
投資活動之淨現金流出	(455,385)	(112,884)
籌資活動之現金流量：		
存入保證金減少	(943)	-
發放股東現金股利	(795,842)	(746,355)
子公司減資退回股款予非控制權益股東	(12,000)	-
籌資活動之淨現金流出	(808,785)	(746,355)
匯率變動影響數	(2,253)	8,683
本期現金及約當現金增加(減少)數	(498,835)	128,615
期初現金及約當現金餘額	1,179,235	1,050,620
期末現金及約當現金餘額	\$ 680,400	1,179,235

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：



盛群半導體股份有限公司及其子公司
合併財務報告附註
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司及子公司(以下併稱「合併公司」)主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

二、通過財務報告之日期及程序

本合併財務報告已於民國一〇五年一月二十五日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

合併公司自民國一〇四年起全面採用經金管會認可並發布生效之2013年版國際財務報導準則(不包含國際財務報導準則第九號「金融工具」)編製合併財務報告，相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第1號之修正「國際財務報導準則第7號之比較揭露對首次採用者之有限度豁免」	99.7.1
國際財務報導準則第1號之修正「嚴重高度通貨膨脹及首次採用者固定日期之移除」	100.7.1
國際財務報導準則第1號之修正「政府貸款」	102.1.1
國際財務報導準則第7號之修正「揭露—金融資產之移轉」	100.7.1
國際財務報導準則第7號之修正「揭露—金融資產及金融負債之互抵」	102.1.1
國際財務報導準則第10號「合併財務報表」	102.1.1 (投資個體於103.1.1生效)
國際財務報導準則第11號「聯合協議」	102.1.1
國際財務報導準則第12號「對其他個體之權益之揭露」	102.1.1

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第13號「公允價值衡量」	102.1.1
國際會計準則第1號之修正「其他綜合損益項目之表達」	101.7.1
國際會計準則第12號之修正「遞延所得稅：標的資產之回收」	101.1.1
國際會計準則第19號之修訂「員工福利」	102.1.1
國際會計準則第27號之修訂「單獨財務報表」	102.1.1
國際會計準則第32號之修正「金融資產及金融負債之互抵」	103.1.1
國際財務報導解釋第20號「露天礦場於生產階段之剝除成本」	102.1.1

除下列各項外，適用2013年版國際財務報導準則並未對合併財務報告造成重大變動：

1. 國際會計準則第19號「員工福利」

該準則主要修正以淨確定福利負債（資產）乘以折現率決定淨利息，並用其取代準則修訂前之利息成本及計畫資產之預期報酬、刪除精算損益得採「緩衝區法」或發生時一次列入損益之會計政策選擇，並規定精算損益應於發生時列入其他綜合損益、前期服務成本應於發生時認列為損益，不再於符合既得條件前之平均期間內按直線法分攤認列為費用，另企業係於不再能撤銷離職福利之要約或於認列相關重組成本之孰早者認列離職福利，而非僅於已明確承諾相關離職事件時，始應認列離職福利為負債及費用等。此外增加確定福利計畫之揭露規定。該準則對合併公司財務狀況與經營結果無重大影響，惟依規定增加確定福利計畫相關揭露。

2. 國際會計準則第1號「財務報表之表達」

該準則修正其他綜合損益之表達方式，將列示於其他綜合損益之項目依性質分類為「後續不重分類至損益」及「後續將重分類至損益」兩類別。該修正同時規定以稅前金額列示之其他綜合損益項目，其相關稅額應隨前述兩類別予以單獨列示。合併公司已依該準則改變合併綜合損益表之表達方式。

3. 國際財務報導準則第12號「對其他個體之權益之揭露」

該準則整合各號準則對企業所持有子公司、聯合協議、關聯企業及未納入合併財務報告之結構型個體之權益揭露規定，並要求揭露相關資訊。合併公司依該準則增加有關關聯企業之資訊揭露。

4. 國際財務報導準則第13號「公允價值衡量」

該準則定義公允價值，建立公允價值衡量之架構，並規範公允價值衡量相關揭露。該準則對合併公司財務狀況與經營結果無重大影響，惟依規定增加公允價值衡量相關揭露。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(二)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

下表彙列國際會計準則理事會（以下簡稱「理事會」）已發布，惟截至報導日止尚未經金管會認可及公布生效日之準則及解釋：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布之生效日
國際財務報導準則第9號「金融工具」	107.1.1
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	尚待理事會決定
國際財務報導準則第10號、國際財務報導準則第12號及國際會計準則第28號之修正「投資個體：合併報表例外規定之適用」	105.1.1
國際財務報導準則第11號之修正「處理聯合營運權益之取得」	105.1.1
國際財務報導準則第14號「管制遞延帳戶」	105.1.1
國際財務報導準則第15號「來自客戶合約之收入」	107.1.1
國際財務報導準則第16號「租賃」	108.1.1
國際會計準則第1號之修正「揭露計畫」	105.1.1
國際會計準則第16號及國際會計準則第38號之修正「闡明可接受之折舊及攤銷方法」	105.1.1
國際會計準則第16號及國際會計準則第41號之修正「生產性植物」	105.1.1
國際會計準則第19號之修正「確定福利計畫：員工提撥」	103.7.1
國際會計準則第27號之修正「單獨財務報表之權益法」	105.1.1
國際會計準則第36號之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	103.1.1
國際會計準則第39號之修正「衍生工具之約務更替及避險會計之持續適用」	103.1.1
2010-2012及2011-2013週期之年度改善	103.7.1
2012-2014年國際財務報導年度改善	105.1.1
國際財務報導解釋第21號「公課」	103.1.1

合併公司現正持續評估上述準則及解釋對合併公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

本合併財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下。除另有說明者外，下列會計政策已一致適用於本合併財務報告之所有表達期間。

(一)遵循聲明

本合併財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」（以下簡稱「編製準則」）及金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告（以下簡稱「金管會認可之國際財務報導準則」）編製。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(二)編製基礎

1.衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本合併財務報告係依歷史成本為基礎編製：

- (1)透過損益按公允價值衡量之金融工具(包括衍生金融工具)；及
- (2)確定福利負債，係依退休基金資產加計未認列前期服務成本與未認列精算損失，減除未認列精算利益與確定福利義務現值之淨額認列。

2.功能性貨幣及表達貨幣

合併公司每一個體均係以該個體所處主要經濟環境之貨幣為功能性貨幣。本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

(三)合併基礎

1.合併財務報告編製原則

合併財務報告之編製主體包含本公司及本公司之子公司。

自取得子公司控制力之日起，開始將其財務報告納入合併財務報告，直至不再具有控制力之日為止。歸屬於子公司非控制權益之損益歸屬於非控制權益，即使非控制權益因而成為虧損餘額亦然。

合併公司間之重大交易、餘額及未實現收益與費用，於編製合併財務報告時均已消除。

2.列入合併財務報告之子公司

列入本合併財務報告之子公司包含：

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			104.12.31	103.12.31
本公司	MCU Holdings Ltd. (MCU)	投資控股公司	100%	100%
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Holtek BVI)	投資控股公司	100%	100%
本公司	Sigmos Holdings Ltd. (Sigmos)	投資控股公司	100%	100%
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Kingtek BVI)	投資控股公司	100%	100%
本公司	盛凌投資股份有限公司(盛凌投資)	專業投資公司	100%	100%
Holtek BVI	芯群集成電路(廈門)有限公司(芯群)	銷售及技術服務	100%	100%
Holtek BVI	合泰半導體(中國)有限公司(合泰)	銷售及技術服務	100%	100%
Sigmos	Holtek Semiconductor (USA) Inc. (Holtek (USA))	銷售及技術服務	100%	100%
Kingtek BVI	金科集成電路(蘇州)有限公司(金科)	銷售及技術服務	100%	100%
盛凌投資	優方科技股份有限公司(優方)	製造及銷售	54.75%	54.75%

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	所持股權百分比	
			104.12.31	103.12.31
優方	Best Solution Electronics Inc. (Best Solution)	製造及銷售	100%	100%
盛凌投資	盛通科技股份有限公司(盛通)	製造及銷售	100%	100%
盛通	BestComm RF Electronics Inc. (BestComm)	製造及銷售	100%	100%

3.未列入合併財務報告之子公司：無

(四)外幣

1.外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。報導日之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣，其兌換損益係指期初以功能性貨幣計價之攤銷後成本，調整當期之有效利息及付款後之金額，與依外幣計價之攤銷後成本按報導日匯率換算金額間之差異。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率重新換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。除備供出售金融資產、指定為國外營運機構淨投資避險之金融負債或合格之現金流量避險，換算所產生之外幣兌換差異認列於其他綜合損益外，其餘係認列為損益。

2.國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，係依報導日之匯率換算為新台幣；股東權益項目除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘依歷史匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

當處分國外營運機構致喪失控制、共同控制或重大影響時，與該國外營運機構相關之累計兌換差額係全數重分類為損益。部分處分含有國外營運機構之子公司時，相關累計兌換差額係按比例重新歸屬至非控制權益。部分處分含有國外營運機構之關聯企業或合資之投資時，相關累計兌換差額則按比例重分類至損益。

(五)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於合併公司正常營業週期中實現，或意圖將其出售或消耗者。
- 2.主要為交易目的而持有者。
- 3.預期將於資產負債表日後十二個月內實現者。
- 4.現金或約當現金，但不包括於資產負債表日後逾十二個月用以交換、清償負債或受有其他限制者。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

- 1.預期將於合併公司正常營業週期中清償者。
- 2.主要為交易目的而持有者。
- 3.預期將於資產負債表日後十二個月內到期清償者。
- 4.合併公司不能無條件將清償期限延期至資產負債表日後至少十二個月者。

(六)現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(七)金融工具

1.金融資產

(1)透過損益按公允價值衡量之金融資產

此類金融資產係指持有供交易之金融資產，其取得或發生之主要目的為短期內出售或再買回。此類金融資產於原始認列時係按公允價值衡量，交易成本於發生時認列為損益；後續評價按公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

(2)備供出售金融資產

此類金融資產若屬「無活絡市場公開報價且公允價值無法可靠衡量」之權益投資，則以成本減除減損損失後之金額衡量，列報於「以成本衡量之金融資產」。

(3)應收款

應收款係無活絡市場公開報價，且具固定或可決定付款金額之金融資產，包括應收款項及其他應收款。原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本減除減損損失衡量，惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。

(4)金融資產減損

非透過損益按公允價值衡量之金融資產，於每個報導日評估減損。當有客觀證據顯示，因金融資產原始認列後發生之單一或多項事件，致使該資產之估計未來現金流量受損失者，該金融資產即已發生減損。

針對應收帳款個別評估未有減損後，另再以組合基礎評估減損。應收款組合之客觀減損證據可能包含合併公司過去收款經驗、該組合超過平均授信期間之延遲付款增加情況，以及與應收款拖欠有關之全國性或區域性經濟情勢變化。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

以成本衡量之金融資產，認列之減損損失金額係該資產之帳面金額與估計未來現金流量按該金融資產之相似資產市場報酬率折現之現值間之差額。該減損損失於後續期間不得迴轉。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除，惟應收款之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，當判斷應收款無法收回時，則沖銷備抵帳戶，原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

當金融資產以攤銷後成本衡量時，若後續期間減損損失金額減少，且該減少客觀地連結至認列減損後發生之事項，則先前認列之減損損失予以迴轉認列於損益，惟該投資於減損迴轉日之帳面金額不得大於若未認列減損情況下應有之攤銷後成本。

(5)金融資產之除列

合併公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

2.金融負債

(1)應付款

金融負債非屬持有供交易且未指定為透過損益按公允價值衡量者，包括應付帳款及其他應付款，原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本衡量。

(2)金融負債之除列

合併公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額間之差額認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。

(3)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於合併公司有法定權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

(八)存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用之地點及狀態所發生之必要支出，並採加權平均法計算。淨變現價值係正常營業下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用為計算基礎。

(九)投資關聯企業

關聯企業係指合併公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。合併公司持有被投資公司百分之二十至百分之五十之表決權時，即假設具有重大影響力，並採權益法評價。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。

合併財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與合併公司會計政策一致性之調整後，合併公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。

合併公司與關聯企業間之交易所產生之未實現損益，已在合併公司對該被投資公司之權益範圍內予以消除。

當合併公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。

(十)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備之認列及衡量係採成本模式，依成本減除累計折舊與累計減損後之金額衡量。成本包含可直接歸屬於取得資產之支出、任何其他使資產達預計用途之可使用狀態的直接可歸屬成本、拆卸與移除該項目及復原所在地點之成本。此外，為整合相關設備功能而購入之軟體亦資本化為該設備之一部分。

當不動產、廠房及設備包含不同組成部分，且相對於該項目之總成本若屬重大而採用不同之折舊方法較為合宜時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分損益，以淨額認列於營業外收入及支出項下。

2.後續成本

若不動產、廠房及設備項目後續支出所預期產生之未來經濟效益很有可能流入合併公司，且其金額能可靠衡量，則該支出認列為該項目帳面金額之一部分，被重置部分之帳面金額則予以除列。不動產、廠房及設備之日常維修成本於發生時認列為損益。

3.折舊

折舊係依資產成本減除殘值後按估計耐用年限採直線法計提，並依資產之各別重大組成部分評估，若一組成部分之耐用年限不同於資產之其他部分，則此組成部分應單獨提列折舊。折舊之提列認列為損益。

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

- (1)房屋及建築物：20~40年
- (2)機器設備：3~5年
- (3)其他設備：2~8年

每年至少於財務年度結束日檢視不動產、廠房及設備之折舊方法、耐用年限及殘值，若有變動，視為會計估計變動。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十一)租賃

營業租賃之租金給付依直線法於租賃期間認列為費用。

(十二)無形資產

1.研究與發展

研究階段係指預期為獲取及瞭解嶄新的科學或技術知識而進行之活動，相關支出於發生時認列於損益。

發展階段之支出於同時符合下列所有條件時，認列為無形資產；未同時符合者，於發生時即認列於損益：

- (1)完成無形資產之技術可行性已達成，使該無形資產將可供使用或出售。
- (2)意圖完成該無形資產，並加以使用或出售。
- (3)有能力使用或出售該無形資產。
- (4)無形資產將很有可能產生未來經濟效益。
- (5)具充足之技術、財務及其他資源，以完成此項發展，並使用或出售該無形資產。
- (6)歸屬於該無形資產發展階段之支出能可靠衡量。

2.其他無形資產

合併公司取得其他無形資產係以成本減除累計攤銷與累計減損衡量之。

3.後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產的未來經濟效益時，方將其資本化。

4.攤銷

攤銷時係以資產成本減除殘值後金額為可攤銷金額，自達可供使用狀態起，按估計耐用年限採直線法攤銷，攤銷數認列於損益。

每年至少於財務年度結束日檢視無形資產之殘值、攤銷期間及攤銷方法，若有變動，視為會計估計變動。

(十三)非金融資產減損

針對存貨及遞延所得稅資產以外之非金融資產，合併公司於每一報導日評估是否發生減損，就有減損跡象之資產(個別資產或現金產生單位)估計其可回收金額，並就可回收金額低於帳面價值之資產，認列減損損失。於以前年度所認列除商譽以外之累計減損損失，嗣後若已不存在或減少，則迴轉增加帳面價值至可回收金額，惟不超過資產在未認列減損損失下，減除應提列折舊或攤銷之數。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十四)收入認列

正常活動中銷售商品所產生之收入，係考量退回、商業折扣及數量折扣後，按已收或應收對價之公允價值衡量。收入係俟具說服力之證據存在、所有權之重大風險及報酬已移轉予買方、價款很有可能收回及相關成本與可能之商品退回能可靠估計、不持續參與商品之管理及收入金額能可靠衡量時加以認列。若折扣很有可能發生且金額能可靠衡量時，則於銷售認列時予以認列作為收入之減項。

風險及報酬移轉之時點係視銷售合約個別條款而定。

(十五)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供勞務期間內認列為損益項下之員工福利費用。

2.確定福利計畫

合併公司在確定福利退休金計畫下之淨義務係針對福利計畫以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算。任何未認列之前期服務成本及計畫資產之公允價值均予以減除。折現率係以到期日與合併公司淨義務期限接近，且計價幣別與預期支付福利金相同之政府公債之市場殖利率於年度報導日之利率為主。

企業淨義務每年由精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對合併公司有利時，認列資產係以任何未認列之前期服務成本，及未來得以從該計畫退還之資金或減少未來對該計畫之提撥等方式所可獲得經濟效益現值之總額為限。計算經濟效益現值時應考量任何適用於合併公司任何計畫之最低資金提撥需求。一項效益若能在計畫期間內或計畫負債清償時實現，對合併公司而言，即具有經濟效益。

合併公司所有確定福利計畫續後產生之精算損益立即認列於其他綜合損益，並於當期結轉至保留盈餘。

3.短期員工福利

短期員工福利義務係以未折現之基礎衡量，且於提供相關服務時認列為費用。

有關短期現金紅利或分紅計畫下預期支付之金額，若係因員工過去提供服務而使合併公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

(十六)股份基礎給付交易

給與員工之股份基礎給付獎酬以給與日之公允價值，於員工達到可無條件取得報酬之期間內，認列酬勞成本並增加相對權益。認列之酬勞成本係隨預期符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量予以調整；而最終認列之金額係以既得日符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量為基礎衡量。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

股份基礎給付協議之給與日在民國九十七年一月一日前，且既得日在民國一〇一年一月一日(金管會認可之國際財務報導準則轉換日)前之員工認股權計畫，選擇適用國際財務報導準則第1號之豁免，依金管會民國九十八年一月十日發布之證券發行人財務報告編製準則及財團法人中華民國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋(以下簡稱先前一般公認會計原則)認列，採用內含價值法認列酬勞性員工認股選擇權計畫之酬勞成本，亦即按衡量日本公司股票市價與行使價格間之差額估計為酬勞成本，並於員工認股選擇權計畫所規定之員工服務年限內認列為合併公司之費用，同時增加合併公司之股東權益。

(十七)所得稅

所得稅費用包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括當年度課稅所得(損失)按報導日之法定稅率或實質性立法稅率計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅的調整。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期資產實現或負債清償當期之稅率衡量，並以報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

合併公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；
 - (1)同一納稅主體；或
 - (2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

對於可遞轉後期之未使用所得稅抵減及可減除暫時性差異，在很有可能有未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十八)每股盈餘

合併公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。合併公司之潛在稀釋普通股包括本公司尚未經股東會決議且得採股票發放之員工分紅。因盈餘或資本公積轉增資而新增之股份，採追溯調整計算。

(十九)部門資訊

營運部門係合併公司之組成部分，從事可能賺得收入並發生費用(包括與合併公司內其他組成部分間交易相關之收入及費用)之經營活動。所有營運部門之營運結果均定期由合併公司主要營運決策者複核，以制定分配資源予該部門之決策並評量其績效。各營運部門均具單獨之財務資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依金管會認可之國際財務報導準則編製本合併財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理當局持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

對於假設及估計之不確定性中，存有重大風險將於未來次一年度造成重大調整之相關資訊，請詳下列附註：

(一)附註六(四)，存貨之評價。

(二)附註六(九)，確定福利義務之衡量。

合併公司之會計政策及揭露包含採用公允價值衡量其金融、非金融資產及負債。合併公司之財務部門負責進行公允價值驗證，藉獨立、可靠、且能代表可執行價格之資料使評價結果貼近市場狀態，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

合併公司在衡量其資產和負債時，盡可能使用市場可觀察之輸入值。公允價值之等級係以評價技術使用之輸入值為依據，歸類如下：

第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價（未經調整）。

第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接（即價格）或間接（即由價格推導而得）可觀察。

第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料（非可觀察參數）。

若發生公允價值各等級間之移轉事項或情況，合併公司係於報導日認列該移轉。衡量公允價值所採用假設之相關資訊請詳附註六(十五)，金融工具。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	104.12.31	103.12.31
現金及活期存款	\$ 246,152	222,922
定期存款	434,248	956,313
	<u>\$ 680,400</u>	<u>1,179,235</u>

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產

1.透過損益按公允價值衡量之金融資產：

	104.12.31	103.12.31
持有供交易之金融資產－受益憑證	<u>\$ 214,512</u>	<u>158,476</u>

2.以成本衡量之金融資產：

	104.12.31	103.12.31
未上市(櫃)公司股票：		
Unitech Capital Inc. (Unitech)	\$ 86,750	86,750
諧永投資股份有限公司(諧永投資)	143,000	143,000
	<u>\$ 229,750</u>	<u>229,750</u>

(三)應收票據及帳款淨額

	104.12.31	103.12.31
應收票據	\$ 715	531
應收帳款	101,579	109,818
	102,294	110,349
減：備抵呆帳	(7,393)	(7,393)
	<u>\$ 94,901</u>	<u>102,956</u>

合併公司於民國一〇四年度及一〇三年度針對應收票據及應收帳款並無提列(迴轉)減損損失情形。

(四)存貨

	104.12.31	103.12.31
原料及物料	\$ 128,554	125,326
在製品	186,171	138,897
製成品及商品	273,884	236,758
	<u>\$ 588,609</u>	<u>500,981</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

營業成本組成明細如下：

	104年度	103年度
銷貨成本	\$ 2,015,545	2,041,548
迴轉存貨跌價損失	(4,000)	(6,000)
報廢成本	7,817	6,224
	<u>\$ 2,019,362</u>	<u>2,041,772</u>

(五)其他金融資產－流動

	104.12.31	103.12.31
定期存款(三個月以上)	\$ 1,624,124	1,277,620
受限制銀行存款	3,706	3,583
其他	11,195	13,454
	<u>\$ 1,639,025</u>	<u>1,294,657</u>

(六)採用權益法之投資

合併公司於報導日採用權益法之關聯企業皆屬個別不重大，其彙總財務資訊列示如下，該等財務資訊係於合併財務報告中所包含之金額：

	104.12.31	103.12.31
關聯企業其權益之彙總金額	\$ 488,375	458,476
減：聯屬公司間未實現交易利得	(59,105)	(59,364)
	<u>\$ 429,270</u>	<u>399,112</u>
	104年度	103年度
本期綜合損益總額歸屬於合併公司之份額：		
繼續營業單位本期淨利	\$ 57,094	57,440
其他綜合損益	(1,260)	1,650
綜合損益總額	<u>\$ 55,834</u>	<u>59,090</u>

合併公司並無任何與其他投資者共同承擔關聯企業之或有負債，或對關聯企業之負債負有個別責任而產生之或有負債。

合併公司關聯企業將資金移轉予合併公司之能力並未受有重大限制。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(七)不動產、廠房及設備

合併公司不動產、廠房及設備之成本及累計折舊變動明細如下：

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	其 他 設 備	總 計
成本：					
民國104年1月1日餘額	\$ 26,676	542,406	327,698	75,264	972,044
增添	-	3,141	15,457	12,813	31,411
處分	-	-	(12,762)	(1,890)	(14,652)
重分類	-	-	1,207	-	1,207
匯率變動之影響	-	(7,439)	(2,489)	(974)	(10,902)
民國104年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>538,108</u>	<u>329,111</u>	<u>85,213</u>	<u>979,108</u>
民國103年1月1日餘額	\$ 26,676	531,036	318,672	76,654	953,038
增添	-	1,759	15,330	3,249	20,338
處分	-	-	(15,165)	(6,207)	(21,372)
重分類	-	-	5,904	324	6,228
匯率變動之影響	-	9,611	2,957	1,244	13,812
民國103年12月31日餘額	<u>\$ 26,676</u>	<u>542,406</u>	<u>327,698</u>	<u>75,264</u>	<u>972,044</u>
累計折舊：					
民國104年1月1日餘額	\$ -	159,185	266,589	58,407	484,181
本期折舊	-	22,259	20,113	6,328	48,700
處分	-	-	(12,159)	(1,833)	(13,992)
匯率變動之影響	-	(889)	(1,799)	(654)	(3,342)
民國104年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>180,555</u>	<u>272,744</u>	<u>62,248</u>	<u>515,547</u>
民國103年1月1日餘額	\$ -	136,585	258,332	58,613	453,530
本期折舊	-	21,501	21,136	5,206	47,843
處分	-	-	(15,132)	(6,207)	(21,339)
匯率變動之影響	-	1,099	2,253	795	4,147
民國103年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>159,185</u>	<u>266,589</u>	<u>58,407</u>	<u>484,181</u>
帳面價值：					
民國104年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>357,553</u>	<u>56,367</u>	<u>22,965</u>	<u>463,561</u>
民國103年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>383,221</u>	<u>61,109</u>	<u>16,857</u>	<u>487,863</u>
民國103年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>394,451</u>	<u>60,340</u>	<u>18,041</u>	<u>499,508</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(八)營業租賃

- 1.合併公司依已簽訂之辦公室、停車位及員工宿舍租賃合約，預估未來最低租金給付額彙列如下：

	<u>104.12.31</u>	<u>103.12.31</u>
一年內	\$ 13,390	14,789
一年以上至二年	5,842	5,449
二年以上	<u>3,883</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 23,115</u>	<u>20,238</u>

- 2.本公司廠房之土地係向科學工業園區管理局承租，租賃期間自民國九十年三月十五日起至民國一〇九年十二月三十一日止，且租賃期間屆滿時得另訂新約。自民國一〇二年五月起租金每年約為3,360千元，如遇政府調整地價時，租金亦隨同調整。

(九)員工福利

1.確定福利計畫

合併公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	<u>104.12.31</u>	<u>103.12.31</u>
確定福利義務現值	\$ 119,433	106,093
計畫資產之公允價值	<u>(47,695)</u>	<u>(47,839)</u>
淨確定福利負債	<u>\$ 71,738</u>	<u>58,254</u>

合併公司之確定福利計畫係提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

(1)計畫資產組成

合併公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下簡稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

截至報導日，合併公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計47,695千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動基金局網站公布之資訊。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(2)確定福利義務現值之變動

合併公司民國一〇四年度及一〇三年度確定福利義務現值變動如下：

	104年度	103年度
1月1日確定福利義務	\$ 106,093	108,330
計畫支付之福利	(4,189)	(3,636)
當期服務成本及利息	2,228	2,167
淨確定福利負債之再衡量數		
— 因財務假設變動所產生之精算損(益)	11,861	(1,670)
— 因經驗變動所產生之精算損失	3,440	902
12月31日確定福利義務	<u>\$ 119,433</u>	<u>106,093</u>

(3)計畫資產公允價值之變動

合併公司民國一〇四年度及一〇三年度確定福利計畫資產公允價值之變動如下：

	104年度	103年度
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 47,839	47,501
計畫支付之福利	(4,189)	(3,636)
計畫資產預計報酬	1,035	979
計畫參與者之提撥	2,775	2,875
淨確定福利負債之再衡量數		
— 計畫資產報酬(不含當期利息)	235	120
12月31日計畫資產之公允價值	<u>\$ 47,695</u>	<u>47,839</u>

(4)認列為損益之費用

合併公司民國一〇四年度及一〇三年度認列為損益之費用如下：

	104年度	103年度
利息成本	\$ 2,228	2,167
計畫資產預計報酬	(1,035)	(979)
	<u>\$ 1,193</u>	<u>1,188</u>
營業成本	\$ 84	71
推銷費用	79	72
管理費用	239	260
研究發展費用	791	785
	<u>\$ 1,193</u>	<u>1,188</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(5)認列為其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數

合併公司民國一〇四年度及一〇三年度累計認列於其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數如下：

	104年度	103年度
1月1日累積餘額	\$ (4,102)	(3,214)
本期認列	15,066	(888)
12月31日累積餘額	<u>\$ 10,964</u>	<u>(4,102)</u>

(6)精算假設

合併公司所使用之主要精算假設如下：

A.用於精算民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日確定福利義務現值者

	104.12.31	103.12.31
折現率	1.40 %	2.10 %
未來薪資成長率	2.00 %	2.10 %

B.用於精算民國一〇四年度及一〇三年度確定福利計劃成本者

	104年度	103年度
折現率	2.10 %	2.00 %
未來薪資成長率	2.10 %	2.00 %

合併公司預計於民國一〇四年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為2,800千元。

確定福利計畫之加權平均存續期間為15.1年。

(7)敏感度分析

計算確定福利義務現值時，合併公司必須運用判斷及估計以決定資產負債表日相關精算假設，包含員工離職率及未來薪資變動等。任何精算假設之變動，均可能重大影響合併公司確定福利義務之金額。

合併公司民國一〇四年十二月三十一日之淨確定福利負債之帳面金額為71,738千元，當採用之折現率及未來薪資成長率增減變動1%時，合併公司認列之淨確定福利負債增減變動如下：

精算假設	淨確定福利負債	
	增加1%	減少1%
折現率	\$ <u>(16,502)</u>	<u>19,814</u>
未來薪資成長率	\$ <u>18,128</u>	<u>(15,544)</u>

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨退休金負債所採用的方法一致。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

2. 確定提撥計畫

本公司及國內子公司其確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞動部勞工保險局(以下簡稱勞工保險局)之勞工退休金個人專戶。在此計畫下合併公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。合併公司民國一〇四年度及一〇三年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為19,106千元及18,495千元，已提撥至勞工保險局。

除上，民國一〇四年度及一〇三年度國外分公司及合併子公司依當地相關法令認列之退休金費用分別為17,580千元及14,371千元。

(十) 所得稅

1. 所得稅費用(利益)

合併公司民國一〇四年度及一〇三年度之所得稅費用明細如下：

	104年度	103年度
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 117,895	116,739
調整前期之當期所得稅	2,631	9,853
	<u>120,526</u>	<u>126,592</u>
遞延所得稅費用		
暫時性差異之發生及迴轉	7,856	15,013
認列前期未認列之遞延所得稅資產	-	(1,670)
	<u>7,856</u>	<u>13,343</u>
所得稅費用	<u>\$ 128,382</u>	<u>139,935</u>

合併公司民國一〇四年度及一〇三年度認列於其他綜合損益項下之所得稅費用(利益)明細如下：

	104年度	103年度
不重分類至損益之項目：		
確定福利計畫之再衡量數	\$ <u>(2,562)</u>	<u>151</u>
後續可能重分類至損益之項目：		
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	\$ <u>(2,740)</u>	<u>6,130</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

合併公司所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：

	104年度	103年度
稅前淨利	\$ 946,703	938,519
依合併公司所在地國內稅率計算之所得稅	160,940	159,548
永久性差異調整	(9,470)	(6,065)
免稅所得	(23,401)	(12,511)
投資抵減預期新增數	(7,921)	(16,014)
以前年度所得稅核定及估計差異	1,138	9,853
認列前期未認列之遞延所得稅資產	-	(1,670)
其他	7,096	6,794
	<u>\$ 128,382</u>	<u>139,935</u>

2.遞延所得稅資產及負債變動明細表

遞延所得稅資產

	103.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	103.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	104.12.31
存貨跌價損失	\$ 11,900	1,020	-	10,880	680	-	10,200
未實現聯屬公司間利益	11,402	(3,307)	-	14,709	(3,180)	-	17,889
淨確定福利負債	10,341	287	151	9,903	270	(2,562)	12,195
其他	2,001	(404)	-	2,405	612	-	1,793
	<u>\$ 35,644</u>	<u>(2,404)</u>	<u>151</u>	<u>37,897</u>	<u>(1,618)</u>	<u>(2,562)</u>	<u>42,077</u>

遞延所得稅負債

	103.1.1	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	103.12.31	借(貸)記 損益表	借(貸)記 其他綜合 損益表	104.12.31
國外營運機構財務報告 換算之兌換利益	\$ (7,326)	-	6,130	(13,456)	(1,002)	(2,740)	(9,714)
採權益法認列之國外投 資利益	(48,357)	13,318	-	(61,675)	13,281	-	(74,956)
其他	(455)	2,429	-	(2,884)	(2,805)	-	(79)
	<u>\$ (56,138)</u>	<u>15,747</u>	<u>6,130</u>	<u>(78,015)</u>	<u>9,474</u>	<u>(2,740)</u>	<u>(84,749)</u>

3.合併公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一〇二年度。

4.兩稅合一相關資訊如下：

	104.12.31	103.12.31
屬民國八十七年度以後之未分配盈餘	<u>\$ 794,419</u>	<u>794,417</u>
可扣抵稅額帳戶餘額	<u>\$ 69,705</u>	<u>39,969</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

	104年度 (預計)	103年度 (實際)
對中華民國居住者盈餘分配之稅額扣抵比率	<u>16.39%</u>	<u>13.42%</u>

(十一)資本及其他權益

1.股本

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日本公司額定股本均為3,000,000千元(均含保留供發行員工認股權憑證200,000千元及可轉換公司債500,000千元之額度)，實收股本均為2,261,682千元，每股面額10元。

本公司員工於民國一〇二年度行使九十六年發行之員工認股權憑證計2,569,750股，截至民國一〇二年十二月三十一日止，尚有1,227,000股未完成法定登記程序。前述員工認股權憑證於民國一〇三年間皆已完成法定登記程序。

2.資本公積

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得以已實現資本公積之全部或一部轉作資本或發放現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3.保留盈餘

依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- (1)提繳稅捐。
- (2)彌補虧損。
- (3)提存百分之十為法定盈餘公積。
- (4)依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。
- (5)員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之十三·五。
- (6)董事監察人酬勞就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一·五。
- (7)扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派之。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

本公司依證券主管機關規定於分派盈餘時，應就當年度發生之股東權益減項自可分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項有迴轉時，得就迴轉部分併入可分派盈餘。

依民國一〇四年五月修正之公司法規定，員工紅利及董事監察人酬勞已不屬於盈餘分配項目，本公司將於主管機關規定期限前配合修改公司章程。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(1)法定盈餘公積

依公司法規定，公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

(2)特別盈餘公積

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，調整帳列股東權益項下之累積換算調整數而增加保留盈餘之金額為18,008千元；另就轉換日之精算損益調整減列保留盈餘13,410千元。依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，應就因轉換採用金管會認可之國際財務報導準則產生之保留盈餘淨增加數4,598千元提列特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。本公司轉投資之海外子公司盛揚半導體(深圳)有限公司已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記，本公司依據前述函令規定，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉特別盈餘公積併入保留盈餘計1,956千元。截至民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額均為2,642千元。

又依上段所述函令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

(3)盈餘分派

本公司民國一〇三年度員工紅利實際配發金額為96,174千元，董事監察人酬勞實際配發金額為10,686千元，員工紅利及董事監察人酬勞實際配發情形與本公司民國一〇三年度合併財務報告估列金額並無差異。相關資訊可至公開資訊觀測站等管道查詢之。

本公司分別於民國一〇四年六月九日及一〇三年六月十一日經股東常會決議民國一〇三年度及一〇二年度之盈餘分派案，分派予業主之股利如下：

	103年度		102年度	
	每股股利		每股股利	
	(元)	金額	(元)	金額
分派予普通股業主之現金股利	\$ 3.5	791,589	3.3	746,355

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(十二)每股盈餘

歸屬於本公司每股盈餘之計算列示如下：

	104年度	103年度
基本每股盈餘：		
歸屬於本公司股東之本期淨利	\$ <u>806,806</u>	<u>791,556</u>
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數 (千股)	<u>226,168</u>	<u>226,168</u>
基本每股盈餘(元)	\$ <u>3.57</u>	<u>3.50</u>
稀釋每股盈餘：		
歸屬於本公司股東之本期淨利	\$ <u>806,806</u>	<u>791,556</u>
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
具稀釋作用潛在普通股之影響(千股)	<u>3,015</u>	<u>2,494</u>
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數 (千股)	<u>229,183</u>	<u>228,662</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>3.52</u>	<u>3.46</u>

(十三)員工及董事監察人酬勞

本公司民國一〇四年度員工及董事監察人酬勞估列金額分別為98,027千元及10,892千元，係以本公司該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事監察人酬勞前之金額乘上本公司章程擬訂定之員工酬勞及董事及監察人酬勞分派成數為估計基礎，並列報為民國一〇四年度之營業成本或營業費用。若次年度通過發布財務報告日後有變動，則依會計估計變動處理，並將該變動之影響認列為次年度損益。

(十四)營業外收入及支出

合併綜合損益表所列之其他利益淨額明細如下：

	104年度	103年度
外幣兌換利益(損失)淨額	\$ (5,068)	20,109
股利收入	8,135	4,558
其他	<u>13,233</u>	<u>12,437</u>
	\$ <u>16,300</u>	<u>37,104</u>

(十五)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之最大信用暴險金額分別為3,220,720千元及3,313,734千元。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

合併公司之潛在信用風險係源自金融資產交易對方或他方未履行合約之潛在影響，主要來自於合併公司之現金及約當現金、約定期間三個月以上之定期存款及應收客戶之帳款。

合併公司之現金及約當現金及定期存款存放於信用良好之銀行，發生信用風險可能性低。

合併公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日佔合併公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為247,526千元及326,199千元，使合併公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵呆帳，管理當局預期未來不致有重大損失。

(2)減損損失

報導日應收款項之帳齡分析如下：

	104.12.31		103.12.31	
	總額	減損	總額	減損
未逾期	\$ 686,093	5,574	676,918	2,009
逾期0~30天	1,819	1,819	4,966	4,966
逾期31~120天	-	-	418	418
	<u>\$ 687,912</u>	<u>7,393</u>	<u>682,302</u>	<u>7,393</u>

2.流動性風險

下表為金融負債之合約到期日分析：

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過5年
104年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 470,714	470,714	470,714	-
存入保證金	6,654	6,654	-	6,654
	<u>\$ 477,368</u>	<u>477,368</u>	<u>470,714</u>	<u>6,654</u>
103年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 471,782	471,782	471,782	-
存入保證金	7,597	7,597	-	7,597
	<u>\$ 479,379</u>	<u>479,379</u>	<u>471,782</u>	<u>7,597</u>

合併公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

3.市場風險

(1)匯率風險

A.匯率風險之暴險

合併公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	104.12.31			103.12.31			
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣	
<u>金融資產</u>							
<u>貨幣性項目</u>							
美 金	\$	9,047	32.775	296,520	3,323	31.6	104,996
人民幣		74,218	4.9581	367,980	91,243	5.067	462,329
<u>非貨幣性項目</u>							
美 金	\$	9,349	32.775	306,426	9,138	31.65	289,205
<u>金融負債</u>							
<u>貨幣性項目</u>							
美 金	\$	5,337	32.775	174,927	4,829	31.65	152,849
人民幣		12,913	4.9581	64,023	14,389	5.092	73,269

B.敏感性分析

合併公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款及其他應收款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇四年度及一〇三年度之稅後淨利將分別增加或減少3,532千元及2,832千元。

C.貨幣性項目之兌換損益

由於合併公司功能性貨幣種類繁多，故採彙整方式揭露貨幣性項目之兌換損益資訊，民國一〇四年度及一〇三年度外幣兌換利益(損失)淨額(含已實現及未實現)分別為(5,068)千元及20,109千元。

(2)其他價格風險

合併公司之其他價格風險主要來自於透過損益按公允價值衡量之金融資產，於報導日受益憑證價格變動時產生評價損益，於民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日當權益價格上漲或下跌1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇四年度及一〇三年度之稅後淨利將分別增加或減少1,780元及1,315元。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

4.公允價值資訊

(1)金融工具之種類及公允價值

合併公司金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量之金融工具其帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

104.12.31					
帳面價值	公 允 價 值			合 計	
	第一級	第二級	第三級		
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
持有供交易之非衍生性金融資產	\$ 214,512	214,512	-	-	214,512
放款及應收款					
現金及約當現金	680,400	-	-	-	-
應收票據及帳款淨額(含關係人)	680,519	-	-	-	-
其他金融資產—流動	1,639,025	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	6,264	-	-	-	-
	<u>\$ 3,220,720</u>	<u>214,512</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>214,512</u>
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款淨額(含關係人)	\$ 470,714	-	-	-	-
存入保證金	6,654	-	-	-	-
	<u>\$ 477,368</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
103.12.31					
帳面價值	公 允 價 值			合 計	
	第一級	第二級	第三級		
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
持有供交易之非衍生性金融資產	\$ 158,476	158,476	-	-	158,476
放款及應收款					
現金及約當現金	1,179,235	-	-	-	-
應收票據及帳款淨額(含關係人)	674,909	-	-	-	-
其他金融資產—流動	1,294,657	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	6,457	-	-	-	-
	<u>\$ 3,313,734</u>	<u>158,476</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>158,476</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

	103.12.31				
	帳面價值	公 允 價 值			合 計
		第一級	第二級	第三級	
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款淨額(含關係人)	\$ 471,782	-	-	-	-
存入保證金	7,597	-	-	-	-
	<u>\$ 479,379</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(2)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

合併公司持有之受益憑證係具有標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產，其公允價值係參照市場報價決定。

民國一〇四年度及一〇三年度間並無任何公允價值等級移轉情形。

(十六)財務風險管理

1.概要

合併公司因金融工具之使用而暴露於下列風險：

(1)信用風險

(2)流動性風險

(3)市場風險

本附註表達合併公司上述各項風險之暴險資訊、合併公司衡量及管理風險之目標、政策及程序。進一步量化揭露請詳附註六(十五)。

2.風險管理架構

董事會全權負責發展及控管合併公司之風險管理政策。

合併公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析合併公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及合併公司運作之變化。合併公司透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

董事會監督管理階層如何監控合併公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核合併公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助董事會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

3.信用風險

信用風險係合併公司因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而產生財務損失之風險，主要來自於合併公司現金及約當現金及應收客戶之帳款。

有關現金及約當現金、應收款項之信用風險分析，請詳附註六(十五)。另，截至民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日止，合併公司均無提供任何背書保證。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

4.流動性風險

流動性風險係合併公司無法交付現金或其他金融資產以清償金融負債，未能履行相關義務之風險。合併公司管理流動性之方法係盡可能確保合併公司在一般及具壓力之情況下，皆有足夠之流動資金以支應到期之負債，而不致發生不可接受之損失或使合併公司之聲譽遭受到損害之風險。

流動性風險係由本公司之財務部門所監控，持續監督合併公司實際現金流量部位，並使用多方面的資訊，預測並監控合併公司在長期與短期之現金流動部位，財務部門並投資額外之現金於適當到期日之存款或短期性投資，並確保合併公司之流動性，足以因應即將到期之負債。截至民國一〇四年十二月三十一日止，合併公司之營運資金及目前尚有銀行未動支之借款額度164,125千元，應足以支應履行所有合約義務，故未有無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

5.市場風險

市場風險係指因市價變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響合併公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

合併公司為管理市場匯率及受益憑證價格變動風險，所有重大交易之執行均經董事會之覆核與核准，相關財務操作亦受內部稽核部門之監督。相關之管理說明如下：

- (1)合併公司暴露於非以各該集團企業之功能性貨幣計價之銷售及採購交易所產生之匯率風險。集團企業之功能性貨幣以新台幣為主，亦有美金及人民幣，該等交易主要之計價貨幣有新台幣、美元及人民幣。

有關外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，合併公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

- (2)投資組合中重大投資均採個別管理，且所有買賣決策均經董事會之核准。

(十七)資本管理

董事會管理資本之目標係確保合併公司於繼續經營與成長之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以提供股東足夠之報酬。

董事會之資本結構管理策略，係依據合併公司所營事業之產業規模、產業未來之成本與產品發展藍圖，以設定合併公司適當之市場佔有率，並據以規劃所需之營運資金與現金，以對合併公司長期發展所需之各項資產規模，做出整體性之規劃；最後根據合併公司產品競爭力推估可能之產品邊際貢獻、營業利益率與現金流量，並考量產業景氣循環波動、產品生命週期等風險因素，以決定合併公司適當之資本結構。

董事會定期審核資本結構，並考量不同資本結構可能涉及之成本與風險。

截至民國一〇四年十二月三十一日止，合併公司資本管理之方式並未改變。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

合併公司於報導日之負債權益比率如下：

	104.12.31	103.12.31
負債總額	\$ <u>1,017,841</u>	<u>1,001,959</u>
權益總額	\$ <u>4,046,196</u>	<u>4,057,607</u>
負債權益比率	<u>25.16%</u>	<u>24.69%</u>

七、關係人交易

(一)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

合併公司對關係人之重大銷售金額如下：

	104年度	103年度
關聯企業	\$ <u>2,780,314</u>	<u>2,632,831</u>

合併公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天。合併公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

截至民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日止，合併公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為59,105千元及59,364千元，帳列採用權益法之投資項下。

合併公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項明細如下：

	104.12.31	103.12.31
關聯企業	\$ <u>585,618</u>	<u>571,953</u>

2.進貨

合併公司向關係人進貨金額如下：

	104年度	103年度
關聯企業	\$ <u>1,077</u>	<u>1,582</u>

合併公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

合併公司支付關係人耗材費、雜項購置及委託關係人提供積體電路銷售服務之金額如下：

	104年度	103年度
關聯企業	\$ <u>4,368</u>	<u>3,537</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

合併公司因上述進貨及其他交易產生之應付關係人款項如下：

	104.12.31	103.12.31
關聯企業	\$ <u>598</u>	<u>2,024</u>

3.其他交易

民國一〇四年度關聯企業代合併公司支付專門技術購置款3,244千元，截至民國一〇四年十二月三十一日止，因上述交易產生之應付關係人款項皆已付訖。

(二)主要管理階層人員交易

主要管理階層人員報酬如下：

	104年度	103年度
短期員工福利	\$ 25,685	24,001
退職後福利	432	432
	<u>\$ 26,117</u>	<u>24,433</u>

八、質押之資產

資產名稱	質押擔保標的	104.12.31	103.12.31
定期存款(帳列其他金融資產—流動)	進口關稅保證金	\$ <u>3,706</u>	<u>3,583</u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

合併公司與ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當合併公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其 他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	104年度			103年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	25,821	593,012	618,833	25,647	552,307	577,954
勞健保費用	2,071	35,595	37,666	1,965	34,521	36,486
退休金費用	1,407	36,472	37,879	1,229	32,825	34,054
其他員工福利費用	1,126	15,614	16,740	1,120	14,747	15,867
折舊費用	6,645	42,055	48,700	8,265	39,578	47,843
攤銷費用	-	66,759	66,759	-	51,272	51,272

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一〇四年度合併公司依證券發行人財務報告編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

1. 資金貸與他人：無。
2. 為他人背書保證：無。
3. 期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				期中最高	備註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	持股比率	
本公司	第一金台灣債券基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	4,922	74,314	-	74,314	-	
本公司	統一強棒基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	8,493	140,198	-	140,198	-	
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	Unitech Capital Inc.	-	以成本衡量之金融資產	2,500	86,750	5.00 %	-	5.00 %	
盛凌投資股份有限公司	瑞永投資股份有限公司	-	以成本衡量之金融資產	23,124	143,000	3.03 %	-	3.03 %	

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	期 初		買 入		賣 出				期 末	
					單位數	金額	單位數	金額	單位數	售價	帳面成本	處分損益	單位數	金額
本公司	統一強棒基金	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	統一投信	-	5,883	96,566	65,525	1,078,935	62,915	1,036,582	1,035,352	1,230	8,493	140,149 (註)

註：期末金額係取得成本，依市價評價後之帳面金額請詳3。

5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	Holtek BVI	本公司之子公司	銷貨	(511,233)	(14) %	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	187,383	30 %	
Holtek BVI	本公司	Holtek BVI之母公司	進貨	511,233	100 %	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(187,383)	(100) %	
本公司	欣宏	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(489,945)	(14) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	93,606	15 %	
欣宏	本公司	對欣宏採權益法評價之投資公司	進貨	489,945	65 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(93,606)	(83) %	

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

進(銷)貨 之公司	交易 對象 名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易 不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進 (銷) 貨	金 額	佔總進 (銷) 貨 之比率	授信 期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收 (付)票據、帳 款之比率	
本公司	優方	本公司之子公司	銷貨	(196,157)	(5) %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	33,498	5 %	
優方	本公司	優方之母公司	進貨	196,157	100 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	(33,498)	(100) %	
本公司	Crown Rich	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(183,635)	(5) %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	23,253	4 %	
Crown Rich	本公司	對Crown Rich採權益法評價之投資公司	進貨	183,635	47 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	(23,253)	(24) %	
本公司	ForIC	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(156,810)	(4) %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	38,489	6 %	
ForIC	本公司	對ForIC採權益法評價之投資公司	進貨	156,810	69 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	(38,489)	(67) %	
本公司	Newtek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(155,463)	(4) %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	29,551	5 %	
Newtek	本公司	對Newtek採權益法評價之投資公司	進貨	155,463	43 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	(29,551)	(41) %	
本公司	鉅威	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(149,859)	(4) %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	29,219	5 %	
鉅威	本公司	對鉅威採權益法評價之投資公司	進貨	149,859	13 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	(29,219)	(21) %	
本公司	New Wave	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(144,355)	(4) %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	20,949	3 %	
New Wave	本公司	對New Wave採權益法評價之投資公司	進貨	144,355	41 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	(20,949)	(29) %	
本公司	金濟	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(123,394)	(3) %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	26,192	4 %	
金濟	本公司	對金濟採權益法評價之投資公司	進貨	123,394	70 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	(26,192)	(83) %	
本公司	Truetek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(101,135)	(3) %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	18,264	3 %	
Truetek	本公司	對Truetek採權益法評價之投資公司	進貨	101,135	37 %	月結60天	尚無顯著 不同	尚無顯著不同	(18,264)	(35) %	

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項 之 公 司	交易對象 名 稱	關 係	應收關係人 款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項 期後收回金額	提列備抵 呆帳金額
					金 額	處理方式		
本公司	Holtek BVI	子公司	187,383	2.66	4,516	即期收款	17,830 (註1)	-

註1：係截至民國一〇五年一月十一日止收回之金額。

註2：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

9.從事衍生性商品交易：無。

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

10. 母子公司間業務關係及重要交易往來情形：

編號	交易人名稱	交易往來對象	與交易人 之關係	交易往來情形			
				科目	金額	交易條件	佔合併總營收或 總資產之比率
0	本公司	Holtek BVI	母公司對子公司	銷貨收入	511,233	月結90天	12.88 %
0	本公司	Holtek BVI	母公司對子公司	應收帳款	187,383	-	3.70 %
0	本公司	優方	母公司對子公司	銷貨收入	196,157	月結60天	4.94 %
0	本公司	優方	母公司對子公司	應收帳款	33,498	-	0.66 %
0	本公司	Holtek (USA)	母公司對子公司	銷貨收入	44,976	月結60天	1.13 %
0	本公司	合泰	母公司對子公司	銷貨收入	30,996	月結90天	0.78 %

註：係揭示交易金額佔合併總營收或總資產0.5%以上之交易。

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一〇四年度本公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比率	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	475,831	475,831	15,253	100.00 %	498,738	100.00 %	8,657	8,657 註3	本公司之子公司
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00 %	125,677	100.00 %	1,864	1,864 註3	本公司之子公司
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00 %	18,861	100.00 %	1,961	1,961 註3	本公司之子公司
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA) Inc.	美國加洲	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00 %	18,861	100.00 %	1,961	註1,3	本公司之孫公司
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	74,393	74,393	2,277	100.00 %	472,297	100.00 %	61,006	61,006 註3	本公司之子公司
MCU Holdings Ltd.	ForIC Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	9,733	9,733	300	40.00 %	28,377	40.00 %	8,257	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	E-Micro Technology Holding Ltd. (BVI)	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	9,473	9,473	300	100.00 %	9,093	100.00 %	(374)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Truetek Technology Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	16,306	16,306	920	40.00 %	42,024	40.00 %	6,686	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	1,868	1,868	60	40.00 %	10,162	40.00 %	1,721	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比率	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
MCU Holdings Ltd.	Innotek Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	9,411	9,411	320	40.00 %	11,252	40.00 %	3,478	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	3,758	3,758	180	40.00 %	13,291	40.00 %	10,337	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Bestway Electronic Inc.	B.V.I.	電子零件之銷售及技術服務	3,470	3,470	800	40.00 %	20,214	40.00 %	11,660	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Bestway Electronic Inc.	新榮(香港)有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	8,675	8,675	2,000	100.00 %	11,886	100.00 %	(1,066)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	New Wave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	24,784	24,784	800	40.00 %	47,441	40.00 %	17,403	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,105	8,105	1,501	40.61 %	64,016	40.61 %	24,253	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	2,641	2,641	80	40.00 %	34,465	40.00 %	13,650	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	MegaSky Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	-	-	-	-	-	40.00 %	(966)	註1,2	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Fine Chip Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	7,039	-	1	40.00 %	6,590	40.00 %	(897)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Anchip Technology Corporation	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	2,028	-	-	40.00 %	1,920	40.00 %	(159)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	金濤高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	2,400	40.00 %	18,223	40.00 %	4,053	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	滋達科技有限公司	香港	電子零件設計及銷售	5,427	5,427	1,275	33.00 %	8,451	33.00 %	3,828	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
本公司	盛凌投資股份有限公司	新竹市	專營投資業務	400,000	400,000	40,000	100.00 %	417,189	100.00 %	27,036	27,036 註3	本公司之子公司

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比例	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
盛凌投資股份有限公司	欣宏電子股份有限公司	台北市	電子零組件製造/批發/零售	77,035	77,035	6,595	40.00 %	100,462	40.00 %	51,225	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
欣宏電子股份有限公司	A-ONE WIRELESS TECHNOLOGY CORP.	B.V.I.	電子零組件製造/批發/零售	59,204	59,204	2,000	100.00 %	130,670	100.00 %	38,645	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	鈺威股份有限公司	新北市	電子零組件加工製造、買賣進出口	37,500	37,500	5,641	22.39 %	66,956	22.39 %	19,174	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	高聖科技股份有限公司	新北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	2,350	2,350	235	39.17 %	-	39.17 %	1,361	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	16,000	16,000	1,600	54.75 %	22,061	54.75 %	16,441	註1,3	本公司之孫公司
優方科技股份有限公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器件、電子材料批發	12,279	12,279	400	100.00 %	35,624	100.00 %	16,705	註1,3	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	金信科技股份有限公司	新竹市	模具批發、精密儀器批發、資訊軟體批發、電子材料批發、資訊軟體零售及電子材料零售、國際貿易及資訊軟體服務業、資訊處理服務及產品設計業、網路認證服務業	28,489	16,452	2,050	33.17 %	14,531	33.17 %	(17,831)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			期中最高 持股比例	被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額				
金信科技股 份有限公司	Gingy Technology Inc.	B.V.I	模具批發、精密儀器批發、資訊軟體批發、電子材料批發、資訊軟體零售及電子材料零售、國際貿易及資訊軟體服務業、資訊處理服務及產品設計業、網路認證服務業	988	988	2	100.00 %	1,167	100.00 %	95	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
盛凌投資股 份有限公司	天宇微機電股 份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、智慧財產權業、資訊軟體服務及國際貿易	10,002	10,002	380	20.00 %	-	20.00 %	(1,596)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股 份有限公司	盛通科技股 份有限公司	新竹市	電子零組件製造、電子材料批發零售、資訊軟體服務及國際貿易	20,000	20,000	2,000	100.00 %	13,334	100.00 %	(3,441)	註1,3	本公司之孫公司
盛通科技股 份有限公司	BestComm RF Electronics Inc.	B.V.I.	電子零組件製造/批發/零售	8,924	8,924	18	100.00 %	7,115	100.00 %	(954)	註1,3	本公司之孫公司投資之子公司

註1：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

註2：MegaSky Electronics Holding Ltd.已於民國一〇四年十二月完成清算各項權利義務及註銷登記。

註3：相關交易及期末餘額已於合併財務報告中銷除。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被 投資公 司名稱	主要營業 項目	實 收 資本額	投資 方式	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資 公司本 期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	期中最高 持股比例	本期認 列投資 損 益	期末投 資帳面 價 值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回							
芯群集成 電路(廈門)有限公司	積體電路 買賣及技 術服務	113,551	(註1)	101,027	-	-	101,027	4,534	100%	100%	4,534	122,441	-
合泰半導 體(中國)有限公司	集成電路 、電子元 器件及單 片機蕊片 之批發及 進出口業 務與諮詢 服務業務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	(4,004)	100%	100%	(4,004)	272,938	-

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	被投資公司本期損益	本公司直接或間接投資之持股比例	期中最高持股比率	本期認列投資損益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益
					匯出	收回							
新緯科技(深圳)有限公司	電子零件銷售及售後服務	6,769	(註1)	3,383	-	-	3,383	234	40%	40%	94	11,281	-
新禾(廈門)電子有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	691	40%	40%	276	13,472	-
諾華達電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	(11,316)	40%	40%	(4,526)	6,793	-
新碩電子科技(杭州)有限公司	電子元件及單片機晶片技術研發與諮詢服務業務	14,727	(註1)	-	-	-	-	1,981	40%	40%	792	16,672	-
華榮匯電子科技(北京)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	(2,199)	40%	40%	(880)	22,427	-
振揚電子(青島)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	(1,073)	40%	40%	(429)	5,952	-
新鼎電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	6,699	(註1)	2,647	-	-	2,647	2,927	40.61%	46.61%	1,189	6,121	-
信霖電子商貿(上海)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	5,856	40%	40%	2,342	42,487	-
華瑞昇電子(深圳)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	4,952	(註1)	1,964	-	-	1,964	2,983	40%	40%	1,193	13,449	-
全鼎電子(蘇州)有限公司	電子元件及單片機晶片技術支持與諮詢服務業務	3,736	(註1)	1,600	-	-	1,600	1,106	40%	40%	442	9,146	-
金科集成電路(蘇州)有限公司	電子零件銷售及售後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	1,863	100%	100%	1,863	125,634	-

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

2.轉投資大陸地區限額：

本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准投資金額(註2、3)	依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額
471,089 (美金15,111千元)	548,159 (美金16,725千元)	2,416,778 (註4)

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額；經濟部投審會核准投資金額係以資產負債表日匯率換算新台幣金額。

註3：係包括核准自台灣匯出投資金額計493,393千元(美金15,054千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計54,766千元(美金1,671千元)。

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。淨值4,027,963千元 $\times$ 60%
=2,416,778千元。

3.重大交易事項：

合併公司民國一〇四年度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項(於編製合併報告時業已沖銷)，請詳(一)「重大交易事項相關資訊」第10項「母子公司間業務關係及重要交易往來情形」之說明。

十四、部門資訊

(一)一般性資訊及部門資訊

合併公司主要營運項目為積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售，為單一營運部門。營運部門資訊與合併財務報表一致，收入(來自外部客戶收入)及部門損益請詳合併綜合損益表；部門資產請詳合併資產負債表。

(二)產品別及勞務別資訊

合併公司來自外部客戶收入資訊如下：

	104年度		103年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
積體電路銷貨收入	\$ 3,957,325	100	3,925,640	100
設計收入	10,515	-	4,879	-
	<u>\$ 3,967,840</u>	<u>100</u>	<u>3,930,519</u>	<u>100</u>

盛群半導體股份有限公司及其子公司合併財務報告附註(續)

(三)地區別資訊

合併公司地區別資訊如下，其中收入係依據客戶所在地理位置歸類，而非流動資產則依據資產所在地理位置歸類。

	104年度		103年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
來自外部客戶收入：				
中國	\$ 2,734,771	69	2,695,798	68
台灣	582,896	15	538,807	14
其他國家	650,173	16	695,914	18
	<u>\$ 3,967,840</u>	<u>100</u>	<u>3,930,519</u>	<u>100</u>
	104.12.31		103.12.31	
	金 額	佔當期總 資產之%	金 額	佔當期總 資產之%
非流動資產：				
台灣	\$ 252,821	5	258,909	5
中國	279,334	6	297,283	6
	<u>\$ 532,155</u>	<u>11</u>	<u>556,192</u>	<u>11</u>

(四)主要客戶

合併公司佔營業收入淨額10%以上之重要客戶資訊如下：

	104年度		103年度	
	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%	金 額	佔 當 期 營業收入 淨額之%
欣宏	<u>\$ 530,751</u>	<u>13</u>	<u>470,973</u>	<u>12</u>

會計師查核報告

盛群半導體股份有限公司董事會 公鑒：

盛群半導體股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達盛群半導體股份有限公司民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

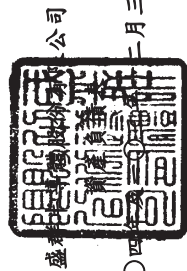
安侯建業聯合會計師事務所

會計師：曾漢鈺
游萬勛



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號
核准簽證文號

民國一〇五年一月二十五日



盛豐建設股份有限公司

民國一〇四年三月三十一日

單位：新台幣千元

		104.12.31		103.12.31	
		金	%	金	%
資產					
流動資產：					
1100 現金及約當現金(附註六(一))		\$ 383,702	8	996,708	20
1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動					
(附註六(二))		214,512	4	158,476	3
1170 應收票據及帳款淨額(附註六(三))		82,301	2	90,378	2
1180 應收關係人款項(附註七)		545,284	11	553,722	11
130X 存貨(附註六(四))		493,670	10	425,350	9
1476 其他金融資產－流動(附註六(五)及八)		1,499,484	30	1,069,281	22
1470 其他流動資產		19,899	-	20,765	-
		<u>3,238,852</u>	<u>65</u>	<u>3,314,680</u>	<u>67</u>
非流動資產：					
1550 採用權益法之投資(附註六(六))		1,427,530	29	1,361,836	27
1600 不動產、廠房及設備(附註六(七))		185,281	4	192,841	4
1840 遞延所得稅資產(附註六(十))		42,077	1	36,345	1
1900 其他非流動資產		72,115	1	70,575	1
		<u>1,727,003</u>	<u>35</u>	<u>1,661,597</u>	<u>33</u>
資產總計		<u>\$ 4,965,855</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,976,277</u>	<u>100</u>
負債及權益					
流動負債：					
應付票據					
應付帳款					
應付關係人款項(附註七)					
應付薪資及獎金					
本期所得稅負債					
其他流動負債					
		<u>65,250</u>	<u>1</u>	<u>60,623</u>	<u>1</u>
		<u>778,756</u>	<u>16</u>	<u>796,996</u>	<u>16</u>
非流動負債：					
遞延所得稅負債(附註六(十))		80,744	2	74,798	2
淨確定福利負債(附註六(九))		71,738	1	58,254	1
存入保證金		6,654	-	7,597	-
		<u>159,136</u>	<u>3</u>	<u>140,649</u>	<u>3</u>
		<u>937,892</u>	<u>19</u>	<u>937,645</u>	<u>19</u>
負債總計		<u>2,261,682</u>	<u>45</u>	<u>2,261,682</u>	<u>45</u>
權益(附註六(十一))：					
普通股股本		142,309	3	142,309	3
資本公積－普通股股票溢價					
保留盈餘：					
法定盈餘公積		794,631	16	791,920	16
特別盈餘公積		2,642	-	2,642	-
未分配盈餘		794,419	16	794,417	16
		<u>1,591,692</u>	<u>32</u>	<u>1,588,979</u>	<u>32</u>
國外營運機構財務報告換算之兌換差額		32,280	1	45,662	1
		<u>4,027,963</u>	<u>81</u>	<u>4,038,632</u>	<u>81</u>
權益總計		<u>\$ 4,965,855</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,976,277</u>	<u>100</u>
負債及權益總計					



董事長：

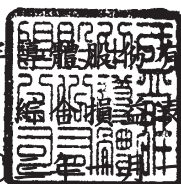


經理人：

閱後附個體財務報告附註)



會計主管：



民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	104年度		103年度	
	金額	%	金額	%
4100 營業收入淨額(附註七)	\$ 3,601,285	100	3,605,717	100
5110 營業成本(附註六(四)及七)	1,881,449	53	1,920,337	53
營業毛利	1,719,836	47	1,685,380	47
5910 未實現銷貨利益之變動	18,820	-	19,243	1
已實現營業毛利	1,701,016	47	1,666,137	46
營業費用：				
6100 推銷費用	99,625	3	86,046	2
6200 管理費用	230,857	6	223,090	6
6300 研究發展費用	560,110	16	562,351	16
	890,592	25	871,487	24
營業淨利	810,424	22	794,650	22
營業外收入及支出：				
7100 利息收入	20,227	-	20,454	1
7070 採用權益法認列之子公司利益之份額(附註六(六))	100,524	3	84,129	2
7020 其他利益(損失)淨額(附註六(十四))	(1,497)	-	28,186	1
	119,254	3	132,769	4
稅前淨利	929,678	25	927,419	26
7950 所得稅費用(附註六(十))	122,872	3	135,863	4
本期淨利	806,806	22	791,556	22
8300 其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8341 確定福利計畫之再衡量數	(15,066)	-	888	-
8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十))	2,562	-	(151)	-
不重分類至損益之項目合計	(12,504)	-	737	-
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	(16,122)	-	36,062	1
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅(附註六(十))	2,740	-	(6,130)	-
後續可能重分類至損益之項目合計	(13,382)	-	29,932	1
8300 本期其他綜合損益	(25,886)	-	30,669	1
本期綜合損益總額	\$ 780,920	22	822,225	23
每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十二))				
9750 基本每股盈餘	\$ 3.57		3.50	
9850 稀釋每股盈餘	\$ 3.52		3.46	

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：





民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

	普通股 股本	預收股本	資本公積	保留盈餘		國外營運機構財務報告換算之兌換差	權益總計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積		
民國一〇三年一月一日餘額	\$ 2,249,412	40,368	114,211	777,359	4,598	15,730	3,962,762
本期淨利	-	-	-	-	-	-	791,556
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	29,932	30,669
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	29,932	822,225
盈餘指撥及分配(註1)：							
提列法定盈餘公積	-	-	-	74,495	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(59,934)	-	-	(746,355)
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	-	(1,956)	-	-
員工行使認股權	12,270	(40,368)	28,098	-	-	-	-
民國一〇三年十二月三十一日餘額	2,261,682	-	142,309	791,920	2,642	45,662	4,038,632
本期淨利	-	-	-	-	-	-	806,806
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(13,382)	(25,886)
本期綜合損益總額	-	-	-	-	-	(13,382)	780,920
盈餘指撥及分配(註2)：							
提列法定盈餘公積	-	-	-	79,156	-	-	-
普通股現金股利	-	-	-	(76,445)	-	-	(791,589)
民國一〇四年十二月三十一日餘額	\$ 2,261,682	-	142,309	794,631	2,642	32,280	4,027,963

註1：董監酬勞10,057千元及員工紅利90,511千元已於綜合損益表中扣除。

註2：董監酬勞10,686千元及員工紅利96,174千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：

(請詳閱) 個體財務報告附註)



經理人：



會計主管：

民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	104年度	103年度
營業活動之現金流量：		
本期稅前淨利	\$ 929,678	927,419
調整項目：		
折舊費用	28,717	28,906
攤銷費用	65,954	50,226
利息收入	(20,227)	(20,454)
採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額	(100,524)	(84,129)
聯屬公司間未實現銷貨利益變動	18,820	19,243
其他不影響現金流量之費損淨額	4,011	949
與營業活動相關之資產及負債淨變動數：		
持有供交易之金融資產減少(增加)	(56,384)	104,737
應收票據及帳款(含應收關係人款項)減少(增加)	16,515	(83,544)
存貨減少(增加)	(72,203)	26,199
其他營業資產增加	(5,117)	(18,069)
應付票據及帳款(含應付關係人款項)增加(減少)	(4,604)	6,676
淨確定福利負債減少	(1,582)	(1,687)
其他營業負債增加(減少)	5,799	(4,860)
營運產生之現金流入	808,853	951,612
收取利息	20,184	20,195
支付所得稅淨額	(142,312)	(111,213)
營業活動之淨現金流入	686,725	860,594
投資活動之現金流量：		
採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	59,860
取得不動產、廠房及設備	(21,642)	(10,432)
處分不動產、廠房及設備價款	593	450
存出保證金減少(增加)	51	(331)
其他金融資產減少(增加)	(431,423)	56,993
其他非流動資產增加	(54,778)	(47,190)
投資活動之淨現金流入(出)	(507,199)	59,350
籌資活動之現金流量：		
存入保證金減少	(943)	-
發放股東現金股利	(791,589)	(746,355)
籌資活動之淨現金流出	(792,532)	(746,355)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(613,006)	173,589
期初現金及約當現金餘額	996,708	823,119
期末現金及約當現金餘額	\$ 383,702	996,708

董事長：



(請詳閱後附財務報告附註)

經理人：



會計主管：



盛群半導體股份有限公司
個體財務報告附註
民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日
(除另有註明者外，所有金額均以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

盛群半導體股份有限公司(以下稱「本公司」)於民國八十七年十月一日依中華民國公司法及科學園區設置管理條例之規定成立，自民國八十七年十二月十一日開始營業，民國八十九年四月於香港設立分公司。本公司股票自民國九十一年十一月四日起於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌買賣，自民國九十三年九月二十七日起改於台灣證券交易所股份有限公司掛牌買賣。

本公司主要營業項目為各種積體電路之研究、開發、生產、製造及銷售。

二、通過財務報告之日期及程序

本個體財務報告已於民國一〇五年一月二十五日經董事會通過。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一)已採用金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）認可之新發布及修訂後準則及解釋之影響

本公司自民國一〇四年起全面採用經金管會認可並發布生效之2013年版國際財務報導準則（不包含國際財務報導準則第九號「金融工具」）編製財務報告，相關新發布、修正及修訂之準則及解釋彙列如下：

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第1號之修正「國際財務報導準則第7號之比較揭露對首次採用者之有限度豁免」	99.7.1
國際財務報導準則第1號之修正「嚴重高度通貨膨脹及首次採用者固定日期之移除」	100.7.1
國際財務報導準則第1號之修正「政府貸款」	102.1.1
國際財務報導準則第7號之修正「揭露—金融資產之移轉」	100.7.1
國際財務報導準則第7號之修正「揭露—金融資產及金融負債之互抵」	102.1.1
國際財務報導準則第10號「合併財務報表」	102.1.1 (投資個體於103.1.1生效)
國際財務報導準則第11號「聯合協議」	102.1.1
國際財務報導準則第12號「對其他個體之權益之揭露」	102.1.1

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

新發布／修正／修訂準則及解釋	國際會計準則理事會發布之生效日
國際財務報導準則第13號「公允價值衡量」	102.1.1
國際會計準則第1號之修正「其他綜合損益項目之表達」	101.7.1
國際會計準則第12號之修正「遞延所得稅：標的資產之回收」	101.1.1
國際會計準則第19號之修訂「員工福利」	102.1.1
國際會計準則第27號之修訂「單獨財務報表」	102.1.1
國際會計準則第32號之修正「金融資產及金融負債之互抵」	103.1.1
國際財務報導解釋第20號「露天礦場於生產階段之剝除成本」	102.1.1

除下列各項外，適用2013年版國際財務報導準則並未對個體財務報告造成重大變動：

1. 國際會計準則第19號「員工福利」

該準則主要修正以淨確定福利負債（資產）乘以折現率決定淨利息，並用其取代準則修訂前之利息成本及計畫資產之預期報酬、刪除精算損益得採「緩衝區法」或發生時一次列入損益之會計政策選擇，並規定精算損益應於發生時列入其他綜合損益、前期服務成本應於發生時認列為損益，不再於符合既得條件前之平均期間內按直線法分攤認列為費用，另企業係於不再能撤銷離職福利之要約或於認列相關重組成本之孰早者認列離職福利，而非僅於已明確承諾相關離職事件時，始應認列離職福利為負債及費用等。此外增加確定福利計畫之揭露規定。該準則對本公司財務狀況與經營結果無重大影響，惟依規定增加確定福利計畫相關揭露。

2. 國際會計準則第1號「財務報表之表達」

該準則修正其他綜合損益之表達方式，將列示於其他綜合損益之項目依性質分類為「後續不重分類至損益」及「後續將重分類至損益」兩類別。該修正同時規定以稅前金額列示之其他綜合損益項目，其相關稅額應隨前述兩類別予以單獨列示。本公司已依該準則改變綜合損益表之表達方式。

3. 國際財務報導準則第12號「對其他個體之權益之揭露」

該準則整合各號準則對企業所持有子公司、聯合協議、關聯企業及未納入合併財務報告之結構型個體之權益揭露規定，並要求揭露相關資訊。本公司依該準則增加有關關聯企業之資訊揭露。

4. 國際財務報導準則第13號「公允價值衡量」

該準則定義公允價值，建立公允價值衡量之架構，並規範公允價值衡量相關揭露。該準則對本公司財務狀況與經營結果無重大影響，惟依規定增加公允價值衡量相關揭露。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(二)金管會尚未認可之新發布及修訂準則及解釋

下表彙列國際會計準則理事會（以下簡稱「理事會」）已發布，惟截至報導日止尚未經金管會認可及公布生效日之準則及解釋：

新發布／修正／修訂準則及解釋	理事會發布之生效日
國際財務報導準則第9號「金融工具」	107.1.1
國際財務報導準則第10號及國際會計準則第28號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	尚待理事會決定
國際財務報導準則第10號、國際財務報導準則第12號及國際會計準則第28號之修正「投資個體：合併報表例外規定之適用」	105.1.1
國際財務報導準則第11號之修正「處理聯合營運權益之取得」	105.1.1
國際財務報導準則第14號「管制遞延帳戶」	105.1.1
國際財務報導準則第15號「來自客戶合約之收入」	107.1.1
國際財務報導準則第16號「租賃」	108.1.1
國際會計準則第1號之修正「揭露計畫」	105.1.1
國際會計準則第16號及國際會計準則第38號之修正「闡明可接受之折舊及攤銷方法」	105.1.1
國際會計準則第16號及國際會計準則第41號之修正「生產性植物」	105.1.1
國際會計準則第19號之修正「確定福利計畫：員工提撥」	103.7.1
國際會計準則第27號之修正「單獨財務報表之權益法」	105.1.1
國際會計準則第36號之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	103.1.1
國際會計準則第39號之修正「衍生工具之約務更替及避險會計之持續適用」	103.1.1
2010-2012及2011-2013週期之年度改善	103.7.1
2012-2014年國際財務報導年度改善	105.1.1
國際財務報導解釋第21號「公課」	103.1.1

本公司現正持續評估上述準則及解釋對本公司財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

本個體財務報告所採用之重大會計政策彙總說明如下。除另有說明者外，下列會計政策已一致適用於本個體財務報告之所有表達期間。

(一)遵循聲明

本個體財務報告係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(二)編製基礎

1.衡量基礎

除下列資產負債表之重要項目外，本個體財務報告係依歷史成本為基礎編製：

- (1)透過損益按公允價值衡量之金融工具(包括衍生金融工具)；及
- (2)確定福利負債，係依退休基金資產加計未認列前期服務成本與未認列精算損失，減除未認列精算利益與確定福利義務現值之淨額認列。

2.功能性貨幣及表達貨幣

本公司以營運所處主要經濟環境之貨幣為功能性貨幣。本個體財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。所有以新台幣表達之財務資訊均以新台幣千元為單位。

(三)外幣

1.外幣交易

外幣交易依交易日之匯率換算為功能性貨幣。報導日之外幣貨幣性項目依當日之匯率換算為功能性貨幣，其兌換損益係指期初以功能性貨幣計價之攤銷後成本，調整當期之有效利息及付款後之金額，與依外幣計價之攤銷後成本按報導日匯率換算金額間之差異。以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目依衡量公允價值當日之匯率重新換算為功能性貨幣，以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則依交易日之匯率換算。除備供出售金融資產、指定為國外營運機構淨投資避險之金融負債或合格之現金流量避險，換算所產生之外幣兌換差異認列於其他綜合損益外，其餘係認列為損益。

2.國外營運機構

國外營運機構之資產及負債，係依報導日之匯率換算為新台幣；股東權益項目除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘依歷史匯率換算為新台幣；收益及費損項目係依當期平均匯率換算為新台幣，所產生之兌換差額均認列為其他綜合損益。

當處分國外營運機構致喪失控制、共同控制或重大影響時，與該國外營運機構相關之累計兌換差額係全數重分類為損益。部分處分含有國外營運機構之子公司時，相關累計兌換差額係按比例重新歸屬至非控制權益。部分處分含有國外營運機構之關聯企業或合資之投資時，相關累計兌換差額則按比例重分類至損益。

(四)資產與負債區分流動與非流動之分類標準

符合下列條件之一之資產列為流動資產，非屬流動資產之所有其他資產則列為非流動資產：

- 1.預期於本公司正常營業週期中實現，或意圖將其出售或消耗者。
- 2.主要為交易目的而持有者。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

3.預期將於資產負債表日後十二個月內實現者。

4.現金或約當現金，但不包括於資產負債表日後逾十二個月用以交換、清償負債或受有其他限制者。

符合下列條件之一之負債列為流動負債，非屬流動負債之所有其他負債則列為非流動負債：

1.預期將於本公司正常營業週期中清償者。

2.主要為交易目的而持有者。

3.預期將於資產負債表日後十二個月內到期清償者。

4.本公司不能無條件將清償期限延期至資產負債表日後至少十二個月者。

(五)現金及約當現金

現金包括庫存現金及活期存款。約當現金係指可隨時轉換成定額現金且價值變動風險甚小之短期並具高度流動性之投資。定期存款符合前述定義且持有目的係滿足短期現金承諾而非投資或其他目的者，列報於約當現金。

(六)金融工具

1.金融資產

(1)透過損益按公允價值衡量之金融資產

此類金融資產係指持有供交易之金融資產，其取得或發生之主要目的為短期內出售或再買回。此類金融資產於原始認列時係按公允價值衡量，交易成本於發生時認列為損益；後續評價按公允價值衡量，再衡量產生之利益或損失認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交易日會計處理。

(2)應收款

應收款係無活絡市場公開報價，且具固定或可決定付款金額之金融資產，包括應收款項及其他應收款。原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本減除減損損失衡量，惟短期應收款項之利息認列不具重大性之情況除外。

(3)金融資產減損

非透過損益按公允價值衡量之金融資產，於每個報導日評估減損。當有客觀證據顯示，因金融資產原始認列後發生之單一或多項事件，致使該資產之估計未來現金流量受損失者，該金融資產即已發生減損。

針對應收帳款個別評估未有減損後，另再以組合基礎評估減損。應收款組合之客觀減損證據可能包含本公司過去收款經驗、該組合超過平均授信期間之延遲付款增加情況，以及與應收款拖欠有關之全國性或區域性經濟情勢變化。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除，惟應收款之減損損失係藉由備抵帳戶調降其帳面金額，當判斷應收款無法收回時，則沖銷備抵帳戶，原先已沖銷而後續收回之款項則貸記備抵帳戶。備抵帳戶帳面金額之變動認列於損益。

當金融資產以攤銷後成本衡量時，若後續期間減損損失金額減少，且該減少客觀地連結至認列減損後發生之事項，則先前認列之減損損失予以迴轉認列於損益，惟該投資於減損迴轉日之帳面金額不得大於若未認列減損情況下應有之攤銷後成本。

(4)金融資產之除列

本公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利終止，或已移轉金融資產且該資產幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

2.金融負債

(1)應付款

金融負債非屬持有供交易且未指定為透過損益按公允價值衡量者，包括應付帳款及其他應付款，原始認列時係按公允價值加計直接可歸屬之交易成本衡量；續後評價採有效利率法以攤銷後成本衡量。

(2)金融負債之除列

本公司係於合約義務已履行、取消或到期時，除列金融負債。

除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額間之差額認列為損益，並列報於營業外收入及支出項下。

(3)金融資產及負債之互抵

金融資產及金融負債僅於本公司有法定權利進行互抵及有意圖以淨額交割或同時變現資產及清償負債時，方予以互抵並以淨額表達於資產負債表。

(七)存貨

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。成本包括使其達可供使用之地點及狀態所發生之必要支出，並採加權平均法計算。淨變現價值係正常營業下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用為計算基礎。

(八)投資關聯企業

關聯企業係指本公司對其財務及營運政策具有重大影響力但未達控制能力者。本公司持有被投資公司百分之二十至百分之五十之表決權時，即假設具有重大影響力，並採權益法評價。

在權益法下，原始取得時係依成本認列，投資成本包含交易之成本。投資關聯企業之帳面金額包括原始投資時所辨認之商譽，減除任何累計減損損失。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

個體財務報告包括自具有重大影響力之日起至喪失重大影響力之日止，於進行與本公司會計政策一致性之調整後，本公司依權益比例認列各該投資關聯企業之損益及其他綜合損益之金額。

本公司與關聯企業間之交易所產生之未實現損益，已在本公司對該被投資公司之權益範圍內予以消除。

當本公司依比例應認列關聯企業之損失份額等於或超過其在關聯企業之權益時，即停止認列其損失，而僅於發生法定義務、推定義務或已代該被投資公司支付款項之範圍內，認列額外之損失及相關負債。

(九)投資子公司

於編製個體財務報告時，本公司對具控制力之被投資公司係採權益法評價。在權益法下，個體財務報告當期損益及其他綜合損益與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬於母公司業主之分攤數相同，且個體財務報告業主權益與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。

本公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制者，作為與業主間之權益交易處理。

(十)不動產、廠房及設備

1.認列與衡量

不動產、廠房及設備之認列及衡量係採成本模式，依成本減除累計折舊與累計減損後之金額衡量。成本包含可直接歸屬於取得資產之支出、任何其他使資產達預計用途之可使用狀態的直接可歸屬成本、拆卸與移除該項目及復原所在地點之成本。此外，為整合相關設備功能而購入之軟體亦資本化為該設備之一部分。

當不動產、廠房及設備包含不同組成部分，且相對於該項目之總成本若屬重大而採用不同之折舊方法較為合宜時，則視為不動產、廠房及設備之單獨項目(主要組成部分)處理。

不動產、廠房及設備之處分損益，以淨額認列於營業外收入及支出項下。

2.後續成本

若不動產、廠房及設備項目後續支出所預期產生之未來經濟效益很有可能流入本公司，且其金額能可靠衡量，則該支出認列為該項目帳面金額之一部分，被重置部分之帳面金額則予以除列。不動產、廠房及設備之日常維修成本於發生時認列為損益。

3.折舊

折舊係依資產成本減除殘值後按估計耐用年限採直線法計提，並依資產之各別重大組成部分評估，若一組成部分之耐用年限不同於資產之其他部分，則此組成部分應單獨提列折舊。折舊之提列認列為損益。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

當期及比較期間之估計耐用年限如下：

- (1)房屋及建築物：20~30年
- (2)機器設備：3~5年
- (3)其他設備：2~8年

每年至少於財務年度結束日檢視不動產、廠房及設備之折舊方法、耐用年限及殘值，若有變動，視為會計估計變動。

(十一)租賃

營業租賃之租金給付依直線法於租賃期間認列為費用。

(十二)無形資產

1.研究與發展

研究階段係指預期為獲取及瞭解嶄新的科學或技術知識而進行之活動，相關支出於發生時認列於損益。

發展階段之支出於同時符合下列所有條件時，認列為無形資產；未同時符合者，於發生時即認列於損益：

- (1)完成無形資產之技術可行性已達成，使該無形資產將可供使用或出售。
- (2)意圖完成該無形資產，並加以使用或出售。
- (3)有能力使用或出售該無形資產。
- (4)無形資產將很有可能產生未來經濟效益。
- (5)具充足之技術、財務及其他資源，以完成此項發展，並使用或出售該無形資產。
- (6)歸屬於該無形資產發展階段之支出能可靠衡量。

2.其他無形資產

本公司取得其他無形資產係以成本減除累計攤銷與累計減損衡量之。

3.後續支出

後續支出僅於可增加相關特定資產的未來經濟效益時，方將其資本化。

4.攤銷

攤銷時係以資產成本減除殘值後金額為可攤銷金額，自達可供使用狀態起，按估計耐用年限採直線法攤銷，攤銷數認列於損益。

每年至少於財務年度結束日檢視無形資產之殘值、攤銷期間及攤銷方法，若有變動，視為會計估計變動。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十三)非金融資產減損

針對存貨及遞延所得稅資產以外之非金融資產，本公司於每一報導日評估是否發生減損，就有減損跡象之資產(個別資產或現金產生單位)估計其可回收金額，並就可回收金額低於帳面價值之資產，認列減損損失。於以前年度所認列除商譽以外之累計減損損失，嗣後若已不存在或減少，則迴轉增加帳面價值至可回收金額，惟不超過資產在未認列減損損失下，減除應提列折舊或攤銷之數。

(十四)收入認列

正常活動中銷售商品所產生之收入，係考量退回、商業折扣及數量折扣後，按已收或應收對價之公允價值衡量。收入係俟具說服力之證據存在、所有權之重大風險及報酬已移轉予買方、價款很有可能收回及相關成本與可能之商品退回能可靠估計、不持續參與商品之管理及收入金額能可靠衡量時加以認列。若折扣很有可能發生且金額能可靠衡量時，則於銷售認列時予以認列作為收入之減項。

風險及報酬移轉之時點係視銷售合約個別條款而定。

(十五)員工福利

1.確定提撥計畫

確定提撥退休金計畫之提撥義務係於員工提供勞務期間內認列為損益項下之員工福利費用。

2.確定福利計畫

本公司在確定福利退休金計畫下之淨義務係針對福利計畫以員工當期或過去服務所賺得之未來福利金額折算為現值計算。任何未認列之前期服務成本及計畫資產之公允價值均予以減除。折現率係以到期日與本公司淨義務期限接近，且計價幣別與預期支付福利金相同之政府公債之市場殖利率於年度報導日之利率為主。

企業淨義務每年由精算師以預計單位福利法精算。當計算結果對本公司有利時，認列資產係以任何未認列之前期服務成本，及未來得以從該計畫退還之資金或減少未來對該計畫之提撥等方式所可獲得經濟效益現值之總額為限。計算經濟效益現值時應考量任何適用於本公司任何計畫之最低資金提撥需求。一項效益若能在計畫期間內或計畫負債清償時實現，對本公司而言，即具有經濟效益。

本公司所有確定福利計畫續後產生之精算損益立即認列於其他綜合損益，並於當期結轉至保留盈餘。

3.短期員工福利

短期員工福利義務係以未折現之基礎衡量，且於提供相關服務時認列為費用。

有關短期現金紅利或分紅計畫下預期支付之金額，若係因員工過去提供服務而使本公司負有現時之法定或推定支付義務，且該義務能可靠估計時，將該金額認列為負債。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十六)股份基礎給付交易

給與員工之股份基礎給付獎酬以給與日之公允價值，於員工達到可無條件取得報酬之期間內，認列酬勞成本並增加相對權益。認列之酬勞成本係隨預期符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量予以調整；而最終認列之金額係以既得日符合服務條件及非市價既得條件之獎酬數量為基礎衡量。

股份基礎給付協議之給與日在民國九十七年一月一日前，且既得日在民國一〇一年一月一日(金管會認可之國際財務報導準則轉換日)前之員工認股權計畫，選擇適用國際財務報導準則第1號之豁免，依金管會民國九十八年一月十日發布之證券發行人財務報告編製準則及財團法人中華民國會計研究發展基金會公布之各號財務會計準則公報及其解釋(以下簡稱先前一般公認會計原則)認列，採用內含價值法認列酬勞性員工認股選擇權計畫之酬勞成本，亦即按衡量日本公司股票市價與行使價格間之差額估計為酬勞成本，並於員工認股選擇權計畫所規定之員工服務年限內認列為本公司之費用，同時增加本公司之股東權益。

(十七)所得稅

所得稅費用包括當期及遞延所得稅。除與企業合併、直接認列於權益或其他綜合損益之項目相關者外，當期所得稅及遞延所得稅應認列於損益。

當期所得稅包括當年度課稅所得(損失)按報導日之法定稅率或實質性立法稅率計算之預計應付所得稅或應收退稅款，及任何對以前年度應付所得稅的調整。

遞延所得稅係就資產及負債於財務報導目的之帳面金額與其課稅基礎之暫時性差異予以衡量認列。

遞延所得稅係以預期資產實現或負債清償當期之稅率衡量，並以報導日之法定稅率或實質性立法稅率為基礎。

本公司僅於同時符合下列條件時，始將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵：

- 1.有法定執行權將當期所得稅資產及當期所得稅負債互抵；且
- 2.遞延所得稅資產及遞延所得稅負債與下列由同一稅捐機關課徵所得稅之納稅主體之一有關；
 - (1)同一納稅主體；或
 - (2)不同納稅主體，惟各主體意圖在重大金額之遞延所得稅資產預期回收及遞延所得稅負債預期清償之每一未來期間，將當期所得稅負債及資產以淨額基礎清償，或同時實現資產及清償負債。

對於可遞轉後期之未使用所得稅抵減及可減除暫時性差異，在很有可能有未來課稅所得可供使用之範圍內，認列為遞延所得稅資產。並於每一報導日予以重評估，就相關所得稅利益非屬很有可能實現之範圍內予以調減。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十八)每股盈餘

本公司列示歸屬於本公司普通股權益持有人之基本及稀釋每股盈餘。基本每股盈餘係以歸屬於本公司普通股權益持有人之損益，除以當期加權平均流通在外普通股股數計算之。稀釋每股盈餘則係將歸屬於本公司普通股權益持有人之損益及加權平均流通在外普通股股數，分別調整所有潛在稀釋普通股之影響後計算之。本公司之潛在稀釋普通股包括本公司尚未經股東會決議且得採股票發放之員工分紅。因盈餘或資本公積轉增資而新增之股份，採追溯調整計算。

(十九)部門資訊

本公司已於合併財務報告揭露部門資訊，因此個體財務報告不揭露部門資訊。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

管理階層依「證券發行人財務報告編製準則」編製本個體財務報告時，必須作出判斷、估計及假設，其將對會計政策之採用及資產、負債、收益及費用之報導金額有所影響。實際結果可能與估計存有差異。

管理當局持續檢視估計及基本假設，會計估計變動於變動期間及受影響之未來期間予以認列。

對於假設及估計之不確定性中，存有重大風險將於未來次一年度造成重大調整之相關資訊，請詳下列附註：

(一)附註六(四)，存貨之評價。

(二)附註六(九)，確定福利義務之衡量。

本公司之會計政策及揭露包含採用公允價值衡量其金融、非金融資產及負債。本公司之財務部門負責進行公允價值驗證，藉獨立、可靠、且能代表可執行價格之資料使評價結果貼近市場狀態，並定期校準評價模型、進行回溯測試、更新評價模型所需輸入值及資料及其他任何必要之公允價值調整，以確保評價結果係屬合理。

本公司在衡量其資產和負債時，盡可能使用市場可觀察之輸入值。公允價值之等級係以評價技術使用之輸入值為依據，歸類如下：

第一級：相同資產或負債於活絡市場之公開報價（未經調整）。

第二級：除包含於第一級之公開報價外，資產或負債之輸入參數係直接（即價格）或間接（即由價格推導而得）可觀察。

第三級：資產或負債之輸入參數非基於可觀察之市場資料（非可觀察參數）。

若發生公允價值各等級間之移轉事項或情況，本公司係於報導日認列該移轉。衡量公允價值所採用假設之相關資訊請詳附註六(十五)，金融工具。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

六、重要會計項目之說明

(一)現金及約當現金

	104.12.31	103.12.31
現金及活期存款	\$ 109,429	72,072
定期存款	274,273	924,636
	<u>\$ 383,702</u>	<u>996,708</u>

(二)透過損益按公允價值衡量之金融資產

	104.12.31	103.12.31
持有供交易之金融資產－受益憑證	<u>\$ 214,512</u>	<u>158,476</u>

(三)應收票據及帳款淨額

	104.12.31	103.12.31
應收票據	\$ 715	530
應收帳款	88,979	97,241
	89,694	97,771
減：備抵呆帳	(7,393)	(7,393)
	<u>\$ 82,301</u>	<u>90,378</u>

本公司於民國一〇四年度及一〇三年度針對應收票據及應收帳款並無提列(迴轉)減損損失情形。

(四)存貨

	104.12.31	103.12.31
原料及物料	\$ 113,728	106,191
在製品	165,155	122,286
製成品及商品	214,787	196,873
	<u>\$ 493,670</u>	<u>425,350</u>

營業成本組成明細如下：

	104年度	103年度
銷貨成本	\$ 1,877,566	1,919,942
迴轉存貨跌價損失	(4,000)	(6,000)
報廢成本	7,883	6,395
	<u>\$ 1,881,449</u>	<u>1,920,337</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(五)其他金融資產－流動

	<u>104.12.31</u>	<u>103.12.31</u>
定期存款(三個月以上)	\$ 1,490,300	1,059,000
受限制銀行存款	3,706	3,583
其他	<u>5,478</u>	<u>6,698</u>
	<u><u>\$ 1,499,484</u></u>	<u><u>1,069,281</u></u>

(六)採用權益法之投資

本公司於報導日採用權益法之投資列示如下：

	<u>104.12.31</u>	<u>103.12.31</u>
子公司	\$ 1,532,762	1,448,360
減：聯屬公司間未實現交易利得	<u>(105,232)</u>	<u>(86,524)</u>
	<u><u>\$ 1,427,530</u></u>	<u><u>1,361,836</u></u>

子公司相關資訊請參閱民國一〇四年度合併財務報告。

本公司民國一〇四年度及一〇三年度所享有子公司利益之份額分別為100,524千元及84,129千元。

(七)不動產、廠房及設備

本公司不動產、廠房及設備之成本及累計折舊變動明細如下：

	<u>土 地</u>	<u>房 屋 及 建 築</u>	<u>機 器 設 備</u>	<u>其 他 設 備</u>	<u>總 計</u>
成本：					
民國104年1月1日餘額	\$ 26,676	259,522	233,643	38,757	558,598
增添	-	3,141	8,382	10,119	21,642
處分	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(11,579)</u>	<u>(1,320)</u>	<u>(12,899)</u>
民國104年12月31日餘額	<u><u>\$ 26,676</u></u>	<u><u>262,663</u></u>	<u><u>230,446</u></u>	<u><u>47,556</u></u>	<u><u>567,341</u></u>
民國103年1月1日餘額	\$ 26,676	257,763	238,553	43,151	566,143
增添	-	1,759	7,185	1,488	10,432
處分	-	-	(15,165)	(6,206)	(21,371)
重分類	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,070</u>	<u>324</u>	<u>3,394</u>
民國103年12月31日餘額	<u><u>\$ 26,676</u></u>	<u><u>259,522</u></u>	<u><u>233,643</u></u>	<u><u>38,757</u></u>	<u><u>558,598</u></u>
累計折舊：					
民國104年1月1日餘額	\$ -	130,123	200,809	34,825	365,757
本期折舊	-	12,802	13,293	2,622	28,717
處分	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(11,094)</u>	<u>(1,320)</u>	<u>(12,414)</u>
民國104年12月31日餘額	<u><u>\$ -</u></u>	<u><u>142,925</u></u>	<u><u>203,008</u></u>	<u><u>36,127</u></u>	<u><u>382,060</u></u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	土 地	房 屋 及 建 築	機 器 設 備	其 他 設 備	總 計
民國103年1月1日餘額	\$ -	117,768	201,174	39,135	358,077
本期折舊	-	12,355	14,654	1,897	28,906
處分	-	-	(15,019)	(6,207)	(21,226)
民國103年12月31日餘額	<u>\$ -</u>	<u>130,123</u>	<u>200,809</u>	<u>34,825</u>	<u>365,757</u>
帳面價值：					
民國104年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>119,738</u>	<u>27,438</u>	<u>11,429</u>	<u>185,281</u>
民國103年12月31日	<u>\$ 26,676</u>	<u>129,399</u>	<u>32,834</u>	<u>3,932</u>	<u>192,841</u>
民國103年1月1日	<u>\$ 26,676</u>	<u>139,995</u>	<u>37,379</u>	<u>4,016</u>	<u>208,066</u>

(八)營業租賃

- 1.本公司依已簽訂之辦公室、停車位及員工宿舍租賃合約，預估未來最低租金給付額彙列如下：

	104.12.31	103.12.31
一年內	\$ 7,633	10,121
一年以上至二年	838	5,024
	<u>\$ 8,471</u>	<u>15,145</u>

- 2.本公司廠房之土地係向科學工業園區管理局承租，租賃期間自民國九十年三月十五日起至民國一〇九年十二月三十一日止，且租賃期間屆滿時得另訂新約。自民國一〇二年五月起租金每年約為3,360千元，如遇政府調整地價時，租金亦隨同調整。

(九)員工福利

1.確定福利計畫

本公司確定福利義務現值與計畫資產公允價值之調節如下：

	104.12.31	103.12.31
確定福利義務現值	\$ 119,433	106,093
計畫資產之公允價值	(47,695)	(47,839)
淨確定福利負債	<u>\$ 71,738</u>	<u>58,254</u>

本公司之確定福利計畫係提撥至台灣銀行之勞工退休準備金專戶。適用勞動基準法之每位員工之退休支付，係依據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。

(1)計畫資產組成

本公司依勞動基準法提撥之退休基金係由勞動部勞動基金運用局(以下簡稱勞動基金局)統籌管理，依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」規定，基金之運用，其每年決算分配之最低收益，不得低於依當地銀行二年定期存款利率計算之收益。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

截至報導日，本公司之台灣銀行勞工退休準備金專戶餘額計47,695千元。勞工退休基金資產運用之資料包括基金收益率以及基金資產配置，請詳勞動基金局網站公布之資訊。

(2)確定福利義務現值之變動

本公司民國一〇四年度及一〇三年度確定福利義務現值變動如下：

	104年度	103年度
1月1日確定福利義務	\$ 106,093	108,330
計畫支付之福利	(4,189)	(3,636)
當期服務成本及利息	2,228	2,167
淨確定福利負債之再衡量數		
— 因財務假設變動所產生之精算損(益)	11,861	(1,670)
— 因經驗變動所產生之精算損失	3,440	902
12月31日確定福利義務	<u>\$ 119,433</u>	<u>106,093</u>

(3)計畫資產公允價值之變動

本公司民國一〇四年度及一〇三年度確定福利計畫資產公允價值之變動如下：

	104年度	103年度
1月1日計畫資產之公允價值	\$ 47,839	47,501
計畫支付之福利	(4,189)	(3,636)
計畫資產預計報酬	1,035	979
計劃參與者之提撥	2,775	2,875
淨確定福利負債之再衡量數		
— 計劃資產報酬(不含當期利息)	235	120
12月31日計畫資產之公允價值	<u>\$ 47,695</u>	<u>47,839</u>

(4)認列為損益之費用

本公司民國一〇四年度及一〇三年度認列為損益之費用如下：

	104年度	103年度
利息成本	\$ 2,228	2,167
計畫資產預計報酬	(1,035)	(979)
	<u>\$ 1,193</u>	<u>1,188</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	104年度	103年度
營業成本	\$ 84	71
推銷費用	79	72
管理費用	239	260
研究發展費用	791	785
	<u>\$ 1,193</u>	<u>1,188</u>

(5)認列為其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數

本公司民國一〇四年度及一〇三年度累計認列於其他綜合損益之淨確定福利負債之再衡量數如下：

	104年度	103年度
1月1日累積餘額	\$ (4,102)	(3,214)
本期認列	15,066	(888)
12月31日累積餘額	<u>\$ 10,964</u>	<u>(4,102)</u>

(6)精算假設

本公司所使用之主要精算假設如下：

A.用於精算民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日確定福利義務現值者

	104.12.31	103.12.31
折現率	1.40 %	2.10 %
未來薪資成長率	2.00 %	2.10 %

B.用於精算民國一〇四年度及一〇三年度確定福利計劃成本者

	104年度	103年度
折現率	2.10 %	2.00 %
未來薪資成長率	2.10 %	2.00 %

本公司預計於民國一〇四年度報導日後之一年內支付予確定福利計畫之提撥金額為2,800千元。

確定福利計畫之加權平均存續期間為15.1年。

(7)敏感度分析

計算確定福利義務現值時，本公司必須運用判斷及估計以決定資產負債表日相關精算假設，包含員工離職率及未來薪資變動等。任何精算假設之變動，均可能重大影響本公司確定福利義務之金額。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司民國一〇四年十二月三十一日之淨確定福利負債之帳面金額為71,738千元，當採用之折現率及未來薪資成長率增減變動1%時，本公司認列之淨確定福利負債增減變動如下：

精算假設	淨確定福利負債	
	增加1%	減少1%
折現率	\$ <u>(16,502)</u>	<u>19,814</u>
未來薪資成長率	\$ <u>18,128</u>	<u>(15,544)</u>

上述之敏感度分析係基於其他假設不變的情況下分析單一假設變動之影響。實務上許多假設的變動則可能是連動的。敏感度分析係與計算資產負債表之淨確定福利負債所採用的方法一致。

本期編製敏感度分析所使用之方法與假設與前期相同。

2. 確定提撥計畫

本公司之確定提撥計畫係依勞工退休金條例之規定，依勞工每月工資6%之提繳率，提撥至勞動部勞工保險局(以下簡稱勞工保險局)之勞工退休金個人專戶。在此計畫下本公司提撥固定金額至勞工保險局後，即無支付額外金額之法定或推定義務。本公司民國一〇四年度及一〇三年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用分別為18,686千元及18,495千元，已提撥至勞工保險局。

除上，民國一〇四年度及一〇三年度國外分公司依當地相關法令認列之退休金費用分別為779千元及734千元。

(十) 所得稅

1. 所得稅費用(利益)

本公司民國一〇四年度及一〇三年度之所得稅費用明細如下：

	104年度	103年度
當期所得稅費用		
當期產生	\$ 114,730	114,359
調整前期之當期所得稅	<u>2,626</u>	<u>9,827</u>
	<u>117,356</u>	<u>124,186</u>
遞延所得稅費用		
暫時性差異之發生及迴轉	<u>5,516</u>	<u>11,677</u>
所得稅費用	<u>\$ 122,872</u>	<u>135,863</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司民國一〇四年度及一〇三年度認列於其他綜合損益項下之所得稅費用(利益)明細如下：

	<u>104年度</u>	<u>103年度</u>
不重分類至損益之項目：		
確定福利計畫之再衡量數	\$ <u>(2,562)</u>	<u>151</u>
後續可能重分類至損益之項目：		
國外營運機構財務報告換算之兌換差額	\$ <u>(2,740)</u>	<u>6,130</u>
本公司所得稅費用與稅前淨利之關係調節如下：		
	<u>104年度</u>	<u>103年度</u>
稅前淨利	\$ 929,678	927,419
依本公司所在地國內稅率計算之所得稅	158,045	157,661
永久性差異調整	(4,988)	(3,100)
免稅所得	(23,401)	(12,511)
投資抵減預期新增數	(7,921)	(16,014)
以前年度所得稅核定及估計差異	1,137	9,827
	\$ <u>122,872</u>	<u>135,863</u>

2. 遞延所得稅資產及負債變動明細表

遞延所得稅資產

	<u>103.1.1</u>	<u>借(貸)記 損益表</u>	<u>借(貸)記 其他綜合 損益表</u>	<u>103.12.31</u>	<u>借(貸)記 損益表</u>	<u>借(貸)記 其他綜合 損益表</u>	<u>104.12.31</u>
存貨跌價損失	\$ 11,900	1,020	-	10,880	680	-	10,200
未實現聯屬公司間利益	11,402	(3,307)	-	14,709	(3,180)	-	17,889
淨確定福利負債	10,341	287	151	9,903	270	(2,562)	12,195
其他	845	(8)	-	853	(940)	-	1,793
	\$ <u>34,488</u>	<u>(2,008)</u>	<u>151</u>	<u>36,345</u>	<u>(3,170)</u>	<u>(2,562)</u>	<u>42,077</u>

遞延所得稅負債

	<u>103.1.1</u>	<u>借(貸)記 損益表</u>	<u>借(貸)記 其他綜合 損益表</u>	<u>103.12.31</u>	<u>借(貸)記 損益表</u>	<u>借(貸)記 其他綜合 損益表</u>	<u>104.12.31</u>
國外營運機構財務報告 換算之兌換利益	\$ (7,326)	-	6,130	(13,456)	(1,002)	(2,740)	(9,714)
採權益法認列之國外投 資利益	(47,202)	11,256	-	(58,458)	12,493	-	(70,951)
其他	(455)	2,429	-	(2,884)	(2,805)	-	(79)
	\$ <u>(54,983)</u>	<u>13,685</u>	<u>6,130</u>	<u>(74,798)</u>	<u>8,686</u>	<u>(2,740)</u>	<u>(80,744)</u>

3. 本公司營利事業所得稅結算申報已奉稅捐稽徵機關核定至民國一〇二年度。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

4.兩稅合一相關資訊如下：

	104.12.31	103.12.31
屬民國八十七年度以後之未分配盈餘	\$ <u>794,419</u>	<u>794,417</u>
可扣抵稅額帳戶餘額	\$ <u>69,705</u>	<u>39,969</u>
	104年度 (預計)	103年度 (實際)
對中華民國居住者盈餘分配之稅額扣抵比率	<u>16.39%</u>	<u>13.42%</u>

(十一)資本及其他權益

1.股本

民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日本公司額定股本均為3,000,000千元(均含保留供發行員工認股權憑證200,000千元及可轉換公司債500,000千元之額度)，實收股本均為2,261,682千元，每股面額10元。

本公司員工於民國一〇二年度行使九十六年發行之員工認股權憑證計2,569,750股，截至民國一〇二年十二月三十一日止，尚有1,227,000股未完成法定登記程序。前述員工認股權憑證於民國一〇三年間皆已完成法定登記程序。

2.資本公積

依公司法規定，資本公積需優先填補虧損後，始得以已實現資本公積之全部或一部轉作資本或發放現金。前項所稱之已實現資本公積，包括超過票面金額發行股票所得之溢額及受領贈與之所得。依發行人募集與發行有價證券處理準則規定，得撥充資本之資本公積，每年撥充之合計金額，不得超過實收資本額百分之十。

3.保留盈餘

依本公司章程規定，年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

- (1)提繳稅捐。
- (2)彌補虧損。
- (3)提存百分之十為法定盈餘公積。
- (4)依證券交易法提列或迴轉特別盈餘公積。
- (5)員工紅利就依一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之十三·五。
- (6)董事監察人酬勞就一至四款規定數額後剩餘之數提撥百分之一·五。
- (7)扣除前各項餘額後，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派之。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

本公司依證券主管機關規定於分派盈餘時，應就當年度發生之股東權益減項自可分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，不得分派。嗣後股東權益減項有迴轉時，得就迴轉部分併入可分派盈餘。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

依民國一〇四年五月修正之公司法規定，員工紅利及董事及監察人酬勞已不屬於盈餘分配項目，本公司將於主管機關規定期限前配合修改公司章程。

(1)法定盈餘公積

依公司法規定，公司應就稅後純益提撥百分之十為法定盈餘公積，直至與資本總額相等為止。公司無虧損時，得經股東會決議，以法定盈餘公積發給新股或現金，惟以該項公積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

(2)特別盈餘公積

本公司於首次採用金管會認可之國際財務報導準則時，因選擇適用國際財務報導準則第一號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目，調整帳列股東權益項下之累積換算調整數而增加保留盈餘之金額為18,008千元；另就轉換日之精算損益調整減列保留盈餘13,410千元。依金管會民國一〇一年四月六日金管證發字第1010012865號令規定，應就因轉換採用金管會認可之國際財務報導準則產生之保留盈餘淨增加數4,598千元提列特別盈餘公積，並於使用、處分或重分類相關資產時，得就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉分派盈餘。本公司轉投資之海外子公司盛揚半導體(深圳)有限公司已於民國一〇三年八月完成清算各項權利義務及註銷登記，本公司依據前述函令規定，就原提列特別盈餘公積之比例予以迴轉特別盈餘公積併入保留盈餘計1,956千元。截至民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日止，該項特別盈餘公積餘額均為2,642千元。

又依上段所述函令規定，本公司於分派可分配盈餘時，就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額與上段所提列特別盈餘公積餘額之差額，自當期損益與前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積；屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘補提列特別盈餘公積不得分派。嗣後其他股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部份分派盈餘。

(3)盈餘分派

本公司民國一〇三年度員工紅利實際配發金額為96,174千元，董事監察人酬勞實際配發金額為10,686千元，員工紅利及董事監察人酬勞實際配發情形與本公司民國一〇三年度個體財務報告估列金額並無差異。相關資訊可至公開資訊觀測站等管道查詢之。

本公司分別於民國一〇四年六月九日及一〇三年六月十一日經股東常會決議民國一〇三年度及一〇二年度之盈餘分派案，分派予業主之股利如下：

	103年度		102年度	
	每股股利 (元)	金額	每股股利 (元)	金額
分派予普通股業主之現金股利	\$ 3.5	791,589	3.3	746,355

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(十二)每股盈餘

本公司每股盈餘之計算列示如下：

	<u>104年度</u>	<u>103年度</u>
基本每股盈餘：		
本期淨利	\$ <u>806,806</u>	<u>791,556</u>
計算每股盈餘之加權平均流通在外股數 (千股)	<u>226,168</u>	<u>226,168</u>
基本每股盈餘(元)	\$ <u>3.57</u>	<u>3.50</u>
稀釋每股盈餘：		
本期淨利	\$ <u>806,806</u>	<u>791,556</u>
加權平均流通在外股數(千股)	226,168	226,168
具稀釋作用潛在普通股之影響(千股)	<u>3,015</u>	<u>2,494</u>
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數 (千股)	<u>229,183</u>	<u>228,662</u>
稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>3.52</u>	<u>3.46</u>

(十三)員工及董事監察人酬勞

本公司民國一〇四年度員工及董事、監察人酬勞估列金額分別為98,027千元及10,892千元，係以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事監察人酬勞前之金額乘上本公司章程擬訂定之員工及董事及監察人酬勞分派成數為估計基礎，並列報為民國一〇四年度之營業成本或營業費用。若次年度通過發布財務報告日後有變動，則依會計估計變動處理，並將該變動之影響認列為次年度損益。

(十四)營業外收入及支出

綜合損益表所列之其他利益(損失)淨額明細如下：

	<u>104年度</u>	<u>103年度</u>
外幣兌換利益(損失)淨額	\$ (2,542)	26,939
其他	<u>1,045</u>	<u>1,247</u>
	\$ <u>(1,497)</u>	<u>28,186</u>

(十五)金融工具

1.信用風險

(1)信用風險之暴險

金融資產之帳面金額代表最大信用暴險金額。民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日之最大信用暴險金額分別為2,730,354千元及2,873,687千元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司之潛在信用風險係源自金融資產交易對方或他方未履行合約之潛在影響，主要來自於本公司之現金及約當現金、約定期間三個月以上之定期存款及應收客戶之帳款。

本公司之現金及約當現金及定期存款存放於信用良好之銀行，發生信用風險可能性低。

本公司主要銷售對象為國內外信譽良好之公司，除依授信作業程序給予客戶信用額度外，並持續了解客戶之信用狀況，民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日估本公司應收票據及帳款(含關係人)10%以上客戶之帳款金額分別為280,989千元及275,477千元，使本公司有應收帳款信用風險集中之情形，惟已定期評估應收帳款之回收可能性並提列適當備抵呆帳，管理當局預期未來不致有重大損失。

(2)減損損失

報導日應收款項之帳齡分析如下：

	104.12.31		103.12.31	
	總額	減損	總額	減損
未逾期	\$ 626,682	-	609,631	-
逾期0~30天	8,296	7,393	25,155	-
逾期31~120天	-	-	16,707	7,393
	<u>\$ 634,978</u>	<u>7,393</u>	<u>651,493</u>	<u>7,393</u>

2.流動性風險

下表為金融負債之合約到期日分析：

	帳面金額	合 約 現金流量	1年以內	超過5年
104年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 430,540	430,540	430,540	-
存入保證金	6,654	6,654	-	6,654
	<u>\$ 437,194</u>	<u>437,194</u>	<u>430,540</u>	<u>6,654</u>
103年12月31日				
非衍生金融負債				
應付票據及帳款(含關係人)	\$ 435,144	435,144	435,144	-
存入保證金	7,597	7,597	-	7,597
	<u>\$ 442,741</u>	<u>442,741</u>	<u>435,144</u>	<u>7,597</u>

本公司並不預期到期日分析之現金流量發生時點會顯著提早，或實際金額會有顯著不同。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

3.市場風險

(1)匯率風險

A.匯率風險之暴險

本公司暴露於重大外幣匯率風險之金融資產及負債如下：

	104.12.31			103.12.31		
	外幣	匯率	台幣	外幣	匯率	台幣
<u>金融資產</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美金	\$ 4,071	32.775	133,425	3,521	31.6	111,281
人民幣	110,358	4.9581	547,167	111,323	5.067	565,356
<u>非貨幣性項目</u>						
美金	\$ 34,037	32.775	1,115,573	33,395	31.65	1,056,947
<u>金融負債</u>						
<u>貨幣性項目</u>						
美金	\$ 5,337	32.775	174,927	4,829	31.65	152,849
人民幣	12,913	4.9581	64,023	14,389	5.092	73,269

B.敏感性分析

本公司之匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款及其他應收款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一〇四年度及一〇三年度之稅後淨利將分別增加或減少3,666千元及3,739千元。

(2)其他價格風險

本公司之其他價格風險主要來自於透過損益按公允價值衡量之金融資產，於報導日受益憑證價格變動時產生評價損益，於民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日當權益價格上漲或下跌1%，而其他所有因素維持不變的情況下，民國一〇四年及一〇三年一月一日至十二月三十一日之稅後淨利將分別增加或減少1,780元及1,315元。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

4.公允價值資訊

(1)金融工具之種類及公允價值

本公司金融資產及金融負債之帳面金額及公允價值(包括公允價值等級資訊，但非按公允價值衡量之金融工具其帳面金額為公允價值之合理近似值者，及於活絡市場無報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，依規定無須揭露公允價值資訊)列示如下：

		104.12.31			
		公 允 價 值			
	帳面價值	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
持有供交易之非衍生性金融資產	\$ 214,512	214,512	-	-	214,512
放款及應收款					
現金及約當現金	383,702	-	-	-	-
應收票據及帳款淨額(含關係人)	627,585	-	-	-	-
其他金融資產—流動	1,499,484	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	5,071	-	-	-	-
	<u>\$ 2,730,354</u>	<u>214,512</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>214,512</u>
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款淨額(含關係人)	\$ 430,540	-	-	-	-
存入保證金	6,654	-	-	-	-
	<u>\$ 437,194</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		103.12.31			
		公 允 價 值			
	帳面價值	第一級	第二級	第三級	合 計
透過損益按公允價值衡量之金融資產					
持有供交易之非衍生性金融資產	\$ 158,476	158,476	-	-	158,476
放款及應收款					
現金及約當現金	996,708	-	-	-	-
應收票據及帳款淨額(含關係人)	644,100	-	-	-	-
其他金融資產—流動	1,069,281	-	-	-	-
存出保證金(帳列其他非流動資產)	5,122	-	-	-	-
	<u>\$ 2,873,687</u>	<u>158,476</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>158,476</u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

	103.12.31				
	帳面價值	公 允 價 值			合 計
		第一級	第二級	第三級	
按攤銷後成本衡量之金融負債					
應付票據及帳款淨額(含關係人)	\$ 435,144	-	-	-	-
存入保證金	7,597	-	-	-	-
	<u>\$ 442,741</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(2)按公允價值衡量金融工具之公允價值評價技術

本公司持有之受益憑證係具有標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產，其公允價值係參照市場報價決定。

民國一〇四年度及一〇三年度間並無任何公允價值等級移轉情形。

(十六)財務風險管理

1.概 要

本公司因金融工具之使用而暴露於下列風險：

- (1)信用風險
- (2)流動性風險
- (3)市場風險

本附註表達本公司上述各項風險之暴險資訊、本公司衡量及管理風險之目標、政策及程序。進一步量化揭露請詳附註六(十五)。

2.風險管理架構

董事會全權負責發展及控管本公司之風險管理政策。

本公司之風險管理政策之建置係為辨認及分析本公司所面臨之風險，及設定適當風險限額及控制，並監督風險及風險限額之遵循。風險管理政策及系統係定期覆核以反映市場情況及本公司運作之變化。本公司透過訓練、管理準則及作業程序，以發展有紀律且具建設性之控制環境，使所有員工了解其角色及義務。

本公司之董事會監督管理階層如何監控本公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核本公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。內部稽核人員協助本公司董事會扮演監督角色。該等人員進行定期及例外覆核風險管理控制及程序，並將覆核結果報告予董事會。

3.信用風險

信用風險係本公司因客戶或金融工具之交易對手無法履行合約義務而產生財務損失之風險，主要來自於本公司現金及約當現金及應收客戶之帳款。

有關現金及約當現金、應收款項之信用風險分析，請詳附註六(十五)。另，截至民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日止，本公司均無提供任何背書保證。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

4.流動性風險

流動性風險係本公司無法交付現金或其他金融資產以清償金融負債，未能履行相關義務之風險。本公司管理流動性之方法係盡可能確保本公司在一般及具壓力之情況下，皆有足夠之流動資金以支應到期之負債，而不致發生不可接受之損失或使本公司之聲譽遭受到損害之風險。

流動性風險係由本公司之財務部門所監控，持續監督本公司實際現金流量部位，並使用多方面的資訊，預測並監控本公司在長期與短期之現金流動部位，財務部門並投資額外之現金於適當到期日之存款或短期性投資，並確保本公司之流動性，足以因應即將到期之負債。截至民國一〇四年十二月三十一日止，本公司之營運資金及目前尚有銀行未動支之借款額度164,125千元，應足以支應履行所有合約義務，故未有無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。

5.市場風險

市場風險係指因市價變動，如匯率、利率、權益工具價格變動，而影響本公司之收益或所持有金融工具價值之風險。市場風險管理之目標係管控市場風險之暴險程度在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

本公司為管理市場匯率及受益憑證價格變動風險，所有重大交易之執行均經董事會之覆核與核准，相關財務操作亦受內部稽核部門之監督。相關之管理說明如下：

- (1)本公司暴露於非以功能性貨幣計價之銷售及採購交易所產生之匯率風險。該等交易主要之計價貨幣有美元及人民幣。

有關外幣計價之貨幣性資產及負債，當發生短期不平衡時，本公司係藉由以即時匯率買進或賣出外幣，以確保淨暴險保持在可接受之水準。

- (2)投資組合中重大投資均採個別管理，且所有買賣決策均經董事會之核准。

(十七)資本管理

董事會管理資本之目標係確保本公司於繼續經營與成長之前提下，藉由將債務及權益餘額最適化，以提供股東足夠之報酬。

董事會之資本結構管理策略，係依據本公司所營事業之產業規模、產業未來之成本與產品發展藍圖，以設定本公司適當之市場佔有率，並據以規劃所需之營運資金與現金，以對本公司長期發展所需之各項資產規模，做出整體性之規劃；最後根據本公司產品競爭力推估可能之產品邊際貢獻、營業利益率與現金流量，並考量產業景氣循環波動、產品生命週期等風險因素，以決定本公司適當之資本結構。

董事會定期審核資本結構，並考量不同資本結構可能涉及之成本與風險。

截至民國一〇四年十二月三十一日止，本公司資本管理之方式並未改變。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司於報導日之負債權益比率如下：

	104.12.31	103.12.31
負債總額	\$ 937,892	937,645
權益總額	\$ 4,027,963	4,038,632
負債權益比率	23.28%	23.22%

七、關係人交易

(一)母子公司間關係

本公司之子公司明細如下：

	設立地	業主權益(持股%)	
		104.12.31	103.12.31
MCU Holdings Ltd. (MCU)	BVI	100%	100%
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Holtek BVI)	BVI	100%	100%
Sigmos Holdings Ltd. (Sigmos)	BVI	100%	100%
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. (Kingtek BVI)	BVI	100%	100%
盛凌投資股份有限公司(盛凌投資)	新竹市	100%	100%
芯群集成電路(廈門)有限公司(芯群)	中國廈門市	100%	100%
合泰半導體(中國)有限公司(合泰)	中國東莞市	100%	100%
Holtek Semiconductor (USA) Inc. (Holtek (USA))	美國加州	100%	100%
金科集成電路(蘇州)有限公司(金科)	中國蘇州市	100%	100%
盛通科技股份有限公司(盛通)	新竹市	100%	100%
BestComm RF Electronics Inc. (BestComm)	BVI	100%	100%
優方科技股份有限公司(優方)	台北市	54.75%	54.75%
Best Solution Electronics Inc. (Best Solution)	BVI	100%	100%

(二)母公司與最終控制者

本公司為本公司及本公司之子公司之最終控制者。

(三)與關係人間之重大交易事項

1.銷售

本公司對關係人之重大銷售金額如下：

	104年度	103年度
子公司	\$ 811,224	658,246
關聯企業	1,759,434	1,774,628
	\$ 2,570,658	2,432,874

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司之銷售價格依銷售之產品規格而定，並視銷售之數量給予不定幅度之折扣；銷售予關係人之收款條件約為月結60天至90天。本公司與一般客戶之銷售交易收款條件則視個別客戶之交易往來經驗及債信評估結果決定採預收貨款、即期電匯或月結30天至60天不等。

截至民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日止，本公司與採權益法評價之被投資公司間因銷貨交易所產生之未實現銷貨毛利分別為104,945千元及86,125千元，帳列採用權益法之投資項下。

本公司因上述銷貨交易產生之應收關係人款項明細如下：

	<u>104.12.31</u>	<u>103.12.31</u>
子公司	\$ 229,308	270,758
關聯企業	<u>315,976</u>	<u>282,964</u>
	<u><u>\$ 545,284</u></u>	<u><u>553,722</u></u>

2.進貨

本公司向關係人進貨金額如下：

	<u>104年度</u>	<u>103年度</u>
子公司	\$ 18,600	7,046
關聯企業	<u>710</u>	<u>1,582</u>
	<u><u>\$ 19,310</u></u>	<u><u>8,628</u></u>

本公司與關係人間之進貨交易條件與一般供應商尚無明顯不同。

本公司支付關係人耗材費、雜項購置及委託關係人提供積體電路銷售服務之金額如下：

	<u>104年度</u>	<u>103年度</u>
子公司	\$ 21,712	18,751
關聯企業	<u>4,368</u>	<u>3,519</u>
	<u><u>\$ 26,080</u></u>	<u><u>22,270</u></u>

本公司因上述進貨及其他交易產生之應付關係人款項如下：

	<u>104.12.31</u>	<u>103.12.31</u>
子公司	\$ 7,604	5,245
關聯企業	<u>192</u>	<u>-</u>
	<u><u>\$ 7,796</u></u>	<u><u>5,245</u></u>

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

3.其他交易

(1)截至民國一〇四年及一〇三年十二月三十一日止，本公司因出售機器設備予金科及合泰所產生之未實現利益分別為287千元及399千元，帳列採權益法之投資項下。

(2)民國一〇四年度關聯企業代本公司支付專門技術購置款計3,244千元，截至民國一〇四年十二月三十一日止，因前述交易產生之應付款項皆已付訖。

(四)主要管理階層人員交易

主要管理階層人員報酬如下：

	104年度	103年度
短期員工福利	\$ 19,636	18,909
退職後福利	432	432
	<u>\$ 20,068</u>	<u>19,341</u>

八、質押之資產

資產名稱	質押擔保標的	104.12.31	103.12.31
定期存款(帳列其他金融資產—流動)	進口關稅保證金	\$ <u>3,706</u>	<u>3,583</u>

九、重大或有負債及未認列之合約承諾

本公司與ARM公司等簽有技術授權合約，合約中訂定當本公司銷售之產品若有運用約定技術時，需依雙方議定價格支付權利金。

十、重大之災害損失：無。

十一、重大之期後事項：無。

十二、其 他

員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總如下：

功 能 別 性 質 別	104年度			103年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
員工福利費用						
薪資費用	25,821	457,766	483,587	25,646	442,226	467,872
勞健保費用	2,071	30,028	32,099	1,965	29,722	31,687
退休金費用	1,406	19,252	20,658	1,229	19,188	20,417
其他員工福利費用	1,126	13,081	14,207	1,120	12,961	14,081
折舊費用	6,645	22,072	28,717	8,265	20,641	28,906
攤銷費用	-	65,954	65,954	-	50,226	50,226

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

本公司民國一〇四年度及一〇三年度平均員工人數均為381人。

十三、附註揭露事項

(一)重大交易事項相關資訊

民國一〇四年度本公司依證券發行人財務報告編製準則之規定，應再揭露之重大交易事項相關資訊如下：

- 1.資金貸與他人：無。
- 2.為他人背書保證：無。
- 3.期末持有有價證券情形(不包含投資子公司、關聯企業及合資控制部分)：

數量單位：千股(單位)

持有之公司	有價證券 種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳列科目	期 末				備 註
				股 數	帳面金額	持股比率	公允價值	
本公司	第一金台灣債券基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	4,922	74,314	-	74,314	
本公司	統一強棒基金	-	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	8,493	140,198	-	140,198	
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	Unitech Capital Inc.	-	以成本衡量之金融資產	2,500	86,750	5.00 %	-	
盛凌投資股份有限公司	譜永投資股份有限公司	-	以成本衡量之金融資產	23,124	143,000	3.03 %	-	

- 4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：

買、賣 之公司	有價證券 種類及 名稱	帳列 科目	交易 對象	關係	期 初		買 入		賣 出				期 末	
					單位數	金額	單位數	金額	單位數	售價	帳面 成本	處分 損益	單位數	金額
本公司	統一強棒基金	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	統一投信	-	5,883	96,566	65,525	1,078,935	62,915	1,036,582	1,035,352	1,230	8,493	140,149 (註)

註：期末金額係取得成本，依市價評價後之帳面金額請詳3。

- 5.取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- 6.處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
- 7.與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

進(銷)貨 之公司	交易 對象 名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易 不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進 (銷) 貨	金 額	佔總進 (銷)貨 之比率	授信 期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收 (付)票據、帳 款之比率	
本公司	Holtek BVI	本公司之子公司	銷貨	(511,233)	(14) %	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	187,383	30 %	
Holtek BVI	本公司	Holtek BVI之母公司	進貨	511,233	100 %	月結90天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(187,383)	(100) %	
本公司	欣宏	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(489,945)	(14) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	93,606	15 %	
欣宏	本公司	對欣宏採權益法評價之投資公司	進貨	489,945	65 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(93,606)	(83) %	

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

進(銷)貨之公司	交易對象名稱	關 係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金 額	佔總進(銷)貨之比率	授信期間	單 價	授信期間	餘 額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	優方	本公司之子公司	銷貨	(196,157)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	33,498	5 %	
優方	本公司	優方之母公司	進貨	196,157	100 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(33,498)	(100) %	
本公司	Crown Rich	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(183,635)	(5) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	23,253	4 %	
Crown Rich	本公司	對Crown Rich採權益法評價之投資公司	進貨	183,635	47 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(23,253)	(24) %	
本公司	ForIC	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(156,810)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	38,489	6 %	
ForIC	本公司	對ForIC採權益法評價之投資公司	進貨	156,810	69 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(38,489)	(67) %	
本公司	Newtek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(155,463)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	29,551	5 %	
Newtek	本公司	對Newtek採權益法評價之投資公司	進貨	155,463	43 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(29,551)	(41) %	
本公司	鈺威	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(149,859)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	29,219	5 %	
鈺威	本公司	對鈺威採權益法評價之投資公司	進貨	149,859	13 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(29,219)	(21) %	
本公司	New Wave	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(144,355)	(4) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	20,949	3 %	
New Wave	本公司	對New Wave採權益法評價之投資公司	進貨	144,355	41 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(20,949)	(29) %	
本公司	金濤	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(123,394)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	26,192	4 %	
金濤	本公司	對金濤採權益法評價之投資公司	進貨	123,394	70 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(26,192)	(83) %	
本公司	Truetek	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	銷貨	(101,135)	(3) %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	18,264	3 %	
Truetek	本公司	對Truetek採權益法評價之投資公司	進貨	101,135	37 %	月結60天	尚無顯著不同	尚無顯著不同	(18,264)	(35) %	

8.應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣千元

帳列應收款項之公司	交易對象名稱	關 係	應收關係人款項餘額	週轉率	逾期應收關係人款項		應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
					金 額	處理方式		
本公司	Holtek BVI	子公司	187,383	2.66	4,516	即期收款	17,830 (註)	-

註：係截至民國一〇五年一月十一日止收回之金額。

9.從事衍生性商品交易：無。

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

(二)轉投資事業相關資訊：

民國一〇四年度本公司之轉投資事業資訊如下(不包含大陸被投資公司)：

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
本公司	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	475,831	475,831	15,253	100.00 %	498,738	8,657	8,657	本公司之子公司
本公司	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	69,542	69,542	2,000	100.00 %	125,677	1,864	1,864	本公司之子公司
本公司	Sigmos Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	6,898	6,898	200	100.00 %	18,861	1,961	1,961	本公司之子公司
Sigmos Holdings Ltd.	Holtek Semiconductor (USA) Inc.	美國加洲	積體電路買賣及技術服務	6,898	6,898	2,000	100.00 %	18,861	1,961	註1	本公司之孫公司
本公司	MCU Holdings Ltd.	B.V.I.	投資海外各項事業	74,393	74,393	2,277	100.00 %	472,297	61,006	61,006	本公司之子公司
MCU Holdings Ltd.	ForIC Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	9,733	9,733	300	40.00 %	28,377	8,257	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
ForIC Electronics Holding Ltd.	E-Micro Technology Holding Ltd. (BVI)	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	9,473	9,473	300	100.00 %	9,093	(374)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	Trueteck Technology Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	16,306	16,306	920	40.00 %	42,024	6,686	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Quanding Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	1,868	1,868	60	40.00 %	10,162	1,721	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Innotek Electronics Inc.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	9,411	9,411	320	40.00 %	11,252	3,478	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Santek Holdings Ltd.	B.V.I.	電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	3,758	3,758	180	40.00 %	13,291	10,337	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Bestway Electronic Inc.	B.V.I.	電子零件之銷售及技術服務	3,470	3,470	800	40.00 %	20,214	11,660	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
Bestway Electronic Inc.	新棠(香港)有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	8,675	8,675	2,000	100.00 %	11,886	(1,066)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
MCU Holdings Ltd.	New Wave Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	24,784	24,784	800	40.00 %	47,441	17,403	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Newtek Electronics Ltd.	B.V.I.	電子元件與單片機蕊片之應用與技術諮詢	8,105	8,105	1,501	40.61 %	64,016	24,253	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Crown Rich Technology Holding Ltd.	B.V.I.	電子元器件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	2,641	2,641	80	40.00 %	34,465	13,650	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所 在 地 區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
MCU Holdings Ltd.	MegaSky Electronics Holding Ltd.	B.V.I.	電子元件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	-	-	-	- %	-	(966)	註1,2	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Fine Chip Electronics Inc.	B.V.I.	電子元件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	7,039	-	1	40.00 %	6,590	(897)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	Anchip Technology Corporation	B.V.I.	電子元件及單片機蕊件的技術支持與諮詢服務	2,028	-	-	40.00 %	1,920	(159)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	金濟高科有限公司	香港	電子零件之銷售及技術服務	9,907	9,907	2,400	40.00 %	18,223	4,053	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
MCU Holdings Ltd.	宏達科技有限公司	香港	電子零件設計及銷售	5,427	5,427	1,275	33.00 %	8,451	3,828	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
本公司	盛凌投資股份有限公司	新竹市	專營投資業務	400,000	400,000	40,000	100.00 %	417,189	27,036	27,036	本公司之子公司
盛凌投資股份有限公司	欣宏電子股份有限公司	台北市	電子零組件製造/批發/零售	77,035	77,035	6,595	40.00 %	100,462	51,225	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
欣宏電子股份有限公司	A-ONE WIRELESS TECHNOLOGY CORP.	B.V.I.	電子零組件製造/批發/零售	59,204	59,204	2,000	100.00 %	130,670	38,645	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司轉投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	鈺威股份有限公司	新北市	電子零組件加工製造、買賣進出口	37,500	37,500	5,641	22.39 %	66,956	19,174	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	高聖科技股份有限公司	新北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電信器材批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	2,350	2,350	235	39.17 %	-	1,361	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司
盛凌投資股份有限公司	優方科技股份有限公司	台北市	電子零組件製造、電子材料批發零售、電腦及其週邊設備製造、資訊軟體服務及國際貿易	16,000	16,000	1,600	54.75 %	22,061	16,441	註1	本公司之孫公司
優方科技股份有限公司	Best Solution Electronics Inc.	B.V.I.	電子元件、電子材料批發	12,279	12,279	400	100.00 %	35,624	16,705	註1	本公司之孫公司投資之子公司
盛凌投資股份有限公司	金信科技股份有限公司	新竹市	模具批發、精密儀器批發、資訊軟體批發、電子材料批發、資訊軟體零售及電子材料零售、國際貿易及資訊軟體服務業、資訊處理服務及產品設計業、網路認證服務業	28,489	16,452	2,050	33.17 %	14,531	(17,831)	註1	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

投資公司 名稱	被投資公司 名稱	所在 地區	主要營 業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資損益	備註
				本期期末	去年年底	股數	比率	帳面金額			
金信科技股份 有限公司	Gingy Technology Inc.	B.V.I	模具批發、精 密儀器批發 、資訊軟體批 發、電子材料 批發、資訊軟 體零售及電子 材料零售、國 際貿易及資訊 軟體服務業 、資訊處理服 務及產品設計 業、網路認證 服務業	988	988	2	100.00 %	1,167	95	註1	本公司之子公司 採權益法評價之 被投資公司轉投 資之子公司
盛凌投資股份 有限公司	天宇微機電股 份有限公司	新竹市	電子零組件製 造、電子材料 批發零售、電 信器材批發零 售、智慧財產 權業、資訊軟 體服務及國際 貿易	10,002	10,002	380	20.00 %	-	(1,596)	註1	本公司之子公司 採權益法評價之 被投資公司
盛凌投資股份 有限公司	盛通科技股份 有限公司	新竹市	電子零組件製 造、電子材料 批發零售、資 訊軟體服務及 國際貿易	20,000	20,000	2,000	100.00 %	13,334	(3,441)	註1	本公司之孫公司
盛通科技股份 有限公司	BestComm RF Electronics Inc.	B.V.I.	電子零組件製 造/批發/零售	8,924	8,924	18	100.00 %	7,115	(954)	註1	本公司之孫公司 投資之子公司

註1：對各該公司投資損益之認列已分別包含於對子公司或孫公司之投資損益中。

註2：MegaSky Electronics Holding Ltd.已於民國一〇四年十二月完成清算各項權利義務及註銷登記。

(三)大陸投資資訊：

1.轉投資大陸地區之事業相關資訊：

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項目	實收 資本額	投資 方式	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資 公司本 期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認 列投資 損益	期末投 資帳面 價值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回						
芯群集成電路 (廈門)有限公 司	積體電路買賣 及技術服務	113,551	(註1)	101,027	-	-	101,027	4,534	100 %	4,534	122,441	-
合泰半導體 (中國)有限公 司	集成電路、電 子元器件及單 片機晶片之批 發及進出口業 務與諮詢服務 業務	292,423	(註1)	272,221	-	-	272,221	(4,004)	100 %	(4,004)	272,938	-
新緯科技(深 圳)有限公司	電子零件銷售 及售後服務	6,769	(註1)	3,383	-	-	3,383	234	40 %	94	11,281	-
新禾(廈門)電 子有限公司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	6,398	(註1)	2,506	-	-	2,506	691	40 %	276	13,472	-
諾華達電子 (深圳)有限公 司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	9,287	(註1)	3,928	-	-	3,928	(11,316)	40 %	(4,526)	6,793	-
新碩電子科技 (杭州)有限公 司	電子元器件及 單片機晶片技 術研發與諮詢 服務業務	14,727	(註1)	-	-	-	-	1,981	40 %	792	16,672	-

盛群半導體股份有限公司個體財務報告附註(續)

大陸被投資 公司名稱	主要營業 項目	實 收 資本額	投資 方式	本期期初自 台灣匯出累 積投資金額	本期匯出或 收回投資金額		本期期末自 台灣匯出累 積投資金額	被投資 公司本 期損益	本公司直接 或間接投資 之持股比例	本期認 列投資 損 益	期末投 資帳面 價 值	截至本期 止已匯回 投資收益
					匯出	收回						
華榮匯電子科 技(北京)有限 公司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	19,361	(註1)	3,601	-	-	3,601	(2,199)	40 %	(880)	22,427	-
振揚電子(青 島)有限公司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	6,315	(註1)	2,634	-	-	2,634	(1,073)	40 %	(429)	5,952	-
新鼎電子(深 圳)有限公司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	6,699	(註1)	2,647	-	-	2,647	2,927	40.61 %	1,189	6,121	-
信霖電子商貿 (上海)有限公 司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	30,293	(註1)	3,911	-	-	3,911	5,856	40 %	2,342	42,487	-
華瑞昇電子 (深圳)有限公 司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	4,952	(註1)	1,964	-	-	1,964	2,983	40 %	1,193	13,449	-
全鼎電子(蘇 州)有限公司	電子元器件及 單片機晶片技 術支持與諮詢 服務業務	3,736	(註1)	1,600	-	-	1,600	1,106	40 %	442	9,146	-
金科集成電路 (蘇州)有限公 司	電子零件銷售 及售後服務	69,712	(註1)	69,712	-	-	69,712	1,863	100 %	1,863	125,634	-

2.轉投資大陸地區限額：

本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額(註2)	經濟部投審會核准 投資金額(註2、3)	依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額
471,089 (美金15,111千元)	548,159 (美金16,725千元)	2,416,778 (註4)

註1：透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註2：累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額係依實際匯出之歷史匯率換算之新台幣金額；經濟部投審會核准投資金額係以資產負債表日匯率換算新台幣金額。

註3：係包括核准自台灣匯出投資金額計493,393千元(美金15,054千元)及第三地區之盈餘轉增資金額計54,766千元(美金1,671千元)。

註4：依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規定，本公司對大陸投資累計金額未超過主管機關所定投資金額或比例上限。淨值4,027,963千元×60%＝2,416,778千元。

3.重大交易事項：

本公司民國一〇四年度與大陸被投資公司直接或間接之重大交易事項，請詳「重大交易事項相關資訊」之說明。

十四、部門資訊

請詳民國一〇四年度合併財務報告。

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	104.12.31	103.12.31	差 異	
			金額	%
流動資產	3,824,522	3,830,158	(5,636)	(0)
長期投資	659,020	628,862	30,158	5
固定資產	463,561	487,863	(24,302)	(5)
其他資產	116,934	112,683	4,251	4
資產總額	5,064,037	5,059,566	4,471	0
流動負債	854,700	858,093	(3,393)	(0)
其他負債	163,141	143,866	19,275	13
負債總額	1,017,841	1,001,959	15,882	2
股本	2,261,682	2,261,682	0	0
資本公積	142,309	142,309	0	0
保留盈餘	1,591,692	1,588,979	2,713	0
股東權益總額	4,046,196	4,057,607	(11,411)	0
重大變動項目說明：				
1. 其他負債較 104 年度期末增加，主要係淨確定福利負債增加所致。				

二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

(一) 財務績效比較表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	104 年度	103 年度	增(減)金額	變 動 比 例 %
營業收入淨額	3,967,840	3,930,519	37,321	0.95
營業成本	2,019,362	2,041,772	(22,410)	(1.10)
營業毛利	1,948,478	1,888,747	59,731	3.16
減:未實現銷貨利益之變動	(258)	4,815	(5,073)	(105.36)
已實現營業毛利	1,948,736	1,883,932	64,804	3.44
營業費用	1,102,186	1,066,437	35,749	3.35
營業利益	846,550	817,495	29,055	3.55
營業外收入及利益	100,153	121,024	(20,871)	(17.25)
稅前淨利	946,703	938,519	8,184	0.87
所得稅利益(費用)	(128,382)	(139,935)	11,553	8.26
本期淨利	818,321	798,584	19,737	2.47
其他綜合損益(稅後淨額)	(25,886)	30,596	(56,482)	(184.61)
本期綜合損益總額	<u>792,435</u>	<u>829,180</u>	(36,745)	(4.43)
本期淨利歸屬母公司業主	806,806	791,556	15,250	1.93
本期淨利歸屬非控制權益	11,515	7,028	4,487	63.84
綜合損益歸屬母公司業主	780,920	822,225	(41,305)	(5.02)
綜合損益歸屬非控制權益	11,515	6,955	4,560	65.56

增減比例變動分析說明：

- 1.104 年度聯屬公司間未實現銷貨毛利減少，主要係出貨至轉投資公司，而轉投資公司尚未出貨至終端客戶之未實現銷貨利益減少所致。
- 2.104 年度其他綜合損益減少，主要係國外營運機構財務報告換算之兌換差額(稅後淨額)較 103 年度減少所致。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

(一) 104 年度現金流量變動分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,179,235	767,588	(1,266,423)	680,400	—	—
104 年度現金流量變動情形分析：					
1. 營業活動：係營運持續獲利，致使營業活動淨現金流入。					
2. 投資活動：存放三個月以上定存增加，致產生投資活動淨現金流出。					
3. 融資活動：發放股東現金紅利，致產生融資活動淨現金流出。					

(二) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
680,400	800,000	(750,000)	730,400	—	—
105 年現金流量情形分析：					
1. 營業活動：係預期營運持續成長、獲利增加，致使營業活動淨現金流入。					
2. 融資活動：係預期盈餘分派現金股息紅利增加，致產生融資活動淨現金流出。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形			
				101 年度	102 年度	103 年度	104 年度
固定資產	自有資金	101 年度	224,965	224,965	—	—	—

(二) 預期可能產生效益：預期可拓展海內外市場業務之發展機會。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司轉投資主要係配合公司營運發展所需，建立完整之銷售及技術服務體系，104年度依權益法認列之投資收益淨額為 57,094 仟元，轉投資狀況請參閱財務報告第 138 頁至第 141 頁附註十三之(二)說明。

- 1.轉投資公司之獲利或虧損主要原因係與營收金額相關，本公司將致力於提昇轉投資公司之營收成長並控制成本費用，以改善其獲利狀況。
- 2.未來之投資計劃仍以業務發展需求考量，於適當時機評估各項投資計畫。

六、風險事項分析：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

- 1.利率：本公司並無因利率變動，而對本公司損益有重大影響情事。本公司約當現金部位主要以投資銀行定存及貨幣型基金為主，往來之金融單位皆是國內外具有一定評比及規模之機構，以獲取穩定、安全之資金投資報酬。
- 2.匯率：為避免因匯率波動對本公司之營收及獲利造成重大影響，本公司除有專責人員每日觀察外匯市場變化及蒐集相關資訊外，並採取下列具體因應措施：
 - (1) 業務單位向客戶報價前，先行對匯率走勢進行審慎評估，並綜合考量影響匯率升貶之各項因素，採取較合理穩健之匯率作為業務報價之基礎，以降低匯率變動對公司營收及獲利之影響。
 - (2) 除與往來銀行與專業金融機構保持密切聯繫，期充分掌握國際匯率之走勢外，內部並定期檢討匯率走勢，針對外幣資金部位規範操作策略，另依避險需求採預售遠期外匯等方式，以降低匯率變動之衝擊。
 - (3) 開立多種外幣帳戶，視實際資金需求或匯率走勢，調節所持之外幣部位，並盡量以同幣別之銷貨收入支應應付帳款，利用自動避險之特性已規避大部分之匯兌風險。

- 3.通貨膨脹：對本公司損益並無重大影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

- 1.本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證業務，而若從事之衍生性商品交易，主要係為規避外幣存款、外幣應收及應付帳款匯率波動之變動風險，因係避險性質，並未對公司損益造成重大影響之虞。
- 2.本公司訂有「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」，所有程序均嚴格規範作業程序及風險控管，並責成相關單位依程序規定辦理，並未發生重大虧損之情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司以微控制器為產品發展主軸，聚焦在家電產品、健康量測、安全防護、電腦週邊、工業控制、車用電子、儀表顯示等領域之市場應用，每年以投入約營業額之 15%~20%作為研發經費，並結合上、中、下游資源進行策略聯盟，以維持公司之產品競爭力。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司對於最近年度國內外重要政策及法律變動皆已採取適當之因應措施，故相關政策及法律變動對於本公司財務及業務並無重大影響。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

面對半導體產業技術不斷提升，本公司除每年投入約營業額的 15%~20%作為研發經費，更因應 IC 設計產業分工日異明顯之趨勢，專注於微控制器 IC 及微控制器週邊 IC 之產品研發與市場開發，並與上游廠商配合使用先進技術，有充分能力因應科技改變及產業變化，為本公司財務及業務帶來正面挹注。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持穩健經營之企業精神，致力於維持本公司既有之良好企業形象，並且經由嚴格的內部控制及危機管理機制，有效防患於未然，確保企業永續經營。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 本公司自成立以來營運狀況良好，且由於營運規模較大，代工廠會優先提供足夠產能。另為進一步分散進貨風險及在產能、製程技術、品質良率及交期掌握等綜合因素考量下，本公司亦積極尋找不同之代工產能，目前與數家晶圓大廠及封裝測試之代工廠商合作，並無進貨過度集中之情形。
2. 本公司多年來積極開拓市場，客戶群遍佈國內外包含大陸在內之全球各主要市場，充分達到分散風險，避免銷售過度集中之虞。另加強授信管理及要求提供相當之擔保品，持續追蹤帳款收款情形，以期維持穩健的經營結果。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處置情形：不適用。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

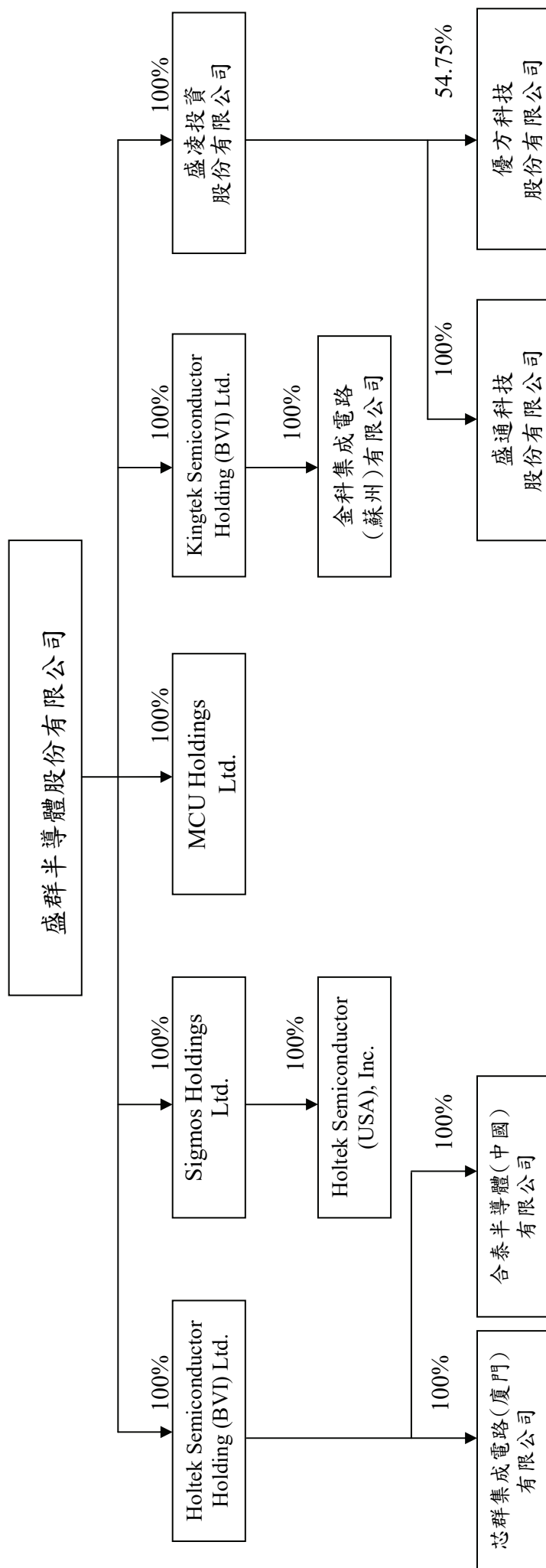
七、其他重要事項：無。

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業組織概況

1. 關係企業組織圖



(二)關係企業基本資料

日期：105 年 3 月 31 日

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業項目
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	88.10	TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BVI	US\$15,253,360	投資海外各項事業
Sigmos Holdings Ltd.	89.12	TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BVI	US\$200,000	投資海外各項事業
Holtek Semiconductor (USA), Inc.	90.05	46729 Fremont Blvd., Fremont CA 94538, USA	US\$200,000	積體電路買賣及技術服務
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	91.01	TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BVI	US\$2,000,000	投資海外各項事業
金科集成電路(蘇州)有限公司	91.04	中國蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道 1355 號國際科技園 122A 室	US\$2,000,000	積體電路買賣及技術服務
MCU Holdings Ltd.	91.05	TrustNet Chambers P.O. Box 3444 Road Town, Tortola BVI	US\$2,277,440	投資海外各項事業
盛凌投資股份有限公司	92.03	新竹市大同路 136 號 2 樓	NT\$400,000,000	專營投資業務
芯群集成電路(廈門)有限公司	97.02	中國廈門市軟件園二期觀日路 34 號 202 室	US\$3,500,000	單片機芯片及其應用工具的技術服務
優方科技股份有限公司	97.05	臺北市南港區三重里園區街 3-2 號 4 樓之 2	NT\$40,000,000	觸控應用 IC 銷售及設計業務
合泰半導體(中國)有限公司	101.07	中國東莞市松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢(辦公 101 號房)	US\$9,764,280	積體電路買賣及技術服務
盛通科技股份有限公司	103.01	新竹市大同路 136 號 2 樓	NT\$20,000,000	RF 應用 IC 銷售及設計業務

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

行業別	關係企業名稱	與他關係企業經營業務之關聯
對各種事業之投資	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	投資芯群集成電路(廈門)及合泰半導體(中國)等公司。
	Sigmos Holdings Ltd.	投資 Holtek Semiconductor (USA), Inc.。
	MCU Holdings Ltd.	為本公司投資業務。
	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	投資金科集成電路(蘇州)有限公司。
	盛凌投資股份有限公司	為本公司投資業務。
積體電路之買賣及技術服務	合泰半導體(中國)有限公司	為本公司推廣產品，建立大陸地區銷售網路及開拓市場，並協助客戶產品之應用及提供產品之售後服務。
	Holtek Semiconductor (USA), Inc.	
	金科集成電路(蘇州)有限公司	
單片機芯片及其應用工具的技術服務	芯群集成電路(廈門)有限公司	為本公司推廣 MCU 產品，建立中國地區 MCU 發展工具之銷售網路及開拓市場，並提供相關技術服務。
觸控應用 IC 銷售及設計業務	優方科技股份有限公司	提供本公司觸控方案系列產品，包括標準觸控 IC、微控制器觸控 IC 以及各式高整合 SoC 微控制器觸控 IC。
RF 應用 IC 銷售及設計業務	盛通科技股份有限公司	提供本公司 RF 無線方案系列產品，包括 RF IC 及 RF+MCU 整合型 SoC。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

日期：105 年 3 月 31 日

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：吳啟勇	15,253,360	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：李佩縈	15,253,360	100%
芯群集成電路(廈門)有限公司	董事長	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇	--	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟	--	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：張治	--	100%
	監察人	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：李佩縈	--	100%
	總經理	張家志	--	--
合泰半導體(中國)有限公司	董事長	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：吳啟勇	--	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟	--	100%
	董 事	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：李佩縈	--	100%
	監察人	Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：廖明通	--	100%
	總經理	蔡榮宗	--	--
Sigmos Holdings Ltd.	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：林正鋒	200,000	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：李佩縈	200,000	100%
Holtek Semiconductor (USA), Inc.	董 事	Sigmos Holdings Ltd. 代表人：連文德	2,000,000	100%
	總經理	連文德	--	--
MCU Holdings Ltd.	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：林正鋒	2,277,440	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：李佩縈	2,277,440	100%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：吳啟勇	2,000,000	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：高國棟	2,000,000	100%
金科集成電路(蘇州)有限公司	董事長	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：高國棟	--	100%
	董 事	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：張治	--	100%
	董 事	Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 代表人：李佩縈	--	100%
	總經理	李佩縈	--	--
盛凌投資股份有限公司	董事長	盛群半導體股份有限公司 代表人：吳啟勇	40,000,000	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：高國棟	40,000,000	100%
	董 事	盛群半導體股份有限公司 代表人：李佩縈	40,000,000	100%
	監察人	盛群半導體股份有限公司 代表人：李文德	40,000,000	100%
優方科技股份有限公司	董事長	盛凌投資股份有限公司 代表人：吳啟勇	1,600,000	40%
	董 事	盛凌投資股份有限公司 代表人：李佩縈	1,600,000	40%
	董 事	欣宏電子股份有限公司 代表人：林既貴	1,475,000	36.875%
	監察人	新耕投資有限公司 代表人：周玲娜	1,475,000	36.875%
	總經理	樂正平	250,000	6.25%
盛通科技股份有限公司	董事長	盛凌投資股份有限公司 代表人：吳啟勇	2,000,000	100%
	董 事	盛凌投資股份有限公司 代表人：高國棟	2,000,000	100%
	董 事	盛凌投資股份有限公司 代表人：李佩縈	2,000,000	100%
	監察人	盛凌投資股份有限公司 代表人：李文德	2,000,000	100%
	總經理	李文義	--	--

(六)關係企業營運概況

日期：104 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元(除每股損益為新台幣元外)

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨 值	營業 收入	營業利益 (損失)	本期(損)益 (稅後)	每股(損)益 (稅後)
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	475,831	686,120	187,383	498,738	510,613	(0)	8,657	0.50
芯群集成電路(廈門)有限公司	113,551	155,719	33,278	122,441	171,786	3,341	4,534	註 2
合泰半導體(中國)有限公司	292,423	444,903	171,965	272,938	512,535	(4,101)	(4,004)	註 2
Sigmos Holdings Ltd.	6,898	18,861	0	18,861	0	0	1,961	9.80
Holtek Semiconductor (USA), Inc.	6,898	24,850	5,989	18,861	57,685	2,678	1,961	0.98
MCU Holdings Ltd.	74,393	472,297	0	472,297	0	(89)	61,006	26.79
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	69,542	125,677	0	125,677	0	0	1,864	0.93
金科集成電路(蘇州)有限公司	69,712	193,891	68,257	125,634	246,378	1,260	1,863	註 2
盛凌投資股份有限公司	400,000	417,234	45	417,189	0	(20)	27,036	0.68
優方科技股份有限公司	40,000	83,694	43,400	40,294	233,119	27,555	16,441	4.11
盛通科技股份有限公司	20,000	14,642	1,308	13,334	3,469	(3,581)	(3,441)	(1.72)

註 1：關係企業如為外國公司，相關數字係以報表日期之兌換匯率換算為新台幣列示，104.12.31 兌換美元 32.7750；人民幣 4.9581。

註 2：係為有限公司，並未發行股份，故不列示每股損益。

(七)關係企業合併財務報表：

聲 明 書

本公司民國一〇四年度(自一〇四年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際會計準則第二十七號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：盛群半導體股份有限公司



董事長：吳啟勇



中 華 民 國 一 〇 五 年 一 月 二 十 五 日

(八)關係企業報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項：無。

盛群半導體股份有限公司



負責人： 吳啟勇

